日月光集團

股票代碼：2311
NYSE：ASX

一〇一年度年報

日月光半導體製造股份有限公司

本年報可於以下網址查詢
公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
本公司網站 http://www.aseglobal.com
中華民國一〇二年二月二十八日 刊印

本公司發言人

張洪本・職稱｜副董事長兼總經理

代理發言人

董宏思・職稱｜財務長

電話｜(02)87805489

電子郵件信箱｜ir@aseglobal.com

總公司

地址｜高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話｜(07)3617131

傳真｜(07)3613094、3614546

台北辦公室

地址｜台北市基隆路一段333號19樓1901室

電話｜(02)87805489、66365678

傳真｜(02)27576121

中壢分公司

地址｜桃園縣中壢市中華路一段550號

電話｜(03)4527121　傳真｜(03)4628658

南投分公司

地址｜南投縣草屯鎮太平路一段351巷135號

電話｜(049)2350876　傳真｜(049)2315924

高雄工廠地址

地址｜高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話｜(07)3617131

中壢工廠地址

地址｜桃園縣中壢市復華里中華路一段550、516號

電話｜(03)4527121

南投工廠地址

地址｜南投縣草屯鎮太平路一段351巷135號

電話｜(049)2350876

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址｜台北市松山區東興路8號地下一樓

電話｜(02) 27463797

網址｜http://www.uni-psg.com

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱｜勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名｜陳珍麗會計師 / 龔俊吉會計師

地址｜高雄市中正三路2號20樓

電話｜（07）2389988

網址｜http://www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所（NYSE）

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

網址｜http://www.aseglobal.com

壹 致股東報告書 02
貳 一〇一年度年報 07
經營摘要 04

致股東報告書

董事長 張虔生

各位股東女士、先生：

延續 2011 年全球經濟日漸疲弱之趨勢，2012 年歐債危機已擴及西班牙與義大利等歐洲國家。美國經濟改善速度也在 2012 年中之後陷入遲緩，而中國大陸經濟降溫更創下近年新低水準，上述因素對全球經濟造成嚴重衝擊。台灣無法自別於國際經濟之外，連帶經濟表現也大受影響，加上去年的種種政策方向變革，使得國內的情勢更加嚴峻，整體經濟呈現出「內外皆冷」之局面。根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 之統計，2012 年全球半導體銷售額年減 2.7%。而工研院 IEK ITIS 計畫之報告，2012 年台灣半導體產業產值為新台幣 1 兆 6,342 億元，較 2011 年成長約 4.6%。IC 封測產業方面雖然智慧型手機及平板電腦成長優異，但由於 PC 產業買氣不振，抵銷了整體封測業之表現。封裝業產值為新台幣 2,720 億元，較 2011 年成長 0.9%；測試業產值為新台幣 1,215 億元，較 2011 年成長 0.6%。面對艱困挑戰之局勢，本公司審慎迎戰以因應大環境之變遷。茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下：

「2012 年營業結果」

I **2012 年營業計畫實施成果 |** 本公司 2012 年合併營收為新台幣 1,940 億元，較 2011 年增加 86 億元，成長 4.7%。就封測本業來看，2012 年度合併營收為新台幣 1,300 億元，成長 1.9%。2012 年第 4 季先進封裝營收達 2.46 億美元，季增 25%；全年先進封裝營收則達 8.34 億美元，年增 27%。2012 年本公司銅打線營收成長 5 億美元，截至第 4 季銅打線佔打線營收比重已達 6 成，遠高於業界平均 2 成左右的水準。金打線營收雖下滑 6 億美元，但營收變化主要受到金轉銅比重增加，所以即使出貨量不變、營收原本就會下滑，加上 2012 年金價走疲，成本降低，實際上對本公司獲利能力仍是有正面助益。

II **預算執行情形 |** 本公司於 2012 年並未公開財務預測。

III **財務收支及獲利能力分析 |** 本公司截至 2012 年底止，實收資本額為 75,941,496 仟元，股東權益為 109,514,885 仟元佔總資產 189,000,561 仟元之 58%，長期資金佔固定資產比率為 252%，流動比率為 42%，本年度較前一年度財務比率略為衰退，但財務結構及償債能力持續維持穩健，本年度營業利益為新台幣 10,732,774 仟元，較 2011 年減少新台幣 126,358 仟元。在整體經濟環境不佳的影響下，本公司在封測本業上力求屹立不搖。本年度稅後純益為新台幣 13,091,359 仟元，較上年度下降 4.6%。整體營運相較於本業上的守成，本公司仍算表現不錯。

IV **研究發展狀況 |** 近年來在雲端運算興起與結合手機及平板電腦等智能行動裝置應用趨勢帶動之下，半導體高階應用晶片封裝測試等市場需求逐漸蔚為風潮。本公司延續產品開發三大主軸：高階封裝、先進銅銲線製程及低腳數封裝，順勢將本公司成功經驗與全球競爭優勢推向正蓬勃發展之 28 奈米先進封裝、覆晶封裝、晶圓銅柱凸塊及三維系統封裝等先進技術領域。本公司在 2012 年成功開發之新技術歸類如下：(1) 在覆晶封裝延伸 28 奈米銅製程 / 超低介電係數晶圓之無鉛、錫鉛覆晶 FCBGA / FCCSP 封裝等技術至更多應用領域與新客戶量產。(2) 在銲線封裝計有延伸 28 奈米銅製程 / 超低介電係數晶圓之金銲線封裝至更多應用領域與新客戶量產、18 微米線徑銅銲線封裝技術等。(3) 在三維系統封裝計有 300mm 之 28 奈米 3 維晶圓穿導孔覆晶堆疊矽質基板封裝級、RF 無線通訊 Wi-Fi + BT + GPS+ FM 系統模組完整方案、微機電整合封裝等。(4) 在晶圓級封裝計有錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術、40 微米間距銅柱凸塊。(5) 本公司面對全球綠色產品大趨勢所開展之綠色設計策略，是架構在既有綠色封裝產品基礎，輔以生態化設計 (Eco-design)，落實從新產品的開發設計及新技術的導入開始，便加入符合低污染、低耗能及節水等環境友善並兼顧作業安全的設計規範考量。期能提早考慮產品可能之環境衝擊與降低其風險程度。

副董事長　張洪本

「2013 年營業計畫概要」

I　經營方針

（1）提供客戶「至高品質」的服務

（2）為公司及客戶創造長期且穩定的利潤

（3）與協力廠商攜手共創榮景

（4）在營運中儘可能地保持彈性。

II　預期銷售數量及其依據

依據產業景氣、未來市場需求及本公司之產能狀況，

本公司 2013 年預計銷售量如下：

銷售項目	預計銷售數量約
封裝	約 130 億個
測試	約 19 億個

III　重要產銷政策

本公司 2012 年資本支出持續提升，讓產能及技術都已提前就位，隨著 28 奈米製程逐漸成熟、晶圓代工續往 20 奈米製程進一步推展先進封裝需求強勁，且在銅打線製程佈局持續領先，本公司深耕已久的長期技術布局計劃可望逐步進入收成期。2013 年將是銅打線成長基期首度高過金打線，預計 2013 年打線營收必會成長，不再受金、銅打線產品價差之干擾。由於全球景氣動能趨緩，需求走向微利時代，也使得產業結構改變，國際整合元件廠 (IDM) 將不斷釋出相關中低階封裝測試訂單，以提升營運效率，而本公司在這方面的產能建構最完整，且與 IDM 廠關係最緊密，因此最有機會受惠。本公司對封測業後市展望仍看好 IDM 廠委外封測及銅製程需求之增加。本公司深耕 IDM 廠已久，目前 IDM 客戶佔營收比重接近 4 成，本公司有信心拉高 IDM 營運比重且自信競爭力會領先同業，銅製程也將持續拉大與同業的競爭差距。

「未來公司發展策略」

展望 2013 年半導體產業，雖然市場不穩定性仍高，但先進製程產能需求依舊不減；從總經層面來看，儘管半導體產業過去 2 年表現低於預期，隨日本和美國逐步改善，歐洲和中國下行風險暫除，只要國際間沒有重大變盪，Gartner 提具的 2013 年半導體產值年增 4.5% 預估值將可望達標。宏觀經濟環境和封測產業的週期性質一直影響著本公司的淨利潤，不過本公司擴大地區業務、產能和產品組合，進而進入新市場和幫助推進客戶業務的全球戰略被證明非常適合成為本公司持續取得成功的長期發展戰略。很顯然，半導體產業正處於全球技術轉型大浪潮的核心位置，本公司則在這樣的轉型中與機遇同存。本公司在 2012 年繼續擴大業務並實現了將近 5% 的營收同比增長，再次創下新高。本公司對股東、客戶、合作夥伴和員工等一直堅守承諾，這為本公司業務的開展奠定了堅實的基礎，特別是在本公司迎接這個移動通訊時代並相應優化業務活動的時候更是如此。

「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」

就目前形勢而言，延續美國去年面臨財政赤字猛然緊縮 (財政懸崖) 的疑慮，2013 年全球經濟仍具有相當的不確定性，歐債問題短期間似乎無法根本解決、中國經濟前景尚未明朗以及國際主要國家為提振經濟將採行量化寬鬆政策所間接促成熱錢流竄、物價上漲的壓力。我們不得不對 2013 年的經濟表現保守以對。不過，經歷過去兩年之間需求減少、庫存增加的調整期後，相信半導體業在未來幾年將會逐步恢復成長。新興市場對於智慧型手機及平板電腦的需求將會高速成長進而成為半導體業的推升動力。希望本公司全體員工、股東都能更加互信與合作，共同迎接來年挑戰，共享揮汗播種後的美好果實。

經營摘要

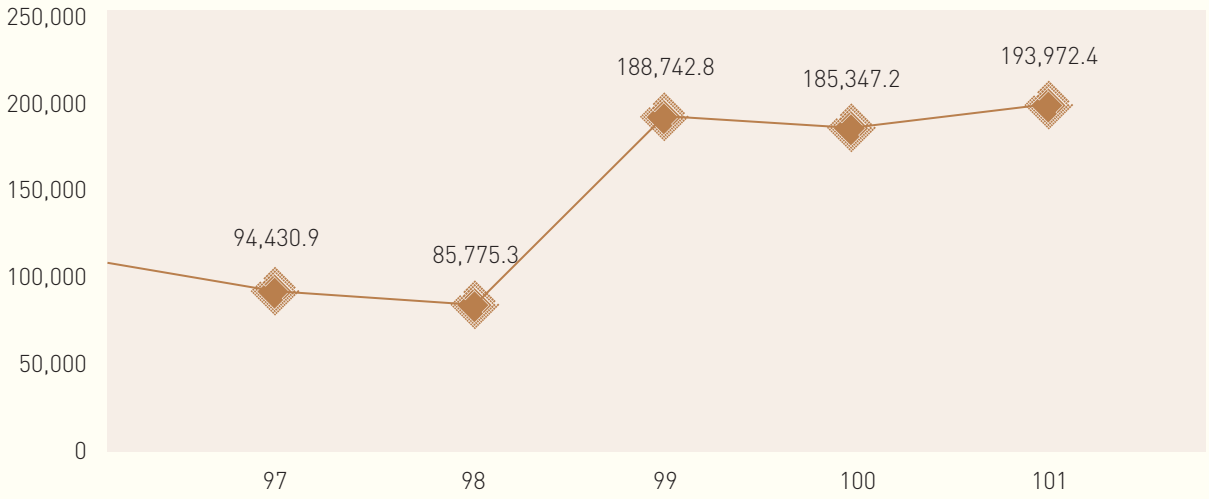
經營摘要（含子公司）	97	98	99	100	101
營業淨收入	94,430.9	85,775.3	188,742.8	185,347.2	193,972.4
營業毛利	21,769.5	18,341.7	40,544.6	35,008.8	36,623.8
營業利益	11,245.4	9,209.8	24,099.0	16,821.3	17,761.4
稅前淨利	9,475.8	8,388.4	22,823.6	16,997.2	16,590.5
稅後淨利	6,160.1	6,903.5	19,194.9	13,978.9	13,548.9
每股盈餘（元／股，追溯調整後之稀釋每股盈餘）	0.80	0.92	2.39	1.78	1.71
現金股利（元／股）	0.49989186	0.35965662	0.64942186	0.64945235	（註 1）
股票股利（元／股）	—	0.9990461805	1.1489771409	1.39882046	（註 1）
固定資產淨額	84,758.0	79,363.9	99,853.9	111,779.0	126,150.3
股東權益淨額	69,672.0	74,713.7	91,839.3	102,282.5	112,459.1
資產總額	152,190.0	161,974.8	208,139.8	223,878.1	246,504.1
員工總數（人）	26,977	29,538	48,901	51,411	57,259
日月光各年總市值（註 2）	67,150.8	158,352.7	203,482.7	172,238.4	191,577.8

註 1：俟股東會決議後定案。
註 2：總市值 = 年底收盤價 * 流通在外股數。

單位：新台幣百萬元

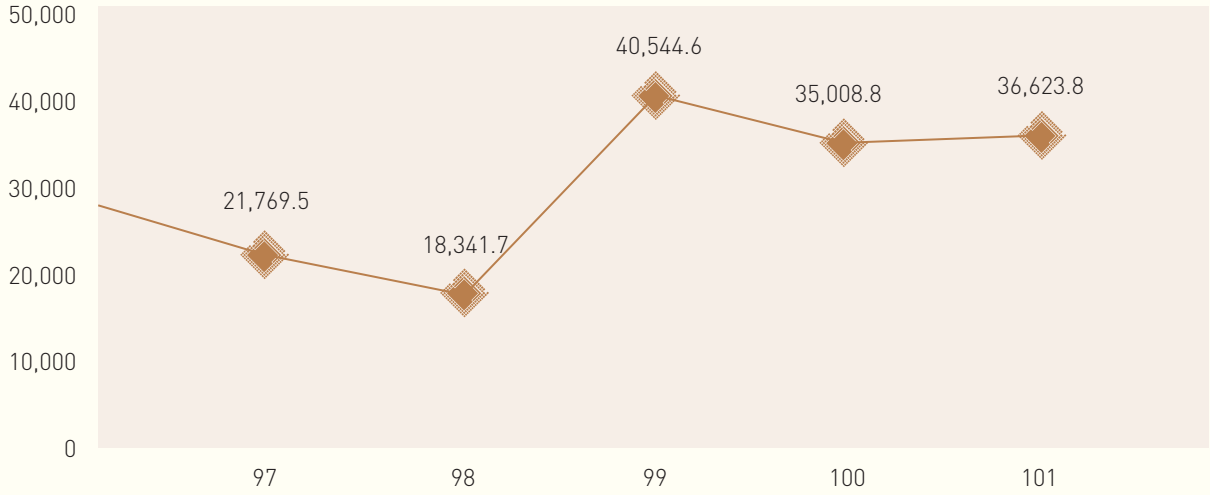
歷年營業淨收入

單位：新台幣百萬元



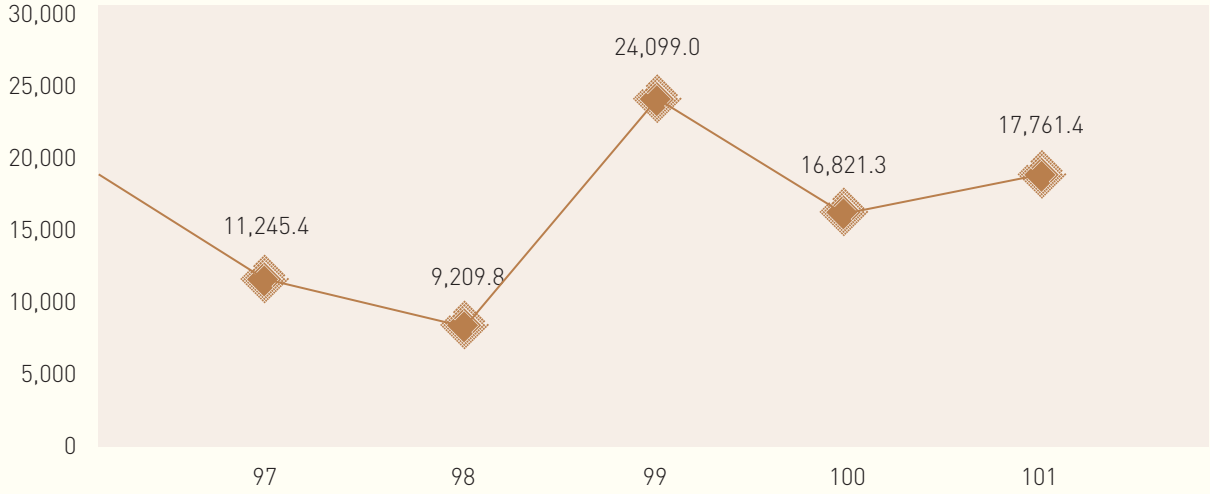
歷年營業毛利

單位：新台幣百萬元



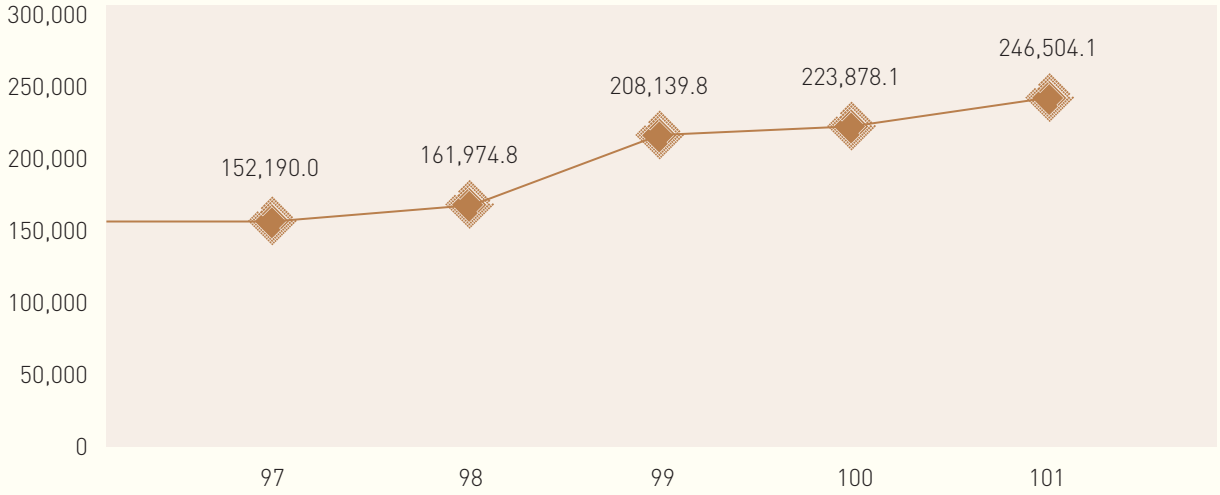
歷年營業利益

單位：新台幣百萬元



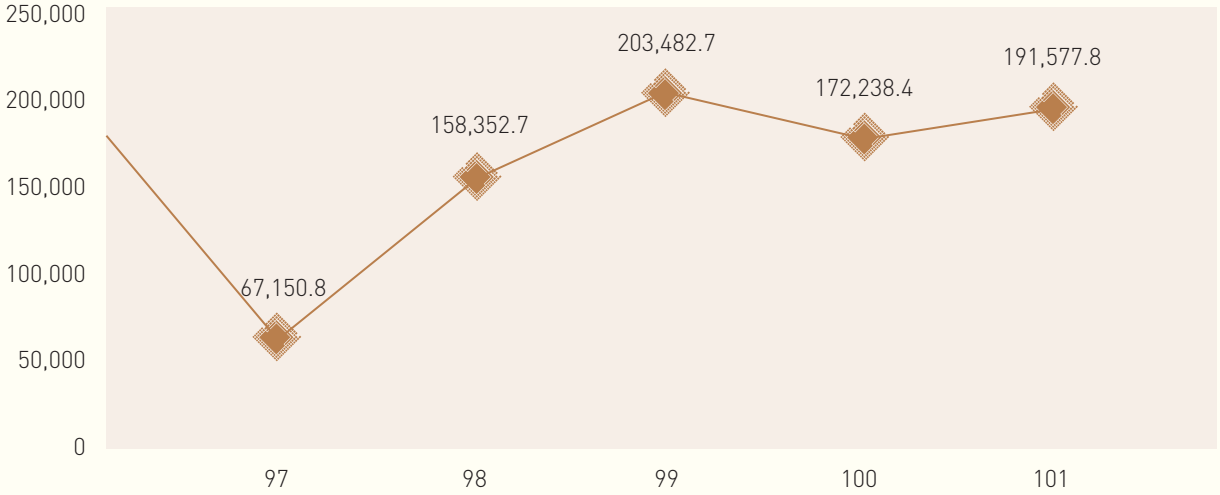
歷年資產總額

單位：新台幣百萬元



歷年日月光總市值

單位：新台幣百萬元



一〇一年度年報

目錄　一〇一年度年報

壹、致股東報告書及經營摘要

2　貳、公司簡介

6　參、公司治理報告
6　一、組織系統
7　二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
17　三、公司治理運作情形
26　四、會計師公費資訊
26　五、更換會計師資訊
27　六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形
27　七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
28　八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
29　九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

30　肆、募資情形
30　一、資本及股份
36　二、公司債辦理情形
37　三、特別股辦理情形
37　四、海外存託憑證辦理情形
38　五、員工認股權憑證辦理情形
39　六、限制員工權利新股辦理情形
39　七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
39　八、資金運用計畫執行情形

40　伍、營運概況
40　一、業務內容
46　二、市場及產銷概況
52　三、從業員工資料
53　四、環保支出資訊
55　五、勞資關係
58　六、重要契約

59　陸、財務概況
59　一、最近五年度簡明資產負債表及損益表
60　二、最近五年度財務分析
62　三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告
63　四、最近年度財務報表
147　五、最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表
157　六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事

158　柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
158　一、財務狀況
158　二、財務績效
158　三、現金流量
159　四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
159　五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
159　六、風險事項分析評估
163　七、其他重要事項

164　捌、特別記載事項
164　一、關係企業相關資料
177　二、私募有價證券辦理情形
178　三、子公司持有或處分本公司股票情形
178　四、其他必要補充說明事項

179　玖、其他事項

貳、公司簡介

一、設立日期：民國七十三年三月二十三日

二、公司沿革：

本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本基於工業報國之精神，並配合政府發展高科技政策，以現金及專門技術作價集資所創建，所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。

本公司記事如下：

73年03月	公司正式成立。
73年07月	工廠開工。
73年08月	塑膠立體型積體電路(PDIP)，開始外銷歐美及日本。
74年02月	陶瓷立體型積體電路(CDIP)，開始外銷日本及歐美。
74年10月	高品質塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC)開始外銷美國。
76年05月	高品質多腳型針格排列積體電路(PGA)及塑膠多腳型針格排列積體電路(PPGA) 開始外銷歐美。
78年5-7月	78年5月25日經證期會(78)台財證(一)字第24594號函核准並經台灣證券交易所(78)上字第4461號函核覆股權分散符合標準，並於同年7月19日正式在台灣證券交易所上市掛牌買賣。
79年03月	收購台灣福雷電子股份有限公司股權百分之九十九點九，計支付價金新台幣105,006,183元，以併購方式進入半導體測試業務市場。
80年03月	轉投資設立日月光電子(馬來西亞)股份有限公司，從事各型積體電路之製造、加工、組合、測試及外銷，另轉投資設立日月光半導體貿易(香港)股份有限公司，以便利轉接海外(馬來西亞)生產基地訂單及服務客戶。
80年08月	新產品平面型塑膠晶粒承載器積體電路(EQFP)開始量產。
80年11月	本公司產品榮獲MOTOROLA公司頒發品質優良獎(Award of Excellence for Quality)。
81年04月	榮獲國際標準組織(ISO 9002)品質認證合格。
84年07月	在亞洲、美國及歐洲等地發行海外存託憑證8,600仟單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行43,000仟股，每股面額10元，售價每單位美金15.25元溢價發行，募集資金折合新台幣33.9億元。
85年06月	本公司之子公司「ASE Test Limited」在美國NASDAQ證券市場掛牌買賣。
86年09月	本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
86年11月	通過SAC(Semiconductor Assembly Council)認證。
87年01月	本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)以1,500,000股普通股發行120,000,000單位之台灣存託憑證(TDR)，並於台灣證券交易所掛牌買賣。
87年03月	榮獲國際標準組織(QS 9000)品質認證合格。
87年09月	榮獲ISO14001環境品質認證合格。
88年03月	本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)第二次以2,500,000股普通股發行台灣存託憑證(TDR)，並於台灣證券交易所掛牌買賣。
88年05月	本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)收購ISE LAB七成股權。
88年07月	日月光集團收購摩托羅拉台灣中壢及南韓PAJU兩廠，藉此更能與摩托羅拉公司進行長期之策略聯盟，強化日月光集團垂直整合的力量，並可擴大產品涵蓋範圍。
88年2-7月	為提昇日月光集團電子專業代工之領域，進一步增加對客戶之服務項目，進而擴大客戶群，遂於88年度自集中交易市場買入環隆電氣股份有限公司股票，參與經營權，持股比率20.67%。
89年09月	為提昇本公司於全球半導體市場之競爭力，進而強化公司形象及國際知名度，於美國時間9月25日完成美國存託憑證(ADR)發行作業，本次發行數量計20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行普通股100,000,000股面額10元，發行價格每單位美金7元，募集資金折合新台幣計43.8億元。
91年09月	榮獲「第十屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。

92年07月　本公司合併持股100%之子公司日月新投資(股)公司及日月興投資(股)公司。

92年09月　本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。

92年10月　本公司董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司，換股比率訂為每1股日月欣半導體股份有限公司股份換發本公司股份0.85股，每1股日月宏科技股份有限公司股份換發本公司股份0.5股，本公司預計將發行282,315,437股以進行合併換股事宜。

93年02月　日月光集團與NEC簽立股權買賣合約，併購該公司位於山形縣之封裝測試廠。

93年07月　本公司於93年6月經董事會決議通過投資設立日月光半導體(昆山)有限公司，投資金額美金壹仟貳佰萬元，並於93年7月23日經投審會核准在案。

93年08月　本公司與子公司日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司正式辦理合併，以本公司為存續公司，並設立中壢分公司。

本公司概括承受原由子公司日月欣半導體股份有限公司投資Omniquest Industrial Limited在大陸地區設立之日月光半導體(上海)(股)公司，並於93年8月10日經投審會核准在案。

本公司於93年7月經董事會決議通過投資設立日月光電子元器件(上海)有限公司，投資金額美金壹仟貳佰萬元，並於93年8月20日經投審會核准在案。

93年11月　本公司於93年9月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於93年11月25日經投審會核准在案。

94年06月　本公司於94年5月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於94年6月30日經投審會核准在案。

94年10月　榮獲「第十三屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。

94年11月　本公司於94年8月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於94年11月2日經投審會核准在案。

本公司於94年11月在菲國總統「國際優良廠商頒獎典禮」頒獎之夜獲頒最高獎項「菲律賓總統獎」。

94年12月　本公司於94年11月經董事會決議通過投資設立日月光高新科技(上海)有限公司，投資金額美金壹仟伍佰萬元，並於94年12月21日經投審會核准在案。

95年03月　本公司以新台幣參仟萬元投資設立「日月光電子股份有限公司」，持股比率為100%。

95年05月　本公司經董事會決議通過將材料事業部分割予子公司日月光電子股份有限公司，換股比例為被分割之材料事業部營業價值每新台幣十元換取日月光電子股份有限公司普通股一股。

95年08月　本公司正式將材料事業部分割予日月光電子股份有限公司，本公司計取得日月光電子股份有限公司普通股294,929,700股。

本公司於95年6月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(昆山)有限公司，並於95年8月1日經投審會核准在案。

95年09月　本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股147,500,000股及147,429,700股，分別轉讓予子公司ASE Labuan Inc.及ASE Mauritius Inc.。

95年12月　本公司於95年11月經董事會決議通過透過子公司J&R Holding Limited以其自有資金美金陸仟萬元，受讓中國大陸地區之現有事業威宇科技測試封裝有限公司100%股權，並於95年12月29日經投審會核准在案。

為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，本公司之子公司ASE Mauritius Inc.將其持有之日月光電子股份有限公司普通股147,429,700股，轉讓予本公司另一子公司ASE Labuan Inc.。

96年06月　本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股3,000,000股，轉讓予子公司ASE Labuan Inc.。

96年07月　本公司於96年3月經董事會決議以海外自有資金美金21,600,000元，透過子公司J&R Holding Limited購買NXP B.V.所持有中國大陸之恩智浦半導體蘇州有限公司60%股權，並於96年7月2日經投審會核准在案。(另於97年3月7日核准更名為蘇州日月新半導體有限公司)

96年08月 本公司為整合集團名稱，將大陸地區投資事業威宇科技測試封裝有限公司名稱更名為「日月光封裝測試(上海)有限公司」，並於96年8月29日經投審會核准在案。

97年02月 本公司於96年10月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司，並於97年2月20日經投審會核准在案。

本公司於97年01月經董事會決議通過以自有資金美金柒佰萬元，透過子公司J&R Holding Limited受讓中國大陸地區之現有事業威海愛一和一電子有限公司100%股權，並於97年2月15日經投審會核准在案。(另於97年5月22日核准更名為日月光半導體(威海)有限公司)。

97年05月 本公司於97年03月經董事會決議通過增資美金玖仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司，並於97年5月16日經投審會核准在案。

本公司於97年04月經董事會決議通過增資金額美金壹仟參佰萬元於日月光半導體(威海)有限公司，並於97年5月22日經投審會核准在案。

97年08月 本公司於97年07月經董事會決議通過增資美金陸佰萬元於日月光電子元器件(昆山)有限公司，並於97年8月7日經投審會核准在案。

97年11月 本公司為維護公司信用及股東權益於97年11月經董事會決議通過實施第一次買回本公司普通股股份144,037,000股並辦理銷除。

98年01月 本公司為維護公司信用及股東權益於98年01月經董事會決議通過實施第二次買回本公司普通股股份73,937,000股並辦理銷除。

98年02月 本公司於97年12月經董事會決議通過增資美金貳仟萬元於日月光半導體(威海)有限公司，並於98年2月4日經投審會核准在案。

98年07月 本公司於98年06月經董事會決議通過增資美金參仟貳佰萬元於日月光半導體(昆山)有限公司，並於98年7月31日經投審會核准在案。

98年11月 本公司於98年11月經董事會決議通過，以現金及子公司J&R Holding Limited及新加坡福雷電子股份有限公司所分別持有之本公司普通股107,308,600股及199,287,400股合計306,596,000股作為對價，對環隆電氣股份有限公司(下稱環隆電氣)之股份進行公開收購。

99年02月 前述共同公開收購案已於99年2月9日完成，本次共收購環隆電氣普通股股份641,669,316股，加計收購前集團原持有普通股股份192,944,213股，完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額78.1%。

99年08月 本公司於99年4月經董事會決議通過同意環隆電氣之股票終止上市申請案，同時承諾收購環隆電氣之股票。本公司已於99年8月5日完成該公開收購案，共收購環隆電氣流通在外股份222,243,661股，加計收購前集團原持有環隆電氣股份834,613,529股，完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額98.9%。

99年11月 本公司為維護公司信用及股東權益於99年11月經董事會決議通過實施第三次買回本公司普通股股份37,000,000股並辦理銷除。

本公司為配合主管機關之政策，於99年11月26日將本公司發行之股票轉換為全面無實體發行。

100年01月 本公司為配合集團營運策略之考量，於100年1月經董事會決議通過設立南投分公司以承接子公司環隆電氣之微電子構裝業務。

100年03月 本公司於99年11月經董事會決議通過透過子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金美金陸仟萬元增資日月光半導體(威海)有限公司，並於100年3月1日經投審會核准在案。

100年08月 本公司發行新臺幣80億元之有擔保普通公司債。

本公司為維護公司信用及股東權益於100年8月經董事會決議通過實施第四次買回本公司普通股股份34,000,000股並辦理銷除。

100年09月 本公司為維護公司信用及股東權益於100年9月經董事會決議通過實施第五次及第六次買回本公司普通股股份分別為50,000,000股及30,000,000股並辦理銷除。

100年11月　本公司為強化與子公司日月鴻科技股份有限公司(以下簡稱「日月鴻」)其資源、人力及技術整合效益之目的，於2011年11月8日經董事會決議通過以每股現金新臺幣18.5元為對價，透過公開收購方式收購除本公司外其他股東所持有之日月鴻普通股，本公司並已於2011年11月18日完成該公開收購案，共收購日月鴻普通股股份105,697,703股，收購金額約新台幣19.6億元，若加計本公司原持有日月鴻55.7%股權計算，本公司持有日月鴻之股權已達99.2%。

100年12月　本公司於100年12月榮獲經濟部頒發「一百年國家發明創作獎之貢獻獎」殊榮。

101年05月　本公司為整合整體資源，提昇營運效益及競爭力於101年3月經董事會決議通過同意以現金合併日月鴻。以本公司為合併後存續公司，日月鴻科技為消滅公司，本合併案之合併基準日為101年5月1日。

101年11月　本公司2011 CSR Report於101年11月榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎—銅獎」之肯定。

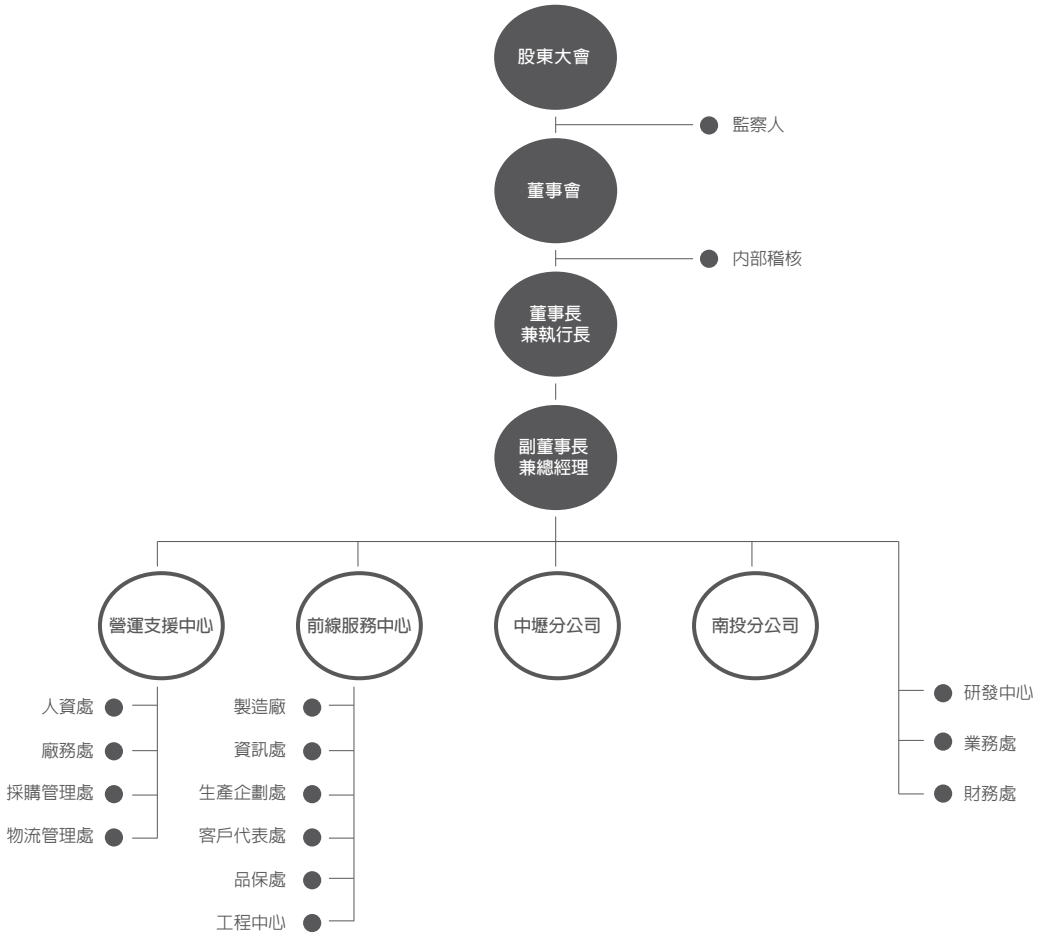
101年12月　本公司於101年12月榮獲經濟部頒發「智慧財產經營管理優質獎：企業組-優質獎及最佳智財報告書」二項殊榮。

本公司K12自2009年建廠規劃導入綠建築標準，以台灣綠建築EEWH"鑽石級"與美國LEED"金級"為設計準則。歷經規劃設計、施工、成效驗證、書面審查及現場查核等過程。順利於2012年12月通過內政部審核並榮獲台灣EEWH 最高等級之鑽石級標章。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構：



(二)主要部門所營業務

〈 **營運支援中心** 〉

人資處：人力資源管理及組織發展

廠務處：廠房及行政區環境保護、庶務管理及工安管制

採購管理處：機台、產品投料之採購、管理及控制

物流管理處：倉儲、進出口業務

〈 **前線服務中心** 〉

製造廠：半導體封裝之代工

資訊處：公司資訊系統建構、推動e化經營策略及系統服務

生產企劃處：生產企劃及營運效率管理

客戶代表處：客戶服務及諮詢

品保處：產品品質檢驗及品質確保

工程中心：基板設計及生產技術開發

〈 **其他** 〉

研發中心：先進技術研究發展

業務處：亞洲、美洲、歐洲等地區業務發展

財務處：財務及會計，包括資金管理、資產管理、成本與管理會計、租稅規劃及股務作業

內部稽核：內部政策、流程及標準稽核

〈 **中壢分公司** 〉

包括行政、人資、財務、品保、生物管、資訊、業務推廣、封裝測試製造廠、策略規劃及客戶關係管理等單位業務。

〈 **南投分公司** 〉

包括人資、總務、財務、品管、營業、產品工程、製造、生物管、資材及工程等單位業務。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事及監察人資料(年報刊印日 102.02.28)

單位：股

職 稱	姓 名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事本人	張洪本 (副董事長)	101.06.22	三年	73.03.11	90,075,058	1.35%	102,994,941	1.35%	121,509,346	1.60%
董事本人	張能傑	101.06.22	三年	98.06.25	1,456,035	0.02%	1,659,708	0.02%	–	–
董事本人	香港商微電子國際公司	101.06.22	三年	80.03.30	1,164,333,431	17.49%	1,327,202,773 (註2)	17.45%	–	–
董事之法人代表人	張虔生 (董事長)									
	吳田玉									
	董宏思									
董事本人	J&R Holding Ltd.	101.06.22	三年	101.06.22	40,972,453	0.62%	46,703,763	0.61%	–	–
董事之法人代表人	羅瑞榮									
	陳昌益									
獨立董事	游勝福	101.06.22	三年	98.06.25	–	–	–	–	4,632	0.00%
獨立董事	徐大麟	101.06.22	三年	98.06.25	–	–	–	–	–	–
監察人本人	張能超	101.06.22	三年	98.06.25	420,974	0.01%	529,860	0.01%	–	–
監察人本人	宏璟建設股份有限公司	101.06.22	三年	98.06.25	75,085,219	1.13%	85,588,293 (註3)	1.13%	–	–
監察人之法人代表人	曾元一									
	潘士華									
	陳天賜									
	李俊哲									

職 稱	姓 名	利用他人名義持有股份(註1)		主要經(學)歷	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
		股數	持股比率	目前兼任本公司及其他公司之職務(註4)	職稱	姓名	關係
董事本人	張洪本 (副董事長)	–	–	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	董事長 監察人	張虔生 張能超	兄 子
董事本人	張能傑	–	–	美國衛斯理大學(Wesleyan University)心理系學士	董事長	張虔生	父
董事本人	香港商微電子國際公司	–	–				
董事之法人代表人	張虔生 (董事長)			台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	副董事長 董事	張洪本 張能傑	弟 子
	吳田玉			美國賓州大學應用機械博士	–	–	–
	董宏思			美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	–	–	–
董事本人	J&R Holding Ltd.	–	–				
董事之法人代表人	羅瑞榮			交通大學電子物理系畢	–	–	–
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	–	–	–
獨立董事	游勝福	–	–	台灣大學商學系會計組 政大會計研究所碩士	–	–	–
獨立董事	徐大麟	–	–	台灣大學物理學學士 美國紐約州布魯克林理工學院電子物理學碩士 美國加州柏克萊分校電機工程博士	–	–	–
監察人本人	張能超	–	–	美國威廉姆斯大學(Williams)經濟系畢	副董事長	張洪本	父
監察人本人	宏璟建設股份有限公司	–	–				
監察人之法人代表人	曾元一			台灣大學土木系畢 亞洲理工學院系統工程碩士 泛亞工程公司董事長 泰國榮泰公司董事長 美國榮工國際公司董事長	–	–	–
	潘士華			美國伊利諾州大學物理系畢 美國加州大學柏克萊分校物理博士	–	–	–
	陳天賜			中原大學工業工程與管理系	–	–	–
	李俊哲			淡江大學航空工業系畢	–	–	–

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。
註2：截至年報刊印日止質押股數為248,471,522股。
註3：截至年報刊印日止質押股數為75,210,000股。

註4：本公司董監事(含經理人)目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

張虔生

日月光半導體製造(股)公司-執行長、董事長及董事(代表人)
日月瑞(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Test Holding, Ltd.-董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Holding Ltd. (Bermuda)-董事
J&R Holding Ltd. (Bermuda)-董事
Innosource Ltd.-董事
日月光半導體(昆山)有限公司-董事
ASE Test Limited (Singapore)-董事長
日月光半導體(上海) (股)公司-董事長及董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事
日月光投資(昆山)有限公司-董事長及董事
洋鼎科技(股)公司-董事
日月光電子(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Mauritius Inc.-董事
ASE Corporation -董事
蘇州日月新半導體有限公司-董事長
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事
ASE Labuan Inc.-董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
ASE Singapore Pte. Ltd.-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
Anstock Limited -董事
環旭電子(股)公司-董事
環隆電氣(股)公司- 董事
Wealthy Joy Co. Ltd-董事
北京鼎固房地產開發有限公司-董事
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事
上海鼎莘房地產開發有限公司-董事
昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事
上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事
上海鼎通房地產開發有限公司-監事
上海鴻翔置業有限公司-監事
上海名龍建設發展有限公司-監事

吳田玉

日月光半導體製造(股)公司-集團營運長及董事(代表人)
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Japan Co., Ltd.-董事
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事
GAPT-Cayman-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事兼總經理
蘇州日月新半導體有限公司-董事
日月光半導體(威海)有限公司-董事

羅瑞榮

日月光半導體製造(股)公司-高雄廠區總經理及董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)及總經理

游勝福

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員
順達科技(股)公司-監察人
華上光電(股)公司-監察人
華信光電科技(股)公司-監察人
三福化工(股)公司-監察人
裕隆汽車製造(股)公司-薪資報酬委員會委員
裕融企業(股)公司-薪資報酬委員會委員
江申工業(股)公司-薪資報酬委員會委員
台光電子材料(股)公司-薪資報酬委員會委員

徐大麟

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員
漢鼎亞太公司總裁暨創辦人
致申科技(股)公司-董事(代表人)

張洪本

日月光半導體製造(股)公司-總經理及副董事長
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
Innosource Ltd.-董事
日月光半導體(上海)(股)公司-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Limited (Singapore) -董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn, Bhd.-董事
ASE Holding Ltd. (Bermuda) -董事
J&R Holding Ltd. (Bermuda) -董事
日月光半導體(昆山)有限公司-董事長及董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事長及董事
洋鼎科技(股)公司-董事
GAPT-Cayman-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事長及董事
ASE Japan Co., Ltd.-董事
日月光半導體(香港)有限公司-董事長及董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
Anstock Limited -董事
RTH公司-董事長及董事
環旭電子(股)公司-董事長及董事
環銓電子(昆山)公司-董事長及董事
環勝電子(深圳)公司-董事長及董事
環鴻電子(股)公司-董事長及董事
環旭科技有限公司-董事長及董事
環鴻科技(股)公司-董事長及董事(代表人)
環誠科技有限公司-董事長及董事
環鴻電子(昆山)有限公司-董事長及董事
環隆電氣(股)公司- 董事長
Sino Horizon Holdings Limited-董事長
Wealthy Joy Co. Ltd-董事
Peak Vision International Limited-董事
Peak Paramount International Limited-董事
Great Sino Development Ltd. -董事
北京鼎固房地產開發有限公司-董事長
上海鼎固房地產開發有限公司-董事長
上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長
上海鼎通房地產開發有限公司-董事長
上海鴻翔置業有限公司-董事長
上海名龍建設發展有限公司-董事長
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長
上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長
上海鼎莘房地產開發有限公司-董事長
昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長
上海日月光百貨有限公司-董事
上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-董事
重慶鼎固物業管理有限公司-總經理
ASE Enterprises-董事
溫地發展有限公司-董事
溫州宏德建設開發有限公司-董事
嘉瑩投資(股)公司-董事
明祥投資(股)公司-董事長
明通投資(股)公司-董事
瑞昌投資(股)公司-監事
嘉慶投資(股)公司-董事
偉東投資(股)公司-董事長
紹昌投資(股)公司-董事
啓昌投資(股)公司-監事
鼎昌投資(股)公司-董事長
萬昌投資(股)公司-董事
萬亞投資(股)公司-董事
鼎固投資(股)公司-監事

董宏思

日月光半導體製造(股)公司-財務長及董事(代表人)
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.-監察人
台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-監察人
Innosource Ltd. -董事
J&R Holding Ltd. (Bermuda) -董事
ASE Investment (Labuan) Inc.-董事
ASE Holding Ltd. (Bermuda) -董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Holding, Ltd.-董事
ASE Test Finance, Ltd.-董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Mauritius Inc.-董事
日月光電子(股)公司-董事(代表人)
日月光電子元器件(昆山)有限公司-監事
ASE Labuan Inc. -董事
ASE Corporation-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Anstock Limited -董事
洋鼎科技(股)公司-監察人
環隆電氣(股)公司-監察人
環旭電子(股)公司-監察人
環鴻科技(股)公司-監察人(代表人)
陸竹開發(股)公司-監察人
H.R.SILVINE-CMC Co., Ltd.-董事
大衆商業銀行-獨立董事

陳昌益

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(昆山)有限公司-董事
ASE Test Limited (Singapore)-董事
ASE Test Holdings Ltd.-董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Investment (Labuan) Inc.-董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-監事
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長及董事
日月光電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(香港)有限公司-董事
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事
蘇州日月新半導體有限公司-董事
上海鼎威房地產開發有限公司-董事長及董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長及董事
昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長及董事
昆山鼎悅房地產開發有限公司-董事長及董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
環隆電氣(股)公司-董事(代表人)
展毅投資(股)公司-董事(代表人)
達基投資(股)公司-董事(代表人)
HHI公司-董事
聯合創業投資(股)公司-董事(代表人)
三商行(股)公司-薪資報酬委員會委員

張能傑

日月光半導體製造(股)公司-董事
日月光半導體(上海)(股)公司-董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事
日月光半導體(昆山)有限公司-監事
日月光投資(昆山)有限公司-董事
日月光半導體(威海)有限公司-董事
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事
上海鼎威房地產開發有限公司-董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事
昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事
昆山鼎悅房地產開發有限公司-董事
環旭電子(股)公司-董事
環隆電氣(股)公司-董事(代表人)
北京鼎固房地產開發有限公司-董事

曾元一

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
宏璟建設(股)公司-董事長
宏錦光(股)公司-董事(代表人)
宏璟新(股)公司-董事長及董事(代表人)
H.R.SILVINE-CMC Co., Ltd.-董事
福華工程(股)公司-董事
Fund Land Croup Limited-董事
Hung Ching Co., Limited-董事
詩肯(股)公司-獨立董事
台灣世曦工程顧問(股)公司-監察人

陳天賜

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(上海)股份有限公司-監事
陸竹開發(股)公司-董事(代表人)
蘇州日月新半導體有限公司-監事

李俊哲

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
日月光半導體(上海)有限公司-董事

潘士華

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
ASE Japan Co., Ltd. -董事
ASE Test Holding, Ltd.-董事
日月光電子(股)公司-監察人(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
洋鼎科技(股)公司-董事
陸竹開發(股)公司-董事(代表人)

張能超

日月光半導體製造(股)公司-監察人
日月光半導體(上海)股份有限公司-董事

俞旭濬

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事
上海鼎威房地產開發有限公司-董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事
昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事
昆山鼎悅房地產開發有限公司-董事
環隆電氣(股)公司-監察人
宏璟建設(股)司-監察人
視元素(股)公司-董事長及董事(代表人)

1.1 董事、監察人為法人股東其主要股東

102年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商微電子國際公司	Aintree Limited	100.00%
J&R Holding Limited	日月光半導體製造股份有限公司	100.00%
宏璟建設股份有限公司	日月光半導體製造股份有限公司	26.22%
	張虔生	16.89%
	張洪本	7.40%
	宏璟新股份有限公司	3.27%
	張姚宏影	2.89%
	匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	2.48%
	明祥投資股份有限公司	2.40%
	張迎申	2.35%
	紹昌投資股份有限公司	2.34%
	偉東投資股份有限公司	2.30%

另法人股東其主要股東為日月光半導體製造(股)公司者，其主要股東詳本年報第34頁。

1.2 董事、監察人為法人股東其主要股東為法人者其上一層主要股東

102年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
Aintree Limited	張虔生	100.00%
宏璟新股份有限公司	宏璟建設股份有限公司	100.00%
明祥投資股份有限公司	嘉瑩投資股份有限公司	99.95%
	張淡榮	0.01%
	張虔生	0.01%
	馮美珍	0.01%
	馮美玲	0.01%
	王永剛	0.01%
	劉小克	0.00%
紹昌投資股份有限公司	嘉瑩投資股份有限公司	99.95%
	張洪本	0.01%
	張淡榮	0.01%
	張虔生	0.01%
	馮美玲	0.01%
	王永剛	0.01%
	劉小克	0.00%
偉東投資股份有限公司	嘉慶投資股份有限公司	99.95%
	張虔生	0.01%
	張淡榮	0.01%
	馮美珍	0.01%
	馮美玲	0.01%
	王永剛	0.01%
	劉小克	0.00%

1.3 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

條件 / 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形				
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	01. 非為公司或其關係企業之受僱人	02. 非公司或其關係企業之董事、監察人	03. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	04. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬	05. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
張虔生			V					
張洪本			V					
吳田玉			V			V	V	V
羅瑞榮			V			V	V	V
董宏思			V				V	V
陳昌益			V			V	V	V
張能傑			V			V		V
游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V
徐大麟			V	V	V	V	V	V
曾元一			V			V	V	V
潘士華			V			V	V	V
陳天賜			V			V	V	V
李俊哲			V			V	V	V
張能超			V			V		V

條件 / 姓名	符合獨立性情形					兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	06. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東	07. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶	08. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	09. 未有公司法第30條各款情事之一	10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選	
張虔生		V		V		0
張洪本		V		V	V	0
吳田玉	V	V	V	V		0
羅瑞榮	V	V	V	V		0
董宏思		V	V	V		1
陳昌益		V	V	V		0
張能傑	V	V		V	V	0
游勝福	V	V	V	V	V	0
徐大麟	V	V	V	V	V	0
曾元一		V	V	V		1
潘士華	V	V	V	V		0
陳天賜	V	V	V	V		0
李俊哲	V	V	V	V		0
張能超	V	V		V	V	0

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股(截至年報刊印日止實際持有股數)

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份	
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
執行長	張虔生	92.05	80,915,931	1.06%	—	—	1,658,908,250 (註1)	21.81%
總經理	張洪本	92.02	102,994,941	1.35%	121,509,346	1.60%	—	—
集團營運長及總經理	吳田玉	96.02	3,633,386	0.05%	—	—	—	—
高雄廠區總經理	羅瑞榮	95.04	2,565,643	0.03%	1,182	0.00%	—	—
總經理	唐和明	96.01	2,021,551 (註2)	0.03%	—	—	—	—
財務長	董宏思	83.12	3,831,908	0.05%	274,915	0.00%	—	—
副總經理	唐國安	87.02	0	—	—	—	—	—
副總經理	俞旭濬	88.08	351,259	0.00%	—	—	—	—
副總經理	陳道有	93.01	552,127	0.01%	—	—	—	—
副總經理	李世文	93.01	636,234	0.01%	—	—	—	—
副總經理	林顯堂	93.01	832,839	0.01%	14,372	0.00%	—	—
副總經理	林國堂	93.08	1,587,773	0.02%	3,242	0.00%	—	—
副總經理	莫煥華	93.08	342,858	0.00%	—	—	—	—
副總經理	葉清昆	93.08	158,622	0.00%	—	—	—	—
副總經理	藍詩融	93.08	571,120	0.01%	—	—	—	—
副總經理	曾和帝	95.06	339,193	0.00%	—	—	—	—
副總經理	鄭楨銘	95.07	65,416	0.00%	—	—	—	—
副總經理	洪松井	100.01	318,275	0.00%	—	—	—	—
副總經理	曹燕傑	101.12	0	—	—	—	—	—
分公司經理人	沈文智	102.01	260,380	0.00%	—	—	—	—

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
				職稱	姓名	關係
執行長	張虔生	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	請參閱第8頁	副董事長 董 事	張洪本 張能傑	弟 子
總經理	張洪本	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	請參閱第8頁	董事長 監察人	張虔生 張能超	兄 子
集團營運長及總經理	吳田玉	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第8頁	—	—	—
高雄廠區總經理	羅瑞榮	交通大學電子物理系畢	請參閱第8頁	—	—	—
總經理	唐和明	美國哥倫比亞大學化工博士	台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)	—	—	—
財務長	董宏思	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	請參閱第9頁	—	—	—
副總經理	唐國安	國立中央大學管理學碩士 矽品精密工業品保副總	無	—	—	—
副總經理	俞旭濬	國立藝專廣播電視科 東森傳播公司副總經理 鑫凱傳播公司總經理	請參閱第9頁	—	—	—
副總經理	陳道有	成功大學機械系畢	無	—	—	—
副總經理	李世文	成功大學物理系畢	無	—	—	—
副總經理	林顯堂	中山大學EMBA碩士	無	—	—	—
副總經理	林國堂	崑山工專電子科畢	無	—	—	—
副總經理	莫煥華	伯明罕大學機械工程所	無	—	—	—
副總經理	葉清昆	東吳大學物理系	無	—	—	—
副總經理	藍詩融	休士頓大學企研所	無	—	—	—
副總經理	曾和帝	中原大學工業工程與管理系	無	—	—	—
副總經理	鄭楨銘	淡江大學機械工程系	無	—	—	—
副總經理	洪松井	德州大學機械博士	無	—	—	—
副總經理	曹燕傑	文化大學物理系	無	—	—	—
分公司經理人	沈文智	淡江大學航海系	無	—	—	—

註1：其中設質股數為248,471,522股。
註2：其中設質股數為1,590,000股。

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

3.1 董事之酬金

101年12月31日
單位：仟股；新台幣仟元

本公司	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)(註3)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事本人	張洪本(副董事長)												
董事本人	張能傑												
董事本人	香港商微電子國際公司												
董事之法人代表人	張虔生(董事長)												
	吳田玉												
	董宏思	—	—	—	—	183,232	183,232	—	—	1.40%	1.35%	87,430	156,719
董事本人	J&R Holding Limited												
董事之法人代表人	羅瑞榮												
	陳昌益												
獨立董事	游勝福												
獨立董事	徐大麟												

本公司	姓名	兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		退職退休金(F)(註2)		盈餘分配員工紅利(G)(註1)				員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)				
				本公司		財務報告內所有公司								
		本公司	財務報告內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
董事本人	張洪本(副董事長)													
董事本人	張能傑													
董事本人	香港商微電子國際公司													
董事之法人代表人	張虔生(董事長)													
	吳田玉													
	董宏思	1,330	1,776	60,009	—	72,751	—	36,590仟股	49,790仟股	—	—	2.54%	3.06%	無
董事本人	J&R Holding Limited													
董事之法人代表人	羅瑞榮													
	陳昌益													
獨立董事	游勝福													
獨立董事	徐大麟													

註1： 本公司董事會於102年4月8日決議，擬訂101年度董監酬勞為新台幣228,000仟元，董事之金額為新台幣183,000仟元，員工紅利新台幣1,147,223仟元(全部以現金發放)，惟截至刊印日止本次員工紅利配發名單尚未決定，茲以去年員工紅利之實際配發比例估算擬議配發數如上，上述盈餘分配內容俟本年度股東會決議通過後才確定。

註2： 本公司101年度實際給付退職退休金金額為0元；該欄退職退休金金額全數屬退職退休金費用化之提列(提撥)數。

註3： 本欄位未包含本公司及財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣23,780仟元及新台幣92,618仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司I	本公司	財務報告內所有公司J
低於2,000,000元	–	–	–	–
2,000,000元(含)～5,000,000元	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟
5,000,000元(含)～10,000,000元	–	–	–	–
10,000,000元(含)～15,000,000元	–	–	陳昌益	–
15,000,000元(含)～30,000,000元	張虔生、張洪本、吳田玉、羅瑞榮、董宏思、陳昌益、張能傑	張虔生、張洪本、吳田玉、羅瑞榮、董宏思、陳昌益、張能傑	張能傑	張能傑
30,000,000元(含)～50,000,000元	–	–	吳田玉、羅瑞榮、董宏思	羅瑞榮、董宏思、陳昌益
50,000,000元(含)～100,000,000元	–	–	張洪本	張洪本、吳田玉
100,000,000元以上	–	–	張虔生	張虔生
總計	–	–	–	–

3.2 監察人之酬金

101年12月31日
單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)(註1)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人本人	張能超	–	–	9,349	9,349	–	–	0.07%	0.07%	無
監察人本人	宏璟建設股份有限公司	–	–	37,394	37,394	–	–	0.29%	0.28%	無
監察人之法人代表人	曾元一									
	潘士華									
	陳天賜									
	李俊哲									

註1：本公司董事會於102年4月8日決議，擬訂101年度董監酬勞為新台幣228,000仟元，監察人擬配發之金額為新台幣45,000仟元，俟本年度股東會決議通過後才確定。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司D
低於2,000,000元	–	–
2,000,000元(含)～5,000,000元	–	–
5,000,000元(含)～10,000,000元	曾元一、潘士華、陳天賜、李俊哲、張能超	曾元一、潘士華、陳天賜、李俊哲、張能超
10,000,000元(含)～15,000,000元	–	–
15,000,000元(含)～30,000,000元	–	–
30,000,000元(含)～50,000,000元	–	–
50,000,000元(含)～100,000,000元	–	–
100,000,000元以上	–	–
總計	–	–

3.3 總經理及副總經理之酬金

101年12月31日
單位：仟股；新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		盈餘分配之員工紅利金額(D)(註1)			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司	
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額
執行長	張虔生	121,740	181,455	2,913	3,360	36,541	45,224	81,616	—	94,357	—
總經理	張洪本										
集團營運長及總經理	吳田玉										
高雄廠區總經理	羅瑞榮										
總經理	唐和明										
財務長	董宏思										
副總經理	唐國安										
副總經理	俞旭濬										
副總經理	陳道有										
副總經理	李世文										
副總經理	林顯堂										
副總經理	林國堂										
副總經理	莫煥華										
副總經理	葉清昆										
副總經理	藍詩融										
副總經理	曾和帝										
副總經理	鄭楨銘										
副總經理	洪松井										
副總經理	曹燕傑										
分公司經理人	沈文智										

職稱	姓名	A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額		取得限制員工權利新股		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
執行長	張虔生	1.85%	2.39%	41,773仟股	54,948仟股	—	—	無
總經理	張洪本							
集團營運長及總經理	吳田玉							
高雄廠區總經理	羅瑞榮							
總經理	唐和明							
財務長	董宏思							
副總經理	唐國安							
副總經理	俞旭濬							
副總經理	陳道有							
副總經理	李世文							
副總經理	林顯堂							
副總經理	林國堂							
副總經理	莫煥華							
副總經理	葉清昆							
副總經理	藍詩融							
副總經理	曾和帝							
副總經理	鄭楨銘							
副總經理	洪松井							
副總經理	曹燕傑							
分公司經理人	沈文智							

註1：詳第13頁註1及註2之說明。
註2：本欄位未包含本公司及財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣26,867仟元及新台幣95,687仟元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於2,000,000元	曹燕傑、沈文智	曹燕傑、沈文智
2,000,000元(含)～5,000,000元	葉清昆、李世文	葉清昆、李世文
5,000,000元(含)～10,000,000元	俞旭濬、鄭楨銘、洪松井、林國堂、莫煥華、曾和帝、陳道有、林顯堂、藍詩融、唐國安	鄭楨銘、洪松井、林國堂、莫煥華、曾和帝、陳道有、林顯堂、藍詩融、唐國安
10,000,000元(含)～15,000,000元	–	俞旭濬
15,000,000元(含)～30,000,000元	吳田玉、羅瑞榮、董宏思、唐和明	董宏思、羅瑞榮、唐和明
30,000,000元(含)～50,000,000元	張虔生、張洪本	張虔生、吳田玉
50,000,000元(含)～100,000,000元	–	張洪本
100,000,000元以上	–	–
總計	–	–

3.4 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

101年12月31日
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額(註1)	現金紅利金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
經理人	執行長	張虔生	–	81,616	81,616	0.62%
	總經理	張洪本				
	集團營運長及總經理	吳田玉				
	高雄廠區總經理	羅瑞榮				
	總經理	唐和明				
	財務長	董宏思				
	副總經理	唐國安				
	副總經理	俞旭濬				
	副總經理	陳道有				
	副總經理	李世文				
	副總經理	林顯堂				
	副總經理	林國堂				
	副總經理	莫煥華				
	副總經理	葉清昆				
	副總經理	藍詩融				
	副總經理	曾和帝				
	副總經理	鄭楨銘				
	副總經理	洪松井				
	副總經理	曹燕傑				
	分公司經理人	沈文智				

註1： 詳第13頁註1之說明。

(四) 分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

年度 / 占稅後損益比例	一〇一年度		一〇〇年度	
項目	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事、監察人酬金總額(註2)	2.89%	3.40%	3.36%	4.51%
總經理及副總經理酬金總額(註2)	1.85%	2.39%	2.49%	3.71%

本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過，另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較，確保薪酬的競爭性，其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之目的。

董事、監察人酬勞之擬訂，係依有純益年度之分配順序，將酬勞明訂於本公司章程中。

註2：本公司董事會於102年4月8日決議，擬訂101年度提撥員工紅利新台幣1,147,223仟元，全部以現金發放，惟截至刊印日止本次員工紅利配發名單尚未決定，故酬金總額之計算員工紅利金額係以去年實際配發比例估算擬議配發數。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會13(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註1)	備註
董事本人	張洪本(副董事長)	2	10	15%	註1： 實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
董事本人	張能傑	5	0	38%	
董事之法人 (香港商微電子國際公司) 代表人	張虔生(董事長)	4	8	31%	
	吳田玉	7	2	54%	
	董宏思	13	0	100%	
董事之法人 (J&R Holding Ltd.) 代表人	羅瑞榮	5	2	38%	
	陳昌益	2	1	15%	
獨立董事	游勝福	11	0	85%	
獨立董事	徐大麟	1	11	8%	

其他應記載事項：董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

董事會日期期別	議案內容	董事會決議結果	公司對獨立董事陳述意見之處理
101.03.29 101年度第3次董事會議	擬訂定本公司獨立董事之薪資報酬及修訂本公司「公司章程」。 董事對利害關係議案迴避之執行情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人及徐大麟董事皆為獨立董事，明顯與會議內容有自身利害關係，本人(含代理徐大麟董事)將迴避不參與討論及表決本議案，請各位董事自行討論。	經主席徵詢出席董事，除游勝福董事(含代理徐大麟董事)迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事全體無異議照案通過。	不適用。
101.05.02 101年度第5次董事會議	擬審查本公司持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單 董事對利害關係議案迴避之執行情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人及徐大麟董事皆為本案被審查之獨立董事候選人當事人，與本案有自身利害關係，故本人(含代理徐大麟董事)將迴避不參與討論及表決本案，請各位董事自行討論。	經主席徵詢出席董事，除游勝福董事(含代理徐大麟董事)迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事全體無異議照案通過。	不適用。
101.09.27 101年度第10次董事會議	為擬訂定本公司一OO年度盈餘分配之經理人員工紅利分配明細議案。 董事對利害關係議案迴避之執行情形： 董宏思董事發言摘要－因本人董宏思與張虔生董事、張洪本董事、吳田玉董事均為本公司之經理人，明顯與本案討論有關訂定本公司一OO年度盈餘分配其經理人員工紅利分配明細之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人(含代理張虔生董事)及吳田玉董事(含代理張洪本董事)均迴避不參與討論及表決本議案，請其餘出席董事自行討論。	經其餘三席無利害關係之出席董事張能傑董事、游勝福董事及徐大麟董事全體無異議照案通過。	不適用。
101.09.27 101年度第10次董事會議	為擬訂定本公司一OO年度盈餘分配之董監事酬勞分配明細議案。 董事對利害關係議案迴避之執行情形： 董宏思董事發言摘要－因本人董宏思及張虔生董事、吳田玉董事所代表之法人香港商微電子國際公司與張洪本董事、張能傑董事均為本公司一OO年度盈餘分配其董監事酬勞擬配發之對象，明顯與本案之會議內容有利害關係，為避免利益衝突，本人(含代理張虔生董事)、吳田玉董事(含代理張洪本董事)及張能傑董事均迴避不參與討論及表決本議案，請其餘出席董事自行討論。	經其餘二席無利害關係之出席游勝福董事及徐大麟董事全體無異議照案通過。	不適用。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

審計委員會運作情形資訊：本公司依臺灣之證交法應於現任監察人任期屆滿時(民國104年)設置審計委員會，惟為配合ADR上市之相關規定，本公司業已依美國沙氏法案設置符合其規定之審計委員會。

監察人參與董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會13次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出列席次數B	實際列席率(%)(B/A)(註1)	備註
監察人本人	張能超	0	0%	連任
監察人之法人代表人(宏璟建設股份有限公司)	曾元一	1	8%	連任
	潘士華	3	23%	新任(註2)
	陳天賜	1	8%	連任
	李俊哲	4	31%	新任(註2)
監察人之法人代表人(台灣福雷電子股份有限公司)	何 弘	3	50%	舊任(註3)
	劉曉明	0	0%	舊任(註3)

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

本公司目前尚無設置審計委員會(由全體獨立董事組成)以代替監察人之情事。

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(如溝通管道、方式等)：

目前公司之員工及股東均直接與本公司溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)：

每季度結束後，內部稽核主管會彙總上一季度所查核的稽核事項及缺失，於定期董事會中報告，本公司並於會後將相關資料併同董事會議紀錄e-mail予全體董監事參閱。根據公司法第219條監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊應予查核，本公司監察人若對於財務報表有疑問會直接與會計師聯繫並溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：不適用。

註1：實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

註2：為101.06.22新上任監察人，最近年度可列席董事會開會次數僅為7次。

註3：為101.06.21舊任監察人，最近年度可列席董事會開會次數僅為6次。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益		
(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	本公司設有法人關係、公共關係及法務等相關部門專人負責處理股務等相關事宜。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形	本公司每月均經由董監事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東之名單，並經由與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	透過內部控制制度及相關辦法之制定及落實，稽核單位並定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、董事會之組成及職責		
(一) 公司設置獨立董事之情形	本公司已選任獨立董事二位。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司均定期評估簽證會計師的獨立性，目前本公司之簽證會計師與公司、董事及監察人均非關係人，獨立性並無疑慮。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司責成相關單位專責處理債權人、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜，員工亦設有工會及總經理信箱不定期與公司溝通。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、資訊公開		
(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司已架設網站，並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務情形，網址為http://www.aseglobal.com	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	本公司指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊並依相關規定發佈重大訊息。 本公司設有發言人及代理發言人制度，並於本公司之網站上揭露相關資訊。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司依臺灣之證交法應於現任監察人任期屆滿時(民國104年)設置審計委員會，惟為配合ADR上市之相關規定，本公司業已依沙氏法案設置審計委員會。 為配合美為配合美國證管會之規定，由董事會指派符合1934年美國證交法規則10A-3規定之獨立董事擔任本公司審計委員會之委員。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司目前係遵照相關法令執行相關作業並依公司治理守則之精神改善中，未來將考量實際運作情形及內外部環境之評估作為訂定公司治理實務守則之依據。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)

- 本公司承諾做好綠色產品設計製造與本質安全流程規劃，致力降低營運中可能產生的環境衝擊、人員危害與經營風險，並提供員工一個安全舒適的工作環境。
- 恪遵環保、安全、綠色產品與社會責任等永續發展相關之法令規章或要求，並尊重國際條例及其解釋。
- 在勞動權益上，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以保障員工就業自由、職場平等及預防傷害事故與職業疾病的發生。
- 在資訊保密上，尊重、保護國際上與客戶之任何技術、專門技能、文件與資料，要求員工或供應商遵守相關保密協定，並落實保全管理，以確保公司與客戶資料之機密安全。
- 在環境管理上，導入綠色設計、綠色材料與綠色製程及製造，有效降低產品對環境的衝擊。並持續推動能源節約、污染預防與資源再利用，以強化管理成效。
- 妥善運用教育訓練資源，提昇員工對環保、安全、綠色產品與社會責任等永續發展各面向的意識與職能，並定期與員工及其代表溝通與諮詢，以確保管理系統持續運作。
- 持續改善永續發展管理機制以成就管理績效，並且確信所有問題均可經由完善管理系統的運作達到控制，進而保障利害關係人的權益。
- 積極辦理與參與公開活動，主動對利害關係人傳達我們積極邁向永續發展的決心，並透過輔導、溝通與宣導，鼓勵產業鏈上下游共同推動永續發展各管理系統，以促進產業鏈之永續經營。
- 本公司會與供應商簽訂供應商保密條款 / GP Warranty Letter / 稀土與衝突礦產聲明書/供應與承攬商社會責任承諾書，採購合約中明定具法律效力的權利與義務，且明定供應商遴選制度，確保供應商能符合本公司的品質政策、環境政策，並訂定供應商稽核制度以確保執行。為此本公司體認與社會上利害關係各方進行長期對話之必要性。此方式能增進企業對社會的瞭解，做出最佳決策，還能減少企業與社會之衝突。
- 董事及監察人進修之情形： 101年度董事及監察人進修情形如下表：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
法人董事代表人(兼經理人)	董宏思	101/10/25	101/10/25	金融監督管理委員會	第八屆台北公司治理論壇	3.0	是
		101/12/27	101/12/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	IFRS財務報表分析	3.0	是
		101/12/27	101/12/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	從「公司治理」談稅務管理	3.0	是
		101/12/28	101/12/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	投資大陸相關法令限制與實務因應做法	3.0	是
		101/12/28	101/12/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	司法判例會計主管涉嫌「經濟犯罪」風險與法律責任	3.0	是
獨立董事	徐大麟	101/05/18	101/05/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市公司獨立董事職能說明及座談會	3.0	是

- 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險(101年保險金額約為7億3仟萬元)。
- 本公司業已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：本公司無公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告。

(四) 薪酬委員會其組成、職責及運作情形：

本公司為落實公司治理，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，於民國100年9月29日爰依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設立薪資報酬委員會，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中至少一人為本公司獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，對外代表本委員會。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本屆薪資報酬委員會成員資料：

身份別	條件 / 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註)								兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	4	
獨立董事	徐大麟			V	V	V	V	V	V	V	V	V	–	
其他	谷小瑛			V	V	V	V	V	V	V	V	V	–	

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打勾。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8) 未有公司法第30條各款情事之一。

本屆委員任期：101年06月22日至104年06月21日，截至102年2月28日，已開會3次，委員出列席情形如下：

職稱	身份別	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	獨立董事	游勝福	3	100
委員	獨立董事	徐大麟	1	33
委員	其他	谷小瑛	2	67

(五) 履行社會責任情形：(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。)

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理		
(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。	本公司董事會督促公司實踐社會責任及檢討實施成效。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。	本公司設有專職單位負責企業社會責任之推動並做成報告。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	本公司定期召開與企業社會責任有關會議並宣導企業倫理。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
二、發展永續環境		
(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。	本公司規劃了電力、水資源與耗用材料的管理機制，並持續進行供應設施效率提升或模組最佳化的改善，以達到減少用電的目標，包含空調節能、照明節能、製程節能…等。 本公司有計劃的執行各項資源使用管理，對於能源、水資源做最佳化使用與持續改善。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。	本公司在環境保護業務上的執行，除了符合法律及相關規範外，同時建立ISO14001環境管理系統。建立ISO14001環境管理系統，除定期查核是否符合法令要求外，每年訂定污染防治與設備改善計劃，有效降低污染排放並檢討環境管理制度。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。	本公司設立環境管理專責單位，配合最佳可行性控制技術(BACT)的選用、確保污染防治設備正常運作與主動將廢棄物資源化，以有效降低對環境的衝擊。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	本公司注意氣候變遷對營運活動之影響，除推行ISO 50001能源管理系統、ISO 14064溫室氣體管理系統，每年均進行溫室氣體盤查外，並訂定溫室氣體減量目標，以進行溫室氣體減量。為回應客戶及全球消費大衆對低碳產品的期待，導入PAS 2050產品碳足跡盤查，並以降低產品碳足跡為目標。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
三、維護社會公益		
(一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。	本公司導入SA 8000社會責任管理制度、EICC電子行業行為準則、訂定相關政策，並取得驗證單位證書。並尊重基本勞動人權、遵守政府勞動法規、保障員工工作環境、健康安全等相關權益。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	本公司訂有安全衛生業務之執行，導入OHSAS 18001職業安全衛生管理系統與TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統，提供員工一個符合安衛法規且健康的最佳作業場所。本公司設有員工診所定期安排所有員工進行各單位所需之健康檢查。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三) 公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。	我們重視合諧的勞資關係，日月光集團各廠均提供員工暢通、多元化的溝通管道，為了形塑合諧的勞資關係，我們有暢通的溝通及申訴管道，提供各部門員工表達意見或建議，方式及管道包括了勞資會議，總經理信箱、各廠區意見箱、座談會、信函投書、公佈欄、日月光通訊、內部公文、教育訓練、電子佈告欄、員工諮商室及電子郵件等，真誠的傾聽員工的心聲和建議，讓公司與員工的距離更接近。 若任何工作有重大異動(如營運據點調動…等)，皆事先與員工溝通並至至少於2週前通知，且無任何強迫勞動情況發生。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(四) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。	本公司設有客戶服務專業專責團隊，定期檢視客戶的滿意度，提供相關客戶的意見反應與溝通服務。並以網際網路為基礎，建置客戶線上服務平台，整合客戶簡易的服務網路，提供完整的線上供應鏈資訊，致力於提供客戶最好且高效率之服務。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(五) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。	本公司視供應商/承攬商為重要合作夥伴，不定期舉辦供應商永續發展相關教育訓練課程，除宣導溝通公司政策及作法，並告知希望供應商配合達成之事項，也與供應商凝聚永續發展的共識，建構完整綠色半導體供應鏈群聚。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	本公司長期透過「日月之光慈善事業及日月光文教基金會」關懷活動，致力投入社區發展及參與各項社會公益活動，長期致力於回饋社會，深化社區參與行動，並結合慈善團體回饋社會。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
四、加強資訊揭露		
(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。	本公司為讓社會大眾瞭解公司在因應永續發展趨勢的思維與承諾，對外公開公司永續報告書。本報告書符合GRI G3 A+ 應用等級，並取得BSI外部第三方查證聲明書。 本公司於2012年發行日月光集團永續報告書，對外揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	本公司有關企業社會責任之報告書(日月光集團永續報告書)內容充分揭露記載以下事項：環境永續、員工關懷、客戶服務、社會參與及供應鏈溝通管理等。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司目前係遵照上述守則及相關法令執行相關作業並依公司社會責任實務守則之精神改善中，未來將考量實際運作情形及內外部環境之評估作為訂定公司社會責任實務守則之依據。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：

- 有關企業社會責任運作情形之資訊，請詳日月光集團永續報告書(http://www.aseglobal.com)。
- 企業社會責任運作目標：經營社會企業、推動志工活動並幫助更多社會的弱勢族群。公司員工慷慨地奉獻時間、善款及專業技能，主動協助解決急難救助、學童教育等問題，為公司履行社會責任參與承諾的最大支柱。公司期望與廠區週邊的鄰居及社會大眾，藉由長期的合作及溝通，能產生互信、互助及融洽的關係，創造正面積極並對社會有益的商業環境。
- 創造就業機會。
- 積極回饋地方：1.不定期捐款回饋政府及地方團體。2.與大專院校合作進行「產學合作」。3.捐贈機台給大專院校。4.設立南區菁英獎學金。(101年度捐贈的政府及地方團體有台灣電路板協會、中華民國新聞記者協會、國立中山大學、國立成功大學、高雄市體育會龍舟委員會、中華民國科技管理協會、國立台灣大學醫學院附設醫院等贊助金額約為新台幣715萬元)。
- 成立日月光文教基金會積極參與全國性之公益活動(中華文化總會、世界孩童棒球基金會、南臺灣文化暨經濟產業聯盟協會)等贊助金額約為新台幣668萬元。
- 成立高雄市日月之光慈善會參與地區性公益活動(101年度舉辦的活動經費總計約為新台幣1,002萬元)條列主要活動如下：
  1. 清寒學子脫貧計畫－助學金(對象：鄰近廠區國小、國中及高中清寒學生共計1,272人次)經費近新台幣217萬元。
  2. 日月之光課後照顧中心－寶貝熊 (對象：國小一年級～六年級鄰近廠區貧困、單親、隔代教養原著民等弱勢家庭學童)經費約新台幣126萬元。
  3. 社會公益活動(對象：捐助弱勢機構、社會公益活動、捐贈醫療器材及經費、捐血活動等)經費約新台幣168餘萬元。
  4. 社會救助(包括慰問金、急難扶助金等。對象：突逢變故之家庭及個案)經費約新台幣136萬元。
  5. 品格教育希望工程、親職教育講座、夏(冬)令營、親子聯誼活動(對象：快樂熊、寶貝熊及活力熊課後照顧中心之學生與家長)經費近新台幣355萬元。
- 積極參與地方活動：日月光中壢廠參與桃園縣政府2012年萬人CPR挑戰金氏世界紀錄活動。

七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：日月光集團永續報告書符合GRI G3 A+ 應用等級，並通過查證取得BSI外部第三方查證聲明書。

八、揭露溫室氣體排放及減量資訊：本公司編製公開揭露溫室氣體排放及減量資訊於日月光集團永續報告書中，請詳本公司網站 http://www.aseglobal.com。

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

項目	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案		
(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。	為強化公司對誠信經營之決心與承諾，未來將於公司相關規章及對外文件中，特別明示公司誠信經營之政策。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。	目前公司尚未明定方案內之作業程序等，但在工作紀律倫理中訂定道德規範，督促所有員工應確實遵守。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	本公司嚴格禁止董事、監察人、經理人及受僱人等，直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立營業行為。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
二、落實誠信經營		
(一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。	本公司於商業往來前，會先對商業往來對象進行徵信，排除有不誠信行為紀錄之對象，並於商業契約中明訂誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。	本公司未來將逐步設置推動企業誠信經營之專職單位。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。	本公司董事秉持高度自律對董事會議案與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，討論及表決時應予迴避，董事間亦不得不當相互支援。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	本公司設有健全之會計制度及內部控制制度，不允許有外帳或保留秘密帳戶，為確保該制度之設計及執行持續有效，內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	本公司尚未建立檢舉管道及申訴制度。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
四、加強資訊揭露		
(一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。	目前公司已於年報揭露誠信經營運作情形，未來將於公司網站同步設置相關訊息。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。	目前公司並未有採行其他資訊揭露之方式。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：不適用。		
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：無。		

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司並未訂定公司治理實務守則。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

日月光半導體製造股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一〇二年四月八日

本公司民國一〇一年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2風險評估及回應，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一〇一年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國一〇二年四月八日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

日月光半導體製造股份有限公司

董事長： 張虔生　　總經理： 張洪本

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
101.06.21 召開101年股東常會	1. 承認本公司一〇〇年度決算表冊案。	1. 不適用。
	2. 承認本公司一〇〇年度盈餘分派案。	2. 已依通過後內容執行。
	3. 本公司擬以盈餘及資本公積轉增資發行新股案	3. 已依通過後內容辦理相關程序。
	4. 本公司辦理海外私募轉換公司債案。	4. 已依通過後內容辦理相關程序。
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	5. 已依修訂後運作。
	6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。	6. 已依修訂後運作。
	7. 修訂本公司「股東會議事規則」。	7. 已依修訂後運作。
	8. 修訂本公司「公司章程」。	8. 已依修訂後運作。
	9. 提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。	9. 已依同意內容運作。

董事會之重要決議

開會日期	重要決議
101.03.13	決議通過承認本公司民國一〇〇年度營業報告書及財務報表。
101.03.29	1. 決議通過以現金合併日月鴻科技股份有限公司。 2. 決議通過承認本公司民國一〇〇年度盈餘分派議案。 3. 決議通過本公司以盈餘轉增資發行新股。 4. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 6. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 決議通過修訂本公司獨立董事之薪資報酬。 8. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 9. 決議通過改選本公司董事及監察人。 10. 決議通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制。 11. 決議通過本公司民國一〇一年股東常會召開之日期、地點及議程。
101.04.11	決議通過本公司及子公司編製採用國際財務報導準則後對首次轉換至國際財務報導準則日合併財務報告重要項目可能產生之影響金額。
101.05.02	1. 決議通過本公司持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單。 2. 決議通過本公司擬辦理海外私募轉換公司債。 3. 決議通過修訂本公司民國一〇一年股東常會之會議議程。 4. 決議通過本公司為因應未來產能擴充之需求，向宏璟建設股份有限公司購入新建廠辦大樓。
101.06.22	1. 選任本公司董事長及副董事長案。 2. 決議委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
101.08.03	決議通過本公司以每股新台幣18.2元之對價，向本公司100%持股之子公司J&R Holding Limited、A.S.E. Holding Limited及ASE Test Limited購買其所持有之環隆電氣股份有限公司股份。
101.09.27	1. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 2. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 3. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
101.12.13	決議通過追認本公司於101年12月5日第四次參與投資認購元隆電子股份有限公司101年度第二次私募普通股4,084,111股，投資總金額為新台幣18,378,500元整。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊：

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
勤業衆信聯合會計師事務所	龔俊吉	邱慧吟	101.01.01~101.03.31	
勤業衆信聯合會計師事務所	陳珍麗	龔俊吉	101.04.01~101.12.31	

單位：新台幣仟元

金額級距 ＼ 公費項目		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於2,000千元	－	－	－
2	2,000千元(含)～4,000千元	－	2,092	2,092
3	4,000千元(含)～6,000千元	－	－	－
4	6,000千元(含)～8,000千元	－	－	－
5	8,000千元(含)～10,000千元	－	－	－
6	10,000千元(含)以上	39,213	－	39,213
合計		39,213	2,092	41,305

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小 計		
勤業衆信聯合會計師事務所	龔俊吉/邱慧吟	$39,213	－	$190	－	$1,902	$2,092	101.01.01~101.12.31	非審計公費之其他服務內容，包括稅務諮詢及其他等。
	陳珍麗/龔俊吉								

註：非審計公費按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者，應於備註欄列示其服務內容。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	一〇一年六月二十七日		
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業衆信聯合會計師事務所龔俊吉及邱慧吟兩位會計師為之，因該事務所內部業務調整，故改委由該所之陳珍麗及龔俊吉兩位會計師續為之		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 ＼ 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	(不適用)	
	不再接受(繼續)委任		
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無		
	說明：不適用		

更換日期	一〇一年六月二十七日
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業衆信聯合會計師事務所
會計師姓名	陳珍麗、龔俊吉
委任之日期	一〇一年六月二十七日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目之第三點事項復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：不適用。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 持股及設質股數變動情形

職稱	姓　名	一〇一年底止		一〇二年截至二月底止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事本人及大股東	香港商微電子國際公司	162,869,342	8,000,000	–	–
董事本人	張洪本(副董事長兼總經理)	12,919,883	–	–	–
董事本人	張能傑	203,673	–	–	–
董事之法人代表人	張虔生(董事長及執行長)	10,350,795	–	–	–
	吳田玉(集團營運長及總經理)	745,875	–	–	–
	董宏思(財務長)	628,148	–	–	–
董事本人	J&R Holding Ltd.	46,703,763	–	–	–
董事之法人代表人	羅瑞榮(高雄廠區總經理)	864,846	–	–	–
	陳昌益	283,941	–	–	–
獨立董事	游勝福	–	–	–	–
獨立董事	徐大麟	–	–	–	–
監察人本人	張能超	108,886	–	–	–
監察人本人	宏璟建設(股)公司	10,503,074	5,879,000	–	–
監察人之法人代表人	曾元一	84,775	–	–	–
	潘士華(註一)	–	–	–	–
	陳天賜	(335,257)	–	–	–
	李俊哲(註一)	–	–	–	–
總經理	唐和明	248,077	–	–	–
副總經理	唐國安	–	–	–	–
副總經理	俞旭濬	94,833	–	–	–
副總經理	陳道有	245,483	–	–	–
副總經理	李世文	228,076	–	–	–
副總經理	林顯堂	268,659	–	–	–
副總經理	林國堂	194,845	–	–	–
副總經理	莫煥華	63,666	–	–	–

職稱	姓　名	一〇一年底止		一〇二年截至二月底止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
副總經理	葉清昆	19,465	–	–	–
副總經理	藍詩融	70,085	–	–	–
副總經理	曾和帝	41,624	–	–	–
副總經理	鄭楨銘	10,236	–	(18,000)	–
副總經理	洪松井	116,258	–	–	–
副總經理	曹燕傑(註二)	–	–	–	–
分公司經理人	沈文智(註二)	–	–	–	–

註一：係101年6月新上任之監察人 ；
註二：係101年12月及102年1月新上任之經理人

2.股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

3.股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

102年1月18日(註) 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
香港商微電子國際公司	1,327,202,773	17.458	–	–	–	–	張洪本	張洪本為該公司董事	–
							馮美珍	馮美珍為該公司董事之配偶	
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	541,778,660	7.127	–	–	–	–	–	–	–
匯豐銀行託管價值投資公司摩根士丹利國際有限公司	321,454,196	4.228	–	–	–	–	–	–	–
中華郵政股份有限公司	153,535,936	2.020	–	–	–	–	–	–	–
公務人員退休撫卹基金管理委員會	129,367,455	1.702	–	–	–	–	–	–	–
馮美珍	121,509,346	1.598	102,994,941	1.355	–	–	張洪本	配偶	–
							香港商微電子國際公司	馮美珍為該公司董事之配偶	
勞工保險基金	116,175,828	1.528	–	–	–	–	–	–	–
匯豐(台灣)銀行託管法國巴黎銀行香港分行	104,883,500	1.380	–	–	–	–	–	–	–
張洪本	102,994,941	1.355	121,509,346	1.598	–	–	馮美珍	配偶	–
							香港商微電子國際公司	張洪本為該公司董事	
舊制勞工退休基金	99,089,154	1.303	–	–	–	–	–	–	–

註：總股數之計算基礎係以截至101年12月31日止本公司員工因行使員工認股權增加之股數，即於102年1月18日辦理變更登記後之流動在外股數。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

綜合持股比例

101年12月31日　單位：股：%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股　數	持股比例	股　數	持股比例	股數	持股比例
J&R Holding Ltd. (Bermuda)	435,128	100.00%			435,128	100.00%
ASE Holding Ltd. (Bermuda)	243,966	100.00%			243,966	100.00%
Omniquest Industrial Limited	250,504,067	70.63%	104,200,000	29.37%	354,704,067	100.00%
Innosource Limited	86,000,000	100.00%			86,000,000	100.00%
ASE MS Japan Co., Ltd.	1,200	100.00%			1,200	100.00%
台灣福雷電子公司	361,460,000	100.00%			361,460,000	100.00%
環隆電氣(股)公司	1,209,573,053	99.18%			1,209,573,053	99.18%
洋鼎科技(股)公司	23,318,400	100.00%			23,318,400	100.00%
宏璟建設(股)公司	68,629,782	26.22%	64,128,521	24.50%	132,758,303	50.72%
宏錦光(股)公司	39,047,000	27.31%	90,744,000	63.46%	129,791,000	90.77%
陸竹開發(股)公司	209,462,630	84.25%			209,462,630	84.25%
晶錡科技(股)公司	2,000,000	33.33%			2,000,000	33.33%

註：係公司之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

股份種類

101.12.31

股份種類	核定股本					轉換公司債可轉換股份總數	保留員工認股權憑證總數
	流通在外股份			未發行股份	合計		
	已上市	未上市	合計				
普通股	7,602,121,666股	0股	7,602,121,666股	1,897,878,334股	9,500,000,000股	600,000,000股	800,000,000股

(一)股本來源

單位：股/新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
73.03	—	17,200,000	172,000,000	10,000,000	100,000,000	設立(現金)	無	民國73年3月23日 經加處(73)設字第414號
73.05	—	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資100,000,000	無	民國73年5月10日 經加處(73)商字第3956號
73.06	—	23,520,000	235,200,000	23,520,000	235,200,000	現金增資35,200,000	技術股 35,200,000	民國73年6月20日 經加處(73)商字第5246號
75.08	—	33,121,625	331,216,250	33,121,625	331,216,250	現金增資96,016,250	無	民國75年8月12日 經加處(75)商字第7725號
77.06	—	39,495,000	394,950,000	39,495,000	394,950,000	盈餘增資63,733,750	無	民國77年6月14日 經加處(77)商字第5457號
77.09	—	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘增資105,050,000	無	民國77年9月20日 經加處(77)商字第8760號
79.01	—	62,000,000	620,000,000	62,000,000	620,000,000	盈餘增資120,000,000	無	民國79年1月31日 經加處(79)商字第0184號
80.01	—	75,024,000	750,240,000	75,024,000	750,240,000	盈餘及員工紅利增資 117,840,000 資本公積轉增資 12,400,000	無	民國80年1月7日 經加處(80)商字第000046號
80.08	—	125,000,000	1,250,000,000	105,607,373	1,056,073,730	盈餘及員工紅利增資 80,761,730 資本公積轉增資 225,072,000	無	民國80年8月15日 經加處(80)商字第006582號
81.05	38	125,000,000	1,250,000,000	125,000,000	1,250,000,000	現金增資 193,926,270	無	民國81年5月18日 經加處(81)商字第004195號
81.10	—	150,600,000	1,506,000,000	150,600,000	1,506,000,000	盈餘及員工紅利增資 68,500,000 資本公積轉增資 187,500,000	無	民國81年10月24日 經加處(81)商字第009364號
82.09	—	165,660,000	1,656,600,000	165,660,000	1,656,600,000	資本公積轉增資 150,600,000	無	民國82年9月10日 經加處(82)商字第007782號
83.05	—	260,000,000	2,600,000,000	233,824,000	2,338,240,000	盈餘及員工紅利增資 491,131,000 資本公積轉增資 190,509,000	無	民國83年5月30日 經加處(83)商字第4655號
84.02	60	260,000,000	2,600,000,000	260,000,000	2,600,000,000	現金增資 261,760,000	無	民國84年2月6日 經加處(84)商字第000907號
84.05	—	500,000,000	5,000,000,000	356,800,000	3,568,000,000	盈餘及員工紅利增資 760,000,000 資本公積轉增資 208,000,000	無	民國84年5月26日 經加處(84)商字第4553號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
84.07	79.7	500,000,000	5,000,000,000	399,800,000	3,998,000,000	現金增資 430,000,000	無	民國84年7月29日 經加處(84)商字第6711號
85.06	—	1,000,000,000	10,000,000,000	729,000,000	7,290,000,000	盈餘及員工紅利增資 2,092,600,000 資本公積轉增資 1,199,400,000	無	民國85年6月14日 經加處(85)商字第5658號
86.06	—	1,400,000,000	14,000,000,000	1,017,000,000	10,170,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,640,700,000 資本公積轉增資 1,239,300,000	無	民國86年6月11日 經加處(86)商字第005745號
87.05	—	2,200,000,000	22,000,000,000	1,780,000,000	17,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,409,600,000 資本公積轉增資 1,220,400,000	無	民國87年5月8日 經加處(87)商字第4310號
88.08	—	2,200,000,000	22,000,000,000	1,980,000,000	19,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,483,800,000 資本公積轉增資 516,200,000	無	民國88年8月11日 經加處(88)三商字第8494號
89.06	—	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,355,086	19,803,550,860	海外可轉換公司債轉換 普通股本 3,550,860	無	民國89年6月1日 經加處(89)三商字第005552號
89.09	—	3,200,000,000	32,000,000,000	2,652,000,000	26,520,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,716,449,140	無	民國89年9月17日 經加處(89)三資字第09740號
89.10	43.81	3,200,000,000	32,000,000,000	2,752,000,000	27,520,000,000	現金增資發行海外存託憑證 1,000,000,000	無	民國89年10月23日 經加處(89)三商字第011577號
90.08	—	4,150,000,000	41,500,000,000	3,254,800,000	32,548,000,000	盈餘及員工紅利增資 5,028,000,000	無	民國90年8月10日 經加三資字第0900007451號
92.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	3,580,280,000	35,802,800,000	盈餘轉增資 97,644,000 資本公積轉增資 3,157,156,000	無	民國92年9月18日 經加三商字第09200088290號
93.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	3,862,595,437	38,625,954,370	合併增資 2,823,154,370	無	民國93年9月3日 經加三商字第09301027080號
93.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,000,000	41,000,000,000	盈餘轉增資 2,219,773,600 員工紅利轉增資 154,272,030	無	民國93年9月15日 經加三商字第09300078780號
94.01	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,660,600	41,006,606,000	員工認股權憑證轉換 6,606,000	無	民國94年1月 31 日 經加三商字第09400004370號
94.04	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,111,728,800	41,117,288,000	員工認股權憑證轉換 110,682,000	無	民國94年4月 21 日 經加三商字第09400032410號
94.07	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,113,744,200	41,137,442,000	員工認股權憑證轉換 20,154,000	無	民國94年7月 21 日 經加三商字第09400059920號
94.09	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,550,532,800	45,505,328,000	盈餘轉增資 2,878,547,980 員工紅利轉增資 255,674,600 資本公積轉增資 1,233,663,420	無	民國94年9月 29 日 經加三商字第09400084400號
94.10	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,557,372,300	45,573,723,000	員工認股權憑證轉換 68,395,000	無	民國94年10月 21 日 經加三商字第09400091660號
95.01	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,563,877,540	45,638,775,400	員工認股權憑證轉換 65,052,400	無	民國95年01月 19 日 經加三商字第09500005220號
95.04	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,573,895,020	45,738,950,200	員工認股權憑證轉換 100,174,800	無	民國95年04月 24 日 經加三商字第09500030630號
95.07	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,577,568,780	45,775,687,800	員工認股權憑證轉換 36,737,600	無	民國95年07月 19 日 經加三商字第09500059250號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
95.10	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,592,508,620	45,925,086,200	員工認股權憑證轉換 149,398,400	無	民國95年10月 17 日 經加三商字第09500088730號
96.01	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,611,311,450	46,113,114,500	員工認股權憑證轉換 188,028,300	無	民國96年01月 18 日 經加三商字第09600005130號
96.04	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,629,639,544	46,296,395,440	海外無擔保可轉換公司債轉換39,956,440及員工認股權憑證轉換 143,324,500	無	民國96年04月 20 日 經加三商字第09600034690號
96.07	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,645,295,431	46,452,954,310	海外無擔保可轉換公司債轉換85,688,270及員工認股權憑證轉換 70,870,600	無	民國96年07月 23 日 經加三商字第09600063120號
96.09	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,392,899,352	53,928,993,520	盈餘轉增資 6,941,010,710 員工紅利轉增資 535,028,500	無	民國96年09月 12 日 經加三商字第09600079950號
96.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,447,558,879	54,475,588,790	海外無擔保可轉換公司債轉換251,542,070及員工認股權憑證轉換 295,053,200	無	民國96年10月 23 日 經加三商字第09600090450號
97.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,466,030,849	54,660,308,490	海外無擔保可轉換公司債轉換145,603,600及員工認股權憑證轉換 39,116,100	無	民國97年01月 22 日 經加三商字第09700004950號
97.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,476,949,209	54,769,492,090	海外無擔保可轉換公司債轉換19,863,200及員工認股權憑證轉換 89,320,400	無	民國97年04月 22 日 經加三商字第09700033570號
97.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,484,848,118	54,848,481,180	海外無擔保可轉換公司債轉換61,524,590及員工認股權憑證轉換 17,464,500	無	民國97年07月 24 日 經加三商字第09700063360號
97.08	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,681,934,764	56,819,347,640	資本公積轉增資 1,094,938,940 員工紅利轉增資 383,205,000 及盈餘轉增資 492,722,520	無	民國97年08月 28 日 經加三商字第09700077400號
97.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,427,734	56,904,277,340	海外無擔保可轉換公司債轉換32,763,800及員工認股權憑證轉換 52,165,900	無	民國97年10月 21 日 經加三商字第09700094250號
98.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,742,134	56,907,421,340	員工認股權憑證轉換 3,144,000	無	民國98年01月 19 日 經加三商字第09800005500號
98.03	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,546,705,134	55,467,051,340	註銷庫藏股 1,440,370,000	無	民國98年03月 16 日 經加三商字第09800023510號
98.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,547,064,694	55,470,646,940	員工認股權憑證轉換 3,595,600	無	民國98年04月 22 日 經加三商字第09800037010號
98.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,127,694	54,731,276,940	註銷庫藏股 739,370,000	無	民國98年07月 14 日 經加三商字第09800065960號
98.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,529,914	54,735,299,140	員工認股權憑證轉換 4,022,200	無	民國98年07月 21 日 經加三商字第09800068350號
98.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,479,878,254	54,798,782,540	員工認股權憑證轉換 63,483,400	無	民國98年10月 20 日 經加三商字第09800103260號
99.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,488,458,214	54,884,582,140	員工認股權憑證轉換 85,799,600	無	民國99年01月 25 日 經加三商字第09900005410號
99.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,495,212,494	54,952,124,940	員工認股權憑證轉換 67,542,800	無	民國99年04月 23 日 經加三商字第09900039480號
99.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,499,659,994	54,996,599,940	員工認股權憑證轉換 44,475,000	無	民國99年07月 19 日 經加三商字第09900075180號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
99.08	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,049,157,072	60,491,570,720	資本公積轉增資 879,195,320 股東股息紅利轉增資 4,615,775,460	無	民國99年08月 09 日 經加三商字第09900084320號
99.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,051,987,182	60,519,871,820	員工認股權憑證轉換 28,301,100	無	民國99年10月 22 日 經加三商字第09900113120號
100.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,029,118,452	60,291,184,520	員工認股權憑證轉換 141,312,700 註銷庫藏股 370,000,000	無	民國100年01月 19 日 經加三商字第10000006520號
100.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,050,060,512	60,500,605,120	員工認股權憑證轉換 209,420,600	無	民國100年04月 21 日 經加三商字第10000043460號
100.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,052,219,212	60,522,192,120	員工認股權憑證轉換 21,587,000	無	民國100年07月 21 日 經加三商字第10000083030號
100.08	—	9,500,000,000	95,000,000,000	6,747,954,872	67,479,548,720	股東股息紅利轉增資 6,957,356,600	無	民國100年08月 30 日 經加三商字第10000101280號
100.10	—	9,500,000,000	95,000,000,000	6,753,563,242	67,535,632,420	員工認股權憑證轉換 56,083,700	無	民國100年10月 19 日 經加三商字第10000124020號
101.01	—	9,500,000,000	95,000,000,000	6,650,130,772	66,501,307,720	員工認股權憑證轉換 20,425,300 註銷庫藏股 1,054,750,000	無	民國101年01月 19 日 經加三商字第10100007740號
101.04	—	9,500,000,000	95,000,000,000	6,654,716,832	66,547,168,320	員工認股權憑證轉換 45,860,600	無	民國101年04月 20 日 經加三商字第10100043500號
101.07	—	9,500,000,000	95,000,000,000	6,657,855,052	66,578,550,520	員工認股權憑證轉換 31,382,200	無	民國101年07月 24 日 經加三商字第10100081100號
101.09	—	9,500,000,000	95,000,000,000	7,589,454,606	75,894,546,060	股東股息紅利轉增資 9,315,995,540	無	民國101年09月 04 日 經加三商字第10100099460號
101.10	—	9,500,000,000	95,000,000,000	7,594,149,626	75,941,496,260	員工認股權憑證轉換 46,950,200	無	民國101年10月 18 日 經加三商字第10100117650號
102.01	—	9,500,000,000	95,000,000,000	7,602,121,666	76,021,216,660	員工認股權憑證轉換 79,720,400	無	民國102年01月 18 日 經加三商字第10200007680號

(二)股東結構

102年01月18日(註1)

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計(註2)
人數(人)	7	2	389	208,249	881	209,528
持有股數(股)	382,069,413	69,318,758	899,344,761	1,755,259,913	4,496,128,821	7,602,121,666
持股比例(%)	5.026	0.912	11.830	23.089	(註3)59.143	100.000

註1：係股務代理公司所提供最近期之資料。
註2：包含一〇一年十二月三十一日止，因員工行使認股權於一〇二年一月十八日辦理變更登記後所發行之股數。
註3：其中陸資持股比例為0.05%

(三)股權分散情形

1. 普通股股權分散情形

每股面額十元：102年01月18日(註1)

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1～999	67,605	21,535,159	0.283
1,000～5,000	82,174	198,577,614	2.612
5,001～10,000	26,647	186,051,626	2.447
10,001～15,000	12,802	156,022,850	2.052
15,001～20,000	5,400	93,385,393	1.228
20,001～30,000	5,638	137,089,993	1.803

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
30,001～40,000	2,901	100,167,091	1.318
40,001～50,000	1,398	62,716,015	0.825
50,001～100,000	2,660	180,190,793	2.370
100,001～200,000	1,193	161,982,803	2.131
200,001～400,000	472	130,441,481	1.716
400,001～600,000	153	75,460,513	0.993
600,001～800,000	79	54,492,295	0.717
800,001～1,000,000	47	41,562,458	0.547
1,000,001以上	359	6,002,445,582	78.958
合計	209,528	7,602,121,666	100.000

2. 特別股股權分散情形：不適用。

(四)主要股東名單

102年01月18日(註)

主要股東名稱 ＼ 股份	持有股數	持股比例
香港商微電子國際公司	1,327,202,773	17.458
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	541,788,660	7.127
匯豐銀行託管價值投資公司摩根士丹利國際有限公司	321,454,196	4.228
中華郵政股份有限公司	153,535,936	2.020
公務人員退休撫卹基金管理委員會	129,367,455	1.702
馮美珍	121,509,346	1.598
勞工保險基金	116,175,828	1.528
匯豐(台灣)銀行託管法國巴黎銀行香港分行	104,883,500	1.380
張洪本	102,994,941	1.355
舊制勞工退休基金	99,089,154	1.303

註：總股數之基礎係依本公司員工截至101年12月31日止因行使員工認股權增加之股數(即以102年1月18日辦理變更登記後之流通在外股數)。

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利

單位：新台幣元

項目 ＼ 年度			一〇〇年度	一〇一年度	一〇二年截至年報刊印日止
每股市價	追溯前	最高	37.80	31.20	27.00
		最低	23.75	20.05	23.50
	追溯後	最高	33.16	註1	註1
		最低	20.84	註1	註1
	平均		30.42	25.82	24.85
每股淨值	分配前		15.51	14.69	註5
	分配後		14.85	註1	註5
每股盈餘	加權平均股數		7,700,036,280股	7,575,895,842股	7,578,748,975股
	每股盈餘(稀釋)	追溯前	2.03	1.71	註5
		追溯後	1.78	註1	註5
每股股利	現金股利		0.64945235	註1	—
	無償配股	盈餘配股	1.39882046	註1	—
		資本公積配股	—	註1	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬分析	本益比(註2)		14.98	15.10	註5
	本利比(註3)		46.84	註1	—
	現金股利殖利率(註4)		0.02	註1	—

註1：俟股東會決議後定案。
註2：本益比=當年度平均收盤價/每股盈餘
註3：本利比＝當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。
註4：現金股利殖利率＝每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。
註5：尚未完成盈餘結算。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策：

本公司於民國九十八年六月二十五日經股東會通過修訂之股利政策如下：

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

(1) 本公司董事會於102年4月8日提議本次分派股東紅利新台幣7,987,973,811元，每股配發1.05元，全數以現金方式發放。有關上項股東股利之配息率及配股率係依據本公司102年3月28日之股東名簿所記載之股數7,607,594,106股計算，嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

(2) 本次股東會擬議股利分配之情形俟股東常會通過並報請主管機關核准增資後，授權由董事會另訂除權配股基準日，新股之權利義務與原發行之股份相同，屆時將另行公告。

(3) 為配合兩稅合一實施，本次盈餘分派案優先分配最近年度盈餘。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明分配之情形：不適用。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國一〇二年度財務預測資訊。)

(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 本公司公司章程於民國九十七年六月十九日股東會後所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍如下：

依本公司章程第二十三條規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

(1) 彌彌補虧損。

(2) 提存10%為法定盈餘公積。

(3) 依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。

(4) 長期投資依權益法計算之投資收益內屬現金股利以外未實現部分，得就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

如尚有盈餘分派如下：

(5) 董事、監察人酬勞金就依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥2%(含)以下。

(6) 員工紅利係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥7%(含)以上，10%(含)以下，其中7%部份係按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其超過7%部份則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。

(7) 其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總額比例分派之。

上開第(6)款所稱之員工，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。

一〇一年度應付員工紅利及董事監察人酬勞之估列金額分別為新台幣1,178,222,351元及235,644,470元，分別按稅後淨利(已扣除員工紅利及董監酬勞之金額)之10%及2%計算。董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

本公司102年4月8日董事會通過101年度盈餘分派案如下：

(1) 擬議配發員工現金紅利新台幣1,147,223,000元及董事監察人酬勞金額新台幣228,000,000元。上述擬配發金額與原已費用化之員工紅利1,178,222,351元及董事監察人酬勞235,644,470元，差異數共計38,643,821元。差異原因係會計估計調整之差異，差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若股東會決議日時，金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

(2) 擬議配發員工股票紅利金額0元，占本期稅後純益及員工紅利合計數之比例0%。

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.73元。

4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

本公司101年6月21日股東常會通過100年度盈餘分派案及實際配發情形：

(1) 實際配發員工紅利新台幣1,235,336,000元及董事監察人酬勞金額新台幣246,000,000元。

(2) 上述實際分派金額與原已費用化之員工紅利1,362,577,938元，董事監察人酬勞272,515,588元，差異數共計153,757,526元。

差異原因： 會計估計調整。

處理情形： 差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若股東會決議日時，金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

(九)公司買回本公司股份情形：公司最近年度及截至年報刊印日止並未買回本公司股份。

二、公司債辦理情形：

(一)公司債發行情形

102年2月28日

公司債種類	一〇〇年度有擔保普通公司債
發行日期	民國100年8月19日
面額	新台幣5,000萬元
發行及交易地點	中華民國櫃檯買賣中心
發行價格	依票面金額十足發行
總額	新台幣80億元
利率	固定年利率1.45%
期限	5年，到期日：民國105年8月19日
保證機構	本公司債甲券委由臺灣銀行股份有限公司、乙券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、丙券委由合作金庫商業銀行股份有限公司、丁券委由第一商業銀行股份有限公司、戊券委由華南商業銀行股份有限公司共五家銀行依履行公司債保證契約保證。(註1)
受託人	台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構	無
簽證律師	現代法律事務所
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所
償還方法	各券均為五年到期乙次還本
提前買回金額	無
未償還本金	新台幣80億元

公司債種類		一〇〇年度有擔保普通公司債
贖回或提前清償之條款		本公司與各保證銀行及受託人分別簽訂「委任保證契約」及「受託契約」並依各保證銀行及受託人所規定之違約事件發生時，各保證銀行得向公司債持有人(或受託人)提前償付全部公司債。(即違約事件發生時，本公司債即視為全部到期)
限制條款		一般限制條款
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		註2
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

註1: 一〇〇年度有擔保普通公司債各券券別及發行金額如下：

幣別：新台幣元

券別	發行金額
甲券	參拾億
乙券	貳拾億
丙券	拾億
丁券	拾億
戊券	拾億

註2: 一〇〇年度有擔保普通公司債各券信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果

評等機構名稱	券別	保證機構	評等日期	評等等級
中華信評	甲券	臺灣銀行股份有限公司	101/10/08	twAAA
	乙券	兆豐國際商業銀行股份有限公司	101/10/19	twAA+
	丙券	合作金庫商業銀行股份有限公司	102/02/26	twAA
	丁券	第一商業銀行股份有限公司	101/09/18	twAA
	戊券	華南商業銀行股份有限公司	101/06/26	twAA

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

102年截至年報刊印日止 單位：美金元

發行(辦理)日期 / 項目	89 年 9 月	92 年 6 月
發行(辦理)日期	民國89年9月	民國92年6月
發行及交易地點	美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所
發行總金額	美金140,000仟元	美金86,808仟元
單位發行價格	每單位美金7元	每單位美金2.65元
發行單位總數	20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股	32,757,600單位，每單位表彰本公司普通股5股
表彰有價證券之來源	本公司現金增資發行之普通股	本公司股東所持有本公司已發行之普通股
表彰有價證券之數額	本公司普通股100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整	本公司普通股163,788,000股，每股面額新台幣壹拾元整
存託憑證持有人之權利與義務	享有與本公司普通股股東相同之權利義務	

受託人			無
存託機構			花旗銀行
保管機構			花旗銀行台北分行
未兌回餘額			迄年報刊印日止，海外存託憑證流通在外餘額為104,275,800單位，表彰本公司普通股521,379,005股。
發行及存續期間相關費用之分攤方式			無
存託契約及保管契約之重要約定事項			無
每單位市價	101年度	最 高	5.40
		最 低	3.44
		平 均	4.32
	102年截至年報刊印日止	最 高	4.65
		最 低	3.89
		平 均	4.04

五、員工認股權憑證辦理情形：

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，業經主管機關分別於九十一年八月、九十三年五月、九十六年十一月及九十九年四月核准發行第一次員工認股權憑證160,000,000單位、第二次員工認股權憑證140,000,000單位、第三次員工認股權憑證200,000,000單位及第四次員工認股權憑證200,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。

(一) 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

102年02月28日

員工認股權憑證種類	第一次員工認股權憑證		第二次員工認股權憑證		第三次員工認股權憑證	第四次員工認股權憑證	
	第一次發行	第二次發行	第一次發行	第二次發行		第一次發行	第二次發行
申報生效日期	91/08/28		93/05/27		96/11/22	99/04/20	
發行(辦理)日期	91/12/24	92/08/22	93/06/30	94/05/23	96/12/19	99/05/06	100/04/15
董事會決定發行單位數	160,000,000單位		140,000,000單位		200,000,000單位	200,000,000單位	
發行得認購股數占發行時已發行股份總數比率	4.49%	0.39%	3.49%	0.36%	3.66%	3.41%	0.20%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。						
履約方式	由本公司發行普通股新股交付。						
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股。 認股權憑證授予期間 / 累積最高可行使認股比例 屆滿2年 40% 屆滿2.5年 50% 屆滿3年 60% 屆滿3.5年 70% 屆滿4年 80% 屆滿4.5年 90% 屆滿5年 100%						
已執行取得股數	114,137,600股	9,068,060股	80,001,350股	8,335,000股	26,684,400股	2,338,600股	0股
已執行認股金額	1,649,408,980元	141,193,971元	1,611,272,650元	139,102,400元	693,933,040元	48,531,620元	0元
未執行認股數量	0股	4,941,940股	44,998,650股	6,665,000股	159,121,600股	185,380,900股	12,280,000股
未執行認股者其每股認購價格(目前執行價格)	(執行屆滿)	新台幣8.4元	新台幣13.5元	新台幣11.1元	新台幣21.1元	新台幣20.4元	新台幣22.6元
未執行認股數量占年報刊印日已發行股份總數比率(%)	(執行屆滿)	0.06%	0.59%	0.09%	2.09%	2.44%	0.16%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分三年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限。						

(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

102年02月28日

	職稱	姓名	發行日	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
						認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人(含前十大員工)	執行長	張虔生	91.12.24 92.08.22 93.06.30 94.05.23 96.12.19 99.05.06 100.04.15	64,695,000	0.85%	22,587,000	16.24	366,848,700	0.30%	41,773,000 (註)	20.03	836,671,300	0. 55%
	總經理	張洪本											
	集團營運長及總經理	吳田玉											
	高雄廠區總經理	羅瑞榮											
	總經理	唐和明											
	財務長兼副總經理	董宏思											
	副總經理	唐國安											
	副總經理	俞旭濬											
	副總經理	陳道有											
	副總經理	李世文											
	副總經理	林顯堂											
	副總經理	林國堂											
	副總經理	洪松井											
	副總經理	莫煥華											
	副總經理	葉清昆											
	副總經理	藍詩融											
	副總經理	曾和帝											
	副總經理	鄭楨銘											
	副總經理	曹燕傑											
	分公司經理人	沈文智											

註：高層主管離職致未執行股數中335,000股無法行使。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工姓名及取得情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

八、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

本公司所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

1. 主要業務：本公司以先進半導體封裝測試技術與製程研發為核心競爭能力，提供全球半導體廠商先進封裝及測試服務。

2. 目前商品種類及其比重：

單位：新台幣仟元

主要產品項目	一〇一年度	
	營收金額	營業比重
先進基板或導線架型積體電路(Flip Chip BGA, QFN, QFP, BCC,WLCSP)	60,638,069	83.1%
傳統導線架型積體電路(SO,PLCC)	998,766	1.4%
其他	11,289,817	15.5%
總計	72,926,652	100.0%

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

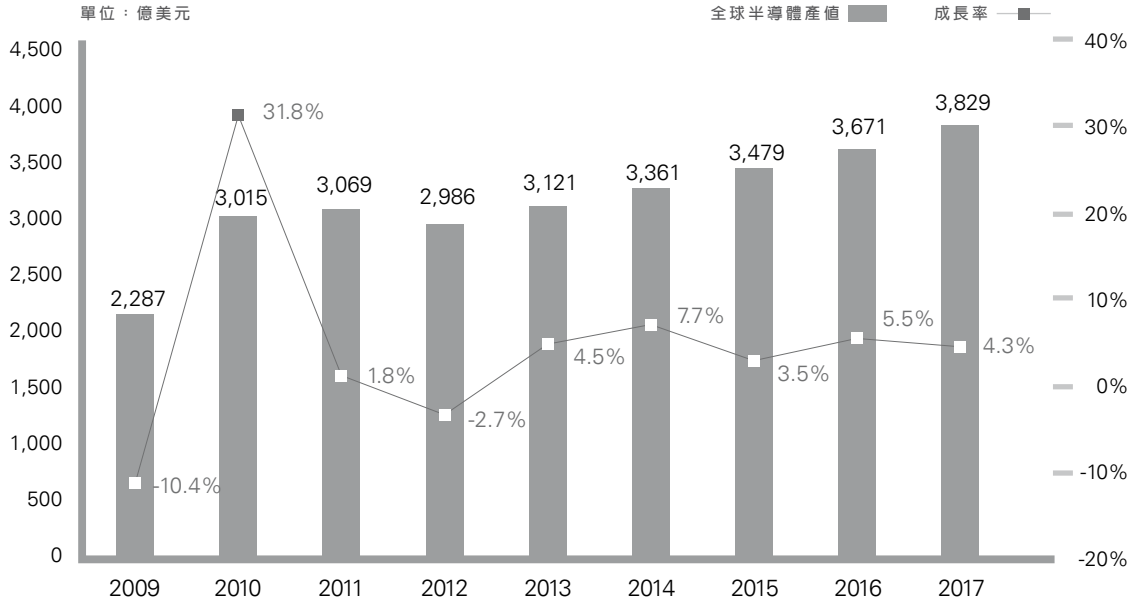
半導體產業在面對歐債問題懸而未決，且於 2012 年下半年重新浮上檯面，再加上美國財政懸崖等總體經濟因素影響下，造成終端需求市場景氣能見度下降，致使 Gartner 對 2012 年全球半導體市場產值的預估，僅達 2,986 億美元，較 2011 年衰退 2.7%。

在終端系統產品方面，2012 年個人電腦(Personal Computer；PC)出貨成長率衰退 2.5%，平板電腦(Tablet)成長率高達 122.1%，智慧手機(Smartphone)的 2012 年成長率高達 47%。由此可知 PC 對半導體產業的驅動力，已逐漸被 Smartphone 與 Tablet 等智慧終端所削弱。

在資本支出方面，全球半導體資本支出在 2012 年達 594 億美元，較 2011 年衰退 10.7%。另一方面，隨著存貨去化策略發酵，Gartner 持續調降 2013 年資本支出預估，達 507 億美元，衰退 14.7%。

展望 2013 年，在全球主要晶片供應商將持續打消庫存的預期，並依據國際貨幣基金會(IMF)於 2013 年1月公布的 2013 至 2014 年景氣預測，2013 年全球經濟成長率將達 3 .5%，雖較 2012 年10月所預測的 3.6% 微幅下修0.1%，但經濟表現仍優於 2012 年 3.2%。IMF 預估 2014 年全球經濟成長率將有機會攀升至 4.1%，表現為 2011 年以來最佳。因此 Gartner 預估 2013 年的全球半導體產值成長 4.5% 達 3,121 億美元，且 2014 年並持續成長 7.7% 且達到近期高點 3,361 億美元。

全球半導體市場預測



資料來源：工研院IEK(2013/03)

台灣半導體產業景氣之動向：台灣半導體產業產值表現，2012 年我國 IC 總體產業產值(含設計、製造、封測)為新台幣 16,342 億元，較 2011 年成長 4.6%。其中設計業產值為新台幣 4,115 億元，較 2011 年成長 6.7%；製造業為新台幣 8,292 億元，較2011年成長 5.4%；封測業為新台幣 3,935 億元，較 2011 年成長 0.8% (封裝業為新台幣 2,720 億元，較 2011 年成長 0.9%；測試業為新台幣 1,215億元，較 2011 年成長0.6%)。

預估 2013 年台灣 IC 產業產值達新台幣 17,856 億元，較 2012 年成長 9.3%。其中，設計業產值為新台幣 4,507 億元，較 2012 年成長 9.5%；製造業為新台幣 9,054 億元，較 2012 年成長 9.2%；封測業為新台幣 4,295 億元，較 2012 年成長 9.1%(封裝業為新台幣 2,965 億元，較 2012 年成長 9.0%；IC 測試業為新台幣 1,330 億元，較 2012 年成長 9.5%。以下係 2012 年我國 IC 設計、製造、封測業及 2013 年預估營運表現，表列如下：

2013年台灣半導體產業產值預估

單位：新台幣億元

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (e)
IC產業產值	13,743	12,497	17,693	15,627	16,342	17,856
IC設計業	3,749	3,859	4,548	3,856	4,115	4,507
IC製造業	6,542	5,766	8,997	7,867	8,292	9,054
IC封測業	3,182	2,872	4,148	3,904	3,935	4,295

資料來源：工研院IEK(2013/3)

IC 製造產業的三大支柱－晶圓代工產業、記憶體製造業及封測業等，在在顯示 2012 年晶圓代工呈現成長、記憶體製造呈現衰退，而封測業成長幅度相對較小。

台灣 IC 設計產業方面，業者已積極由 PC 跨入 Smartphone與 Tablet 等智慧終端，且已成功打入許多國際品牌大廠供應鏈，表現大幅優於 IC 製造與 IC 封測產業，且較 2011 年成長 6.5%。

台灣 IC 製造產業方面，2012 年成長率達 5.0%，此成長幅度乃受惠於2012 年成長率 12.9% 的晶圓代工業務，由於 Smartphone 與Tablet 需求旺盛，不論是在應用處理器(Application Processor；AP)或是基頻(Baseband Processor；BB)方面，皆會被此旺盛需求所帶動。反觀 2012 年衰退 16.1% 的記憶體產業，也是因為Smartphone 與 Tablet 的需求暢旺，反而壓縮了 PC 的成長空間，導致標準型 DRAM 記憶體的需求轉趨疲弱。

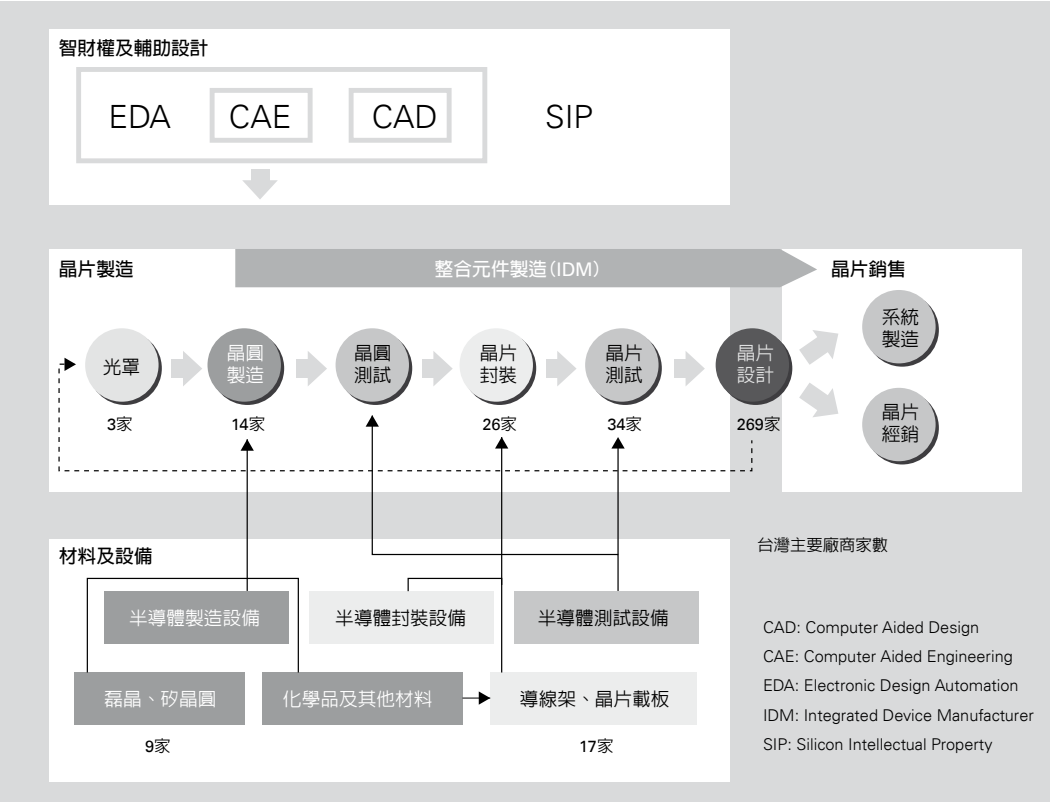
台灣 IC 封測產業方面，雖然有 Smartphone 與 Tablet 晶片的成長力道，但台灣封測業者面臨庫存調整仍在進行、上游客戶開始下修訂單、DRAM 減產與 Windows 8 出貨遞延 PC 需求端走弱等多重因素影響，導致 2012 年成長率僅有 0.7%。

2013 年下半年在全球景氣將有機會走出歐債陰影，成長表現可望優於 2012 年同期， 加上來自智慧型手機等行動上網裝置需求依然相當強勁，亦成為帶動封測產業成長的重要動能，預期回補庫存需求在旺季效應下出現，同時隨景氣展望轉佳，可能出現整合元件大廠(Integrated Device Manufacturer；IDM)訂單擴大委外的狀況。

2. 產業上、中、下游之關連性

在整個半導體供應鏈中，本公司之業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。本公司提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務，主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供，長期與本公司保持良好的業務關係。本公司並透過策略聯盟與合作伙伴藉由垂直分工，進而提昇彼此的競爭實力。

我國半導體產業結構圖



註：圖中數字代表公司家數　資料來源：資策會MIC (2012/2)

3. 產品之發展趨勢

為了因應終端電子產品「輕、薄、短、小、多、省、廉、快、美」的需求，持續促進 IC 元件朝向「小型化、高效能、低功耗、高整合、低成本」的趨勢發展，並帶動製程微縮(Process Ministration)的需求，以獲得更高集積度、更高效能與更低成本；以及功能多樣化以擴展半導體應用，並藉由高整合性的 SoC 與 SiP 及利用晶圓穿導孔技術(Through Silicon Via；TSV)為連接方式的 3D IC 技術進行異質整合(Heterogeneous Integration)，達到系統層級的目標。就應用面而言，在高效能、高頻寬與大容量的訴求下，舉凡行動通訊電子、消費性電子、個人電腦、網路(雲端用)伺服器、繪圖處理器、汽車電子等，都會是 3D IC 可發揮的空間。

而另一方面，市場上渴望低成本的力道更大，尤其是手持式終端產品，因此封測大廠紛紛布局高階封裝，積極轉進新興中段(Middle-end)產業，如內埋系統封裝(Embedded SiP)製程與扇出型堆疊式封裝(Fan-out Package-on-Package)，連載板大廠不僅切入內埋系統封裝，也積極耕耘玻璃中介層(Glass Interposer)高階載板。

此外，分布式電源系統應用的普及推廣以及電池供電移動式電子設備的飛速發展，其電源系統需用的DC/DC電源模塊越來越多。對其性能要求越來越高。除去常規電性能指標以外，對其體積要求越來越小，也就是對其功率密度的要求越來越高，對轉換效率要求也越來越高，也即發熱越來越少。這樣其平均無故障工作時間才越來越長，可靠性越來越好。因此如何開發設計出更高功率密度、更高轉換效率、更低成本更高性能的DC/DC轉換器始終是近二十年來電力電子技術工程師追求的目標。

4. 競爭情形

近年來全球半導體封裝測試產業經營，受到產業整併的效應逐漸擴大，大者恆大趨勢越來越明顯。部分二線或三線的中小型封測廠商，將越來越難達到穩定的訂單規模而獲利。

除了整併趨勢之外，在營收來源部分，IDM 大廠的委外訂單仍是封測產業的主要成長動能。

為了避免產能過剩的影響，近年來封測業者的經營方向已從過去「量變」轉向「質變」，已不再肆意投資，而是謹慎控制產能。

若就供應鏈關係來看，封測業者為了滿足「小型化、高效能、低功耗、高整合、低成本」的 IC 元件趨勢發展，亦積極搶進新興中段產業，與上游的晶圓廠以及下游的載板廠密切合作，以期能創造綜效，達到多贏局面！

綜合上述，封測業正進入整併風潮、IDM 廠加速委外、新興中段產業崛起等「質變」階段。有鑑於此，本公司積極地研發未來新市場所需的新技術，並且降低成本減少支出；在目前現有技術及製程能力方面也不斷加強與客戶的溝通以達到或是超越顧客所要求的品質水準，並提供完整的半導體後段製造服務。另外也可藉由合資來增強市場競爭力、降低新產品研發風險及以具備完整產品線，維持市場領導地位。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目＼年度	100年度	101年度	102年截至2月底
營業收入	69,439,165	72,926,652	10,891,726
研發支出金額	3,094,997	3,827,357	631,377
研發支出佔營業收入之比率	4.46%	5.25%	5.80%

2. 開發成功之技術或產品：

A. 開發成功之新產品

封裝技術

New Package	
3D系統封裝(3D SiP)	1. 2.5D晶圓穿導孔矽材基板系統封裝(2.5D Through Silicon Via interposer System in Package) 2. 3D晶圓穿導孔堆疊系統封裝(3D Through Silicon Via Stacking System in Package) 3. Panel Level覆晶PoP(aMAP Flip Chip PoP) 4. Panel Level 銲線PoP(aMAP Wire Bond PoP) 5. 整合被動元件QFN封裝(Integrated Passive Device Integrated QFN Package) 6. 基板內埋主被動元件技術 (Embedded Active/ Passive Laminate Substrate) 7. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術 (Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
光電封裝(OEP)	1. 晶圓級微機電/ 影像感測器封(Wafer Level MEMS / CIS Package) 2. 裸晶封膠之指紋感應器封裝技術 (Exposed Die Molding Solution for Finger Print Sensor) 3. 微光機電微顯示器封裝 (Optical MEMS Microdisplay Package) 4. 高功率LED構裝 (High Power LED Package)
晶圓級封裝(WLCSP)	1. 矽晶圓間層封裝 (Si Interposer Package) 2. 200 mm外引腳式二維WLP (200 mm 2D Fan-out WLP) 3. 整合電阻被動元件技術 (Integrated Resistor Passive Device)
覆晶封裝(Flip Chip)	1. 28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(28 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution) 2. 40微米微間距覆晶及銲線混合堆疊 (40 um Fine Pitch FC & WB Hybrid Stacked Chips Package)
銲線封裝(Wire Bond Package)	1. 32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝 (32/28 nm Cu/ULK Wafer Wire Bond Package) 2. 銅線BGA/ Lead frame封裝開發 (Cu Wire Bond BGA/ Lead frame Package) 3. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu wire pad to pad bonding) 4. 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案 (Low Cost & High Performance aS3 / aQFN)
無線射頻模組(Wireless Module)	1. BT + FM系統模組完整方案 (BT + FM SiP Module Total Solution) 2. Wi-Fi + BT + GPS+ FM系統模組完整方案 (Wi-Fi + BT + GPS+ FM Combo SiP Module Total Solution) 3. 無線通訊模組電磁遮避技術 (Wireless Module Conformal EMI Shielding)

Bumping	
印刷製程(Printing)	晶圓PI凸塊技術 (Wafer Bumping Technology with PI Bump)
電鍍製程(Plating)	1. 錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術 (Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology) 2. 高長寬比銅柱凸塊技術 (Non-circular High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping)

測試技術

New Test Technology	
後段測試(Final Testing)	1. 無線通訊產品 (GSM/CDMA Wireless Product) 2. 寬頻網路元件測試方案(ADSL/XDSLDevice Tesing Solution) 3. 藍芽(2.5GHZ) 元件測試方案(BlueTooth 2.5GHZ Device Testing Solution) 4. 觸控元件測式方案(Touch Panel Device Testing Solution) 5. 電視解調晶片測試方案(TV Tuner Device Testing Solution) 6. Low cost power management元件測試方案 7. 高頻模組測試 SiP Testing

EMS製程技術

New Process Technology	
晶片焊錫組裝(Solder Die Bond)	1. 13mm以上晶片焊錫組裝能力與技術 2. 焊錫介面空隙小於3%
基片焊錫組裝 (Substrate Attachment)	1. 60mm X 60mm以上基片焊錫組裝能力與技術 2. 焊錫介面空隙小於3%

B. 開發成功之新技術

封裝技術

Advanced Technology	
3D系統封裝(3D SiP)	1. 晶圓穿導孔矽材基板測試 (TSV-interposer Test solution) 2. 3維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術 (3D TSV Stacking) 3. 整合被動元件封裝技術 (Integrated Passive Device) 4. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) 5. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術 (Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology) 6. 65奈米 SRAM晶圓穿孔功能驗證 (65 nm SRAM TSV Qualification)
光電封裝(OEP)	1. 微型投影機顯示器功能驗證 (Pico Projector Microdisplay Qualification) 2. 高深寬比晶圓穿孔電鍍技術 (High Aspect Ratio TSV Plating technology) 3. 低成本矽晶圓穿孔技術 (Low Cost TSV Technology)
晶圓級封裝(WLCSP)	1. FC PoP雷射燒結技術 (FC PoP w/ Laser Ablation Technology) 2. 雙面 RDL電鍍厚銅技術 (Double-sided Thick Cu Plated RDL Technology) 3. 矽材基板內埋主動元件技術 (Embedded Active Si Substrate) 4. 200 mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(50 um Wafer CMP Grind Technology for 200 mm TSV Wafer) 5. 200 mm穿導孔晶圓50微米厚度分離載具技術(50 um Wafer Carrier Release Technology for 200 mm TSV Wafer)
覆晶封裝(Flip Chip)	1. 300 mm 凸塊晶圓 75 微米厚度研磨技術 (75 um Wafer Grind Technology for 300 mm Bumped Wafer) 2. 助焊劑噴塗技術 (Flux Jetting Technology) 3. 微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Under-fill Technology) 4. 28奈米超低介電係數晶圓, 40 um bump pitch之覆晶封裝 (40 um Pitch FC Solution for 28 nm ELK Wafer) 5. 40微米銅柱凸塊微間距之覆晶晶片堆疊封裝 (40 um Fine Pitch Cu Pillar Bump FC Stack) 6. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術 (SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
銲線封裝(Wire Bond Package)	1. 32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝 (32/28 nm Ultra Low K Cu Wafer Wire Bond Package) 2. 18微米線徑銅線打線封裝技術 (18 um Cu Wire Bond Technology) 3. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu wire pad to pad bonding) 4. 銅銲線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology)
綠色封裝(Green Package)	1. QC080000 綠色環保系統認證 (QC080000 Green System Certification) 2. 化學實驗室通過TAF認證 (RoHS Certification on Chemical Lab)
Bumping	
電鍍製程(Plating)	1. 40微米微間距銅柱凸塊技術 (40 um Fine Pitch Cu Pillar Bumping) 2. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術 (High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping Plating)

測試技術

New Test Technology	
晶圓測試(Wafer probing)	1. 電源管理產品(Power Management Product Testing Solution) 2. 觸控感應元件產品(Touch Sensor Device testing Solution)
後段測試(Final testing)	1. 發光二極管元件測試方案(Light Emitting Diode Test Solution) 2. 快閃式記憶體元件測試方案(32M/64M Flash Memory Device Test Solution)

IGBT晶片與基片焊錫組裝製程技術

EMS製程技術 (New Process Technology)	
晶片焊錫組裝(Solder die bond)	1. 13mm以下晶片焊錫組裝能力與技術 2. 焊錫介面空隙小於5%
基片焊錫組裝 (Substrate attachment)	1. 59mm X 50mm以上基片焊錫組裝能力與技術 2. 焊錫介面空隙小於5%

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶，並爭取更多IDM客戶
- 落實集團生產策略，取得最具優勢之配置
- 爭取高階封裝訂單，提昇實質獲利

- 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- 提昇環保產品之生產技術，加速產品轉換速度，以提昇市場機會
- 藉由試製開發達到量產

2. 長期計畫

- 整合集團資源，提供客戶更趨完整之服務
- 改善成本結構，提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔，強化客戶滿意擴大整體生產規模，追求成本優勢，讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市佔率

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 一〇一年度本公司主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	銷售金額	%
美洲	38,961,214	53.42
歐洲	7,106,045	9.74
台灣	21,976,660	30.14
亞洲及其他	4,882,733	6.70
合計	72,926,652	100.00

2. 市場佔有率(主要封測廠之比較)

主要封測廠營收比率統計表

Year	ASE	Amkor	SPIL	STATS ChipPAC	Powertech
2008	29.0%	26.1%	18.8%	16.3%	9.8%
2009	29.5%	24.7%	19.6%	15.1%	11.2%
2010	33.1%	24.9%	17.8%	14.2%	9.9%
2011	35.7%	22.8%	16.7%	14.0%	10.8%
2012	35.6%	22.1%	17.5%	13.6%	11.3%

資料來源：Gartner (2012/Q4)及本公司資料彙整

2012年全球主要封測廠營收比例中，日月光營收持續成長佔35.6%，位居於龍頭地位，Amkor市佔下滑至22.1%，位於第二，矽品佔17.5%，位居第三，STATS ChipPAC及力成分別為13.6%及11.3%，各居全球四、五名，排名及比例上並無太大的變化。日月光不斷開發各種先進製程及強化本身封測實力，近幾來年已慢慢看出其成效，目前已是封測業全球最大之專業封測大廠，近幾年來更是大幅拉大與競爭者的差距。當前封裝技術發展趨勢主要配合電子元件朝高密度、高I/O數、低操作功率、表面元件模組化、複合結構化等方向發展，使封裝技術朝高集積化、多腳/細微化、薄型化、多晶模組封裝化及低成本方向進行，包括因應腳數增加的細間距銲線技術、覆晶封裝、2.5D & 3D堆疊式封裝、晶圓級構裝、多晶模組(Multi-chip Module, MCM)、系統整合型封裝(SiP)技術、銅製程以及晶圓穿導孔(TSV)技術等。有鑒於產業對高階封測產能的需求不斷成長，日月光集團過去在技術與產能的投資已為這成長趨勢作好準備。展望未來，我們將持續製程的精進，同時致力於提昇獲利率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據Gartner統計，封裝及測試市場整體規模2012年達47,774百萬美元，因受全球景氣影響約略持平，預估2013年將回升至49,600百萬美元，預測2017年將提升至64,620百萬美元。其中，IDM封裝及測試整體規模2012年達23,438百萬美元，佔封裝及測試市場整體規模比例率為49.1%，預估2013年營收為23,758百萬美元，預測2017年將提升至29,274百

萬美元，佔市場整體規模比例率降為45.3%。專業代工封裝及測試市場規模(SATS)方面，封裝及測試市場整體規模2012年達24,336百萬美元，佔封裝及測試市場整體規模比例率為50.9%，預估2013年將上升為25,842百萬美元，預測2017年將提升至35,346百萬美元，佔市場整體規模比例將高達54.7%。由此數據顯示，國際性IDM廠的封裝及測試委外代工的比率正逐年增加。主要影響因素為消費性電子化所帶來的產品多樣化，使得客製化的封測設計越來越複雜；系統電路板微縮的速度無法與越來越精細的製程同步，而兩者之間僅能靠封裝技術做為橋樑；再加上封裝與測試技術成本及技術層次越來越高，促使封測研發費用隨著上升，因此晶片製造商為了降低成本，更加使得封測外包需求逐漸增加。同時也突顯出IDM大廠越來越不可能自行投入高階封測設備，委外代工趨勢勢必越來越明顯。

2012~2017年半導體封裝及測試市場成長情形

(單位：美金百萬元)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IDM封裝及測試市場規模	23,438	23,758	24,964	26,513	27,405	29,274
IDM封裝市場規模	18,584	18,864	19,821	21,051	21,759	23,244
IDM測試市場規模	4,854	4,894	5,143	5,462	5,645	6,031
專業代工封測市場規模 (SATS)	24,336	25,842	28,385	30,453	33,089	35,346
專業代工封裝市場規模	18,387	19,421	21,269	22,819	24,794	26,485
專業代工測試市場規模	5,949	6,421	7,116	7,634	8,295	8,861
封裝及測試市場整體規模	47,774	49,600	53,349	56,966	60,493	64,620
封裝及測試市場整體規模成長率	-0.5%	3.8%	7.6%	6.8%	6.2%	6.8%
封裝市場整體規模	36,971	38,286	41,090	43,870	46,553	49,729
專業代工比率(封裝)	49.7%	50.7%	51.8%	52.0%	53.3%	53.3%
測試市場整體規模	10,803	11,315	12,258	13,096	13,940	14,891
專業代工比率(測試)	55.1%	56.7%	58.0%	58.3%	59.5%	59.5%
專業代工比率(封裝及測試)	50.9%	52.1%	53.2%	53.5%	54.7%	54.7%
專業代工市場成長率	1.3%	6.2%	9.8%	7.3%	8.7%	6.8%

資料來源：Gartner (2013/03)

此外，近年來隨著工業電器電子技術及數據產業的發展，以及分布式供電系統的推廣。工業電器DC-DC轉換器的應用越來越廣，面對新世代的電子器件和負載，電源業要面對重大的挑戰，產品除了能在工業電器低電壓輸出大電流外，還要做到體積小、重量輕、動態反應快，噪聲小和價錢相宜。

DC-DC轉換器模組市場之發展驅力與DC-DC轉換器IC市場不同。此兩種展品大多應用程式雖有所「結合」，但為保持及各別之特性，模組市場今後可望達到健全之發展。因此，全球DC-DC轉換器模組市場預計於2016年將可達43億美金規模。

4. 競爭利基

2013年整體市場將有明顯的正成長趨勢，日月光集團在此同時也更重視內部營運機制，也更著重於提升技術開發能力，期許在全球性經濟景氣循環中再創佳績，我們所依賴之各項競爭優勢分析如下：

A. 持續技術研發，高階產品技術及品質居領導地位

隨著半導體專業代工產業鏈模式，日月光也跟著台積電、聯電等主要晶圓代工不斷往高階產品研發，在技術上能夠日月精進，創造多贏之局面。為了因應產品應用的功能越趨繁多、尺寸越來越小及最佳成本效益等市場需求，日月光在高階封測技術2.5D & 3D IC, SiP、CSP、Flip Chip、Bumping及WLP等領域研究多有著墨。

在原有技術精進及先進產品研發方向，日月光集團每年提撥3~5%的營收在技術研發上，每年獲得超過百項專利，期許保持產業之領先地位及競爭優勢，除了在市佔率領先業界，也必須在技術研發上維持領先同業。

B. 積極佈局，適時掌握IDM大廠委外代工之商機

目前國際性IDM大廠為維持半導體經營之效率，降低成本，必須朝向Fab Lite型態發展，奠定委外代工比例增加的趨勢。日月光集團為迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢，多年來的營運策略更為積極，西進大陸佈局，接近客戶，接近市場，以爭取潛在商機。所有的國際大廠都想在中國大陸佔有一席之地，又無法找到較具規模的合作夥伴。如今日月光的佈局，將可能使更多大廠陸續將封測業務外包，不僅不會影響到台灣的基礎，還將帶進更多的商機。

5. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1)有利因素

- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加，對一向在研發創新具備優勢的日月光而言是一大利多機會。
- IDM廠商的經營趨勢，持續釋出封測訂單，未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 因應未來產品輕薄短小、高性能及高效率的需求，2.5D & 3D IC是非常重要的技術，而日月光早在幾年前已投入非常多的資源進行研發，非關的封裝技術更是領先同業。
- 身為台灣擁有基板產線的封測廠，擁有高階基板穩健的製造能力，不但可掌握高階封裝材料之關鍵，更可有效降低IC的整體製造成本，提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外，更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品、無線通訊模組等相關晶片，以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 未來幾年中國大陸對積體電路的需求仍會有大幅成長，基於群聚效應、供應鏈原則，日月光已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備，迎接這波成長及搶先商機。
- 卓越的研發技術:卓越的研發技術攸關高科技公司未來之發展，有鑑於此，本公司致力於研發人員之培育，引進先進技術並累積多年經驗，使期研發之成果達水準；本公司並已取得ISO-9001 工廠管理品質認證及美國軍規MIL standard認證。
- 管理系統完善:本公司從訂單處理、物料管理、生產管制、現場管理、倉儲系統、出貨作業皆已納入電腦化管理，充分掌握各項製程，並大量採用自動化設備來替代人工，以提升產品良率，降低生產成本，增加產品競爭力。

(2)不利因素

- 本土同業競爭者對爭取日月光的客戶相當積極；另外，競爭者的聯盟機制亦有可能對日月光產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降，競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短，對一向以技術取得優勢的日月光是一項外在威脅；由於新技術的研發需投入大量的資金與人力，因此在後續價格上的變動彈性相對較弱，在微利時代下，實為一項挑戰。
- 客戶端對於IC後段封裝、測試之要求水準日益嚴苛，日月光業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及客戶的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業，因而受到半導體市場景氣影響甚巨，營運的優劣易受景氣所影響；IC封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單以及不景氣時訂單減少的衝擊。
- 任何電子設備都需要電源供應器，功率半導體元件與電力電子技術的進步，使得電源供應器這個看似傳統卻又必須整合新材料、新元件、新設計、與新製造技術的產品，再度成為產業發展的關鍵技術。但現今的電源供應器產業中主要仍以民生市場為最大宗需要(消費性、資訊…等) ， 鑒於全球通訊產品快速成長，帶動電源供應器龐大需求，除競爭同業紛紛擴充設備，同時亦吸引許多新廠商投入，因此其所面臨的主要考量點除了產品特性外，價格更為使用者的評選重點之一，也因為多數支援產業電源產品的進入門檻並不高，介入容易，競爭者多且競爭激烈而形成削價競爭毛利日益薄利化的趨勢，為減緩因競爭增加所造成獲利下滑的影響，加強成本控制及擴大生產經濟規模為當務之策。

(3)因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益，強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由日月光特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失，建立最佳化製程，提升製程穩定性，強化日月光在成本和品質方面的競爭力，爭取最大的市場契機。
- 憑藉日月光先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源，擴大業務版圖。

- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能，提高綜效。
- 日月光在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作，除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外，更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢，依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求，提升服務品質的競爭力，同時建立專利防護網，鞏固競爭利基。
- 提升客戶對日月光一元化服務的訂單比例，加快解決方案整合速度，以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服務。
- 客製化之行銷服務系統，加強與客戶間策略聯盟之依存關係，以博大公司現有的研發實力、產品產銷開拓能力，積極與其架構更具競爭優勢的產、銷、研專業分工之供應鏈體，使公司常保產業關鍵優勢之地位。
- 積極透過製程及設計之改良來提昇品質，滿足客戶多樣化需求，縮短交期，提昇產品競爭力，同時對新市場之客戶積極開發。
- 除持續深耕於DC/DC Converter 之高階應用產業及產品設計開發，並堅持以高標之技術及產品品質構築同業競爭門檻以長駐優勢並維持獲利。
- 供應商(鏈)管理的改善規劃與落實，希望藉由整合上、下游產業價值鏈和合作廠商共同分攤資訊成本以達成利益共享， 利潤分享，以降低相關產銷成本， 提升產品競價力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

封裝技術

主要產品	重要用途
• 塑膠立體型積體電路(PDIP)	• 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航設備。
• 塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC) • 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) • 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) • 覆晶(Flip Chip)封裝技術 • 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) • 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) • 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、 HFC BGA) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) • 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) • 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) • 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) • 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA) • 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	• 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、智慧手機、平板電腦、智慧型手持式裝置等。 • 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 • 個人電腦與筆記型電腦等。 • 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 • 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與智慧手機、智慧型手持式裝置等。 • 電腦—繪圖/晶片卡、雲端運算伺服器、PCS & 伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬碟等週邊產品。 • 網路通訊產品—廣域(WAN)與區域網路(LAN)伺服器、轉換器、交換器、路由器、蜂巢式基地台。 • 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD等、電視遊樂器、數位電視機上盒等、PDA、MID。 • 其他產品—自動汽車元件、Telematics。
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) • 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) • 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	• 主要用途在於記憶體積體電路。 • 個人電腦與週邊裝備等。 • 主要用途在於記憶體積體電路。
• 立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package) • 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA) • 多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA)	• 主要用途在於各種可移動式的資訊產品，例如：手機、PDA、數位相機等。 • 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。 • 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
• 晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level CSP) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) • 晶圓穿導孔技術 (TSV Technology) • 整合被動元件 (IPD) • 矽質基板 (Si Interposer) • 微間距晶片堆疊系統技術 (Fine Pitch 3D Chip Stacking Technology) • 異質晶片整合系統封裝 (Heterogeneous Chip Integration SiP)	• 主要應用手機、PDA、數位相機等。 • 主要應用手機、NB、數位相機等。 • 主要應用手機、NB/Network、數位相機等。 • 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。 • 主要應用在手機、NB、Network Sever。 • 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。

• 微間距面對面堆疊系統封裝 (Fine Pitch CoC SiP Solution) • 基板內埋主、被動元件技術 (Embedded Active / Passive Substrate)	• 主要應用在NB、Sever、生醫照護。 • 主要應用在手機、Game Console遊戲機。 • 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。
• 微機電型微顯示器(MEMS-based Micro display) • 安控感測元件 • DDR2 800 記憶體(DDR2 800 Memory) • 外引腳式Map PoP堆疊技術 (Fan-out Map PoP Technology) • 外引腳式WLP (Fan-out WLP) • 無線通訊模組 (Wireless Connectivity SiP Module)	• 主要應用在投影機 (Projector)、高解析數位電視(HDTV) 。 • 主要應用在個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。 • 主要應用在3C產品之記憶體。 • 主要應用在3C產品之系統封裝產品(ASIC + MCP Memory, DBB+SDRAM) 。 • 主要應用在可攜式消費電子。 • 主要應用在3C產品之無線通訊模組包括BT, WiFi, GPS, DVB-H /T。

測試技術

主要產品	重要用途
• 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) • 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) • 覆晶(Flip Chip)封裝技術 • 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) • 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) • 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA, HFC BGA) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) • 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA), • 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) • 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) • 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA) • 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) • 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(aQFN) • 單層基板(Advance Single Sided Substrate) • 系統級封裝(System in Package)	• 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、手持式通訊模組、晶片組等。 • 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電、液晶電視與智慧型行動電話等。 • 個人電腦與筆記型電腦等。 • 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 • 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與智慧型行動電話等。 • 手機晶片組、MP3 Processor。 • 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD等、電視遊樂器、機上盒等、PDA、MID。 • 高頻模組 及 電源管理模組。
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) • 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) • 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	• 主要用途在於記憶體積體電路。 • 個人電腦與週邊裝備等。 • power management IC & portable device。

2. 產製過程：

封裝技術

- 釘架類產品：

  晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→外腳成型→外觀檢驗→包裝

- 球陣列類產品：

  晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→植錫球→切割成型→外觀檢驗→包裝

- 覆晶類產品：

  晶圓凸塊→晶圓切割→覆晶式粘晶粒→底膠充填→正印→植錫球→外觀檢驗→包裝

- 晶圓穿導孔類產品：

  晶圓穿導孔→穿導孔絕緣層→穿導孔銅電鍍充填→穿孔晶圓薄化→雙面佈銅導線→植錫球→堆疊→外觀檢驗→包裝

測試技術

- 釘架類產品/球陣列類產品：

  IC測試→產品老化測試(依客戶需求)→烘烤→產品外觀檢驗→捲帶包裝→成品包裝

- 高頻模組產品/電源管理模組產品：

  測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

(三)主要原料之供應狀況

本公司係代客封裝之半導體製造業，主要晶圓由客戶提供，客戶大都為國際知名半導體公司，長期與本公司保持良好的業

務關係。

主要封裝材料如：釘架、基板、金線、銅線、膠餅等，供應商皆為本公司品管審查合格之績優廠商，尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)股份有限公司(ASESH)及日月光電子股份有限公司(ASEE)，使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASESH/ ASEE / A公司/B公司/C公司/D公司	供需平衡	長期配合廠商
釘架 Lead Frame	E公司/F公司/H公司	供需平衡	長期配合廠商
金線 Gold Wire	G公司/I公司/ J公司	供需平衡	長期配合廠商
銅線 Copper Wire	K公司/J公司	供需平衡	長期配合廠商
膠餅 Compound	E公司/L公司/M公司	供需平衡	長期配合廠商

南投分公司係代客組裝之電子產品製造業，90%以上的材料均由客戶提供，主要客戶為O公司及P公司，長期與本公司保持良好的業務關係。

- O公司主要組裝材料如下：

1. 90%以上主要材料：金屬封裝盒、基板、DICE,CHIP C, CHIP R等材料由客戶提供，物料供應則為客戶直接供應，使得材料的交期及品質可完全掌握。
2. 10%自購料：膠材、包裝材料、金線，金額由本公司視客戶訂單需求採購。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	自製	良好	由客戶自行備料
金屬盒 Metal package	R公司	良好	由客戶自行備料
DICE	S公司/T公司	良好	由客戶自行備料
CHIP C, CHIP R	M公司/U公司	良好	由客戶自行備料

- P公司主要組裝材料如下：

99%以上主要材料：基板、LCP substrate、 Flex PCB、膠材、塑膠件等材料均由客戶直接供應，使得材料的交期及品質可完全掌握。包材部份由本公司視客戶需求購買。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板LCP Substrate	V公司	供需平衡	由客戶自行備料
膠材Die Attach Film	W公司	供需平衡	由客戶自行備料
DICE	X公司	供需平衡	由客戶自行備料
Flex PCB	Y公司	供需平衡	由客戶自行備料
Plastic Parts	Z公司	供需平衡	由客戶自行備料

(四)最近二年度任一年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 佔銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位：新台幣仟元

排名	101年度				100年度			
	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	Q公司	10,459,086	14.3	無	Q公司	8,375,097	12.1	無
	其他	62,467,566	85.7		其他	61,064,068	87.9	
	銷貨淨額	72,926,652	100.0		銷貨淨額	69,439,165	100.0	

2. 佔進貨百分之十以上之進貨廠商

單位：新台幣仟元

排名	101年度				100年度			
	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	—	—	—	—	G公司	2,751,466	10.1	無
	其他	26,160,966	100.0		其他	24,636,737	89.9	
	進貨淨額	26,160,966	100.0		進貨淨額	27,388,203	100.0	

(五)最近二年度生產量值表

單位：仟個/新台幣仟元

年度 / 生產量值 / 主要商品	101年度			100年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
先進基板或導線架型積體電路(Flip Chip, BGA, QFN, QFP, BCC)	15,144,406	6,954,274	39,583,936	11,659,163	6,165,344	38,256,437
傳統導線架型積體電路(PDIP, SO, PLCC)	1,448,000	673,453	921,781	1,432,000	531,154	877,884
其他	—	—	14,055,425	—	—	12,584,680
合計	16,592,406	7,627,727	54,561,142	13,091,163	6,696,498	51,719,001

(六)最近二年度銷售量值表

單位：仟個/新台幣仟元

年度 / 銷售量值 / 主要商品	101年度				100年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
先進基板或導線架型積體電路(Flip Chip, BGA, QFN, QFP, BCC)	2,165,520	19,132,964	4,788,754	41,505,105	1,997,052	17,937,805	4,168,292	39,084,333
傳統導線架型積體電路(PDIP, SO, PLCC)	162,054	210,580	511,399	788,186	160,877	226,671	370,277	716,484
其他	—	2,633,116	—	8,656,701	—	1,752,969	—	9,720,903
合計	2,327,574	21,976,660	5,300,153	50,949,992	2,157,929	19,917,445	4,538,569	49,521,720

三、從業員工資料

(一)組織

本公司基於能維持有利的競爭市場，培育優秀的工程人力資源，健全公司組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		100年度	101年度	102年2月28日
員工人數	技術職人員	5,465	6,482	6,563
	管理職人員	887	1,014	1,038
	事務職人員	1,524	1,697	1,700
	作業員	10,807	12,292	12,474
	合計	18,683	21,485	21,775
平均年歲		34.5	34.3	34.3
平均服務年資		3.65	4.3	4.4

年度		100年度	101年度	102年2月28日
學歷分布比率	博士	0.3	0.3	0.3
	碩士	7.6	8.6	8.7
	大專	56.0	55.4	56.5
	高中	32.1	33.1	32.1
	高中以下	4.0	2.6	2.4

四、環保支出資訊

(一) 說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。

- 102年度：截至年報刊印日止，無重大環境污染事件發生。
- 101年度：無重大環境污染事件發生。

(二) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來年度預計之重大環保資本支出。

- 南投分公司：為承租「環鴻科技股份有限公司」4樓及1樓局部區域，污染防治等相關設備皆使用環鴻科技之設施，南投分公司並無自設相關污染防制設備，因此並無相關環保設備等維護、保養費用支出。

項目	一〇二年度	一〇三年度
擬採行改善措施部分		
(1) 改善計劃	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design) 4. 推行 ISO 50001 能源管理系統及驗證 5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證 6. 結合台灣永續創新論壇，持續致力推動本公司永續發展 7. 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO2減量 8. 節能產品導入與節能工程改善 9. 廢水防治設備清理與改善，並強化廢水回收量與效益 10. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 11. 高效率汙染防制設施建置 12. 集塵設備濾材更換 13. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 14. 廢棄物減廢、減量與回收再利用 15. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 16. 化學品使用量減量 17. 周界臭味防範 18. 緊急應變訓練與演練 19. 噪音防制強化 20. 2013年工安環保月活動 21. 持續推動產品水足跡盤查及查證 22. 空污防治設施(既設高級氧化處理設備保養、既設沸石轉輪設備保養) 23. 廢水處理廠砂塔濾料更換、廢水處理廠污泥脫水機濾布更換、研磨廢水回收系統薄膜保養 24. 廢棄物減量(廢棧板廠商回收重複使用、廢有機溶劑回收、包裝材重複使用、增加回收廢棄物項目) 25. 能源節約工程改善 26. 導入ISO14064-2溫室氣體減量查證，為碳交易預作準備。	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design) 4. 持續推行 ISO 50001 能源管理系統 5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證 6. 結合台灣永續創新論壇，持續致力推動本公司永續發展 7. 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO2減量 8. 節能產品導入與節能工程改善 9. 廢水防治設備清理與改善，並強化廢水回收量與效益 10. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 11. 高效率汙染防制設施建置 12. 集塵設備濾材更換 13. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 14. 廢棄物減廢、減量與回收再利用 15. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 16. 化學品使用量減量 17. 周界臭味防範 18. 緊急應變訓練與演練 19. 噪音防制強化 20. 2014年工安環保月活動 21. 空污防治設施(新設廢氣洗滌塔、 新設集塵機、既設廢氣洗滌塔填充料更換、既設高級氧化處理設備保養、既設沸石轉輪設備保養) 22. 新設製程廢水回收系統、研磨廢水回收系統薄膜保養 23. 廢棄物減量(事業廢棄物減量、資源回收再利用、包裝材重複使用) 24. 能源節約工程改善

項目	一〇二年度	一〇三年度
(2) 未來二年預計環保資本支出擬購置之污染設備或支出內容	1. 各部門自發性改善方案推動 2. 廢水廢氣防治設備改善 3. 周界噪音防制工程 4. 環保設備汰換 5. 週遭環境美化 6. 廢棄物減量回收推動 7. 使用省電燈具及節能改善工程 8. 能源管理監控系統設置 9. 推動廢液減量/回收 10. 導入水回收設施及工程 11. 空氣污染防治(廢氣洗滌塔、高級氧化處理設備、既設沸石轉輪設備、集塵機) 12. 廢水回收設備 13. 污泥乾燥設備	1. 各部門自發性改善方案推動 2. 廢水廢氣防治設備改善 3. 低頻噪音防制工程 4. 環保設備汰換 5. 週遭環境美化 6. 廢棄物減量回收推動 7. 使用省電燈具 8. 能源管理監控系統設置 9. 空氣污染防治(廢氣洗滌塔、高級氧化處理設備、既設沸石轉輪設備、集塵機) 10. 廢水回收設備 11. 污泥乾燥設備
預計改善情形	1. 減少耗能與CO2減量 2. 防範周界臭味 3. 延長設備使用壽命 4. 減廢/減量/資源回收 5. 降低周界噪音 6. 減少能源及水資源的耗用 7. 提昇作業環境舒適度 8. 污染預防	1. 減少耗能與CO2減量 2. 防範周界臭味 3. 延長設備使用壽命 4. 減廢/減量/資源回收 5. 降低周界噪音 6. 減少能源耗用 7. 提昇作業環境舒適度 8. 污染預防
支出金額	NT$308,843仟元	NT$120,217仟元
(3) 改善後之影響		
對淨利之影響	約增加NT$244,299仟元	約增加NT$116,794仟元
對競爭地位之影響	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

(三) 環境與綠色產品政策

環境保護是我們責無旁貸的重要責任，本公司承諾做好環境污染預防、綠色產品設計與製造及持續改善之工作，以響應全球環保運動。

本公司環境政策如下：

- 符合政府環保法規及綠色產品相關法規規定。
- 教育員工，提昇全體員工環境保護及綠色產品意識。
- 在環境保護上，加強廢水、廢氣、廢棄物、噪音、毒化物等對環境的衝擊污染控制、改善，並注重污染預防工作。在綠色產品上，逐步採用綠色設計、綠色材料、綠色製程與生產，減少產品對環境的衝擊，提昇客戶滿意度。
- 節約能源及資源，進行資源回收。
- 在環境保護的相關議題上與大衆及相關團體做密切的溝通與合作。
- 承諾持續改善，確保永續經營。
- 傳達本政策，使大衆和相關團體了解日月光集團於環境保護與綠色產品管理上的企圖心。

(四) 安全衛生政策

本公司承諾提供員工一個符合安衛法規的最佳作業場所。

本公司的承諾如下：

- 致力符合適用之安衛法令及公司所簽訂關於安衛危害之其他規章或要求事項。
- 持續改善安衛管理與績效，預防傷害事故與疾病的發生，並且確信災害的損失可經由完善管理系統的運作達到控制。
- 提供完整的教育訓練，以提昇員工的安全知能，並與員工及其代表進行諮詢，以確保安衛管理系統所有的活動可以成功地運作。

- 分級輔導供應商與承攬商符合安衛法令及相關要求。
- 對所有為組織或代表組織工作的人、大衆及相關團體傳達我們致力於工作環境安全衛生改善的決心。

日月光半導體製造股份有限公司南投廠，對於所提供之產品、活動或服務，除了不斷追求高品質外，為了保護環境及員工安全健康並善盡社會責任，在環安衛管理系統之準則下，公司將以有限資源做最合理之利用，並承諾公司之活動、產品或服務，其性質及規模對環境衝擊及員工安全衛生之危害風險是合宜的，且要求公司每一份子遵守下列行動方案:

- 遵守法令、響應環保 承諾持續遵守政府環境安全衛生法令規章及其他相關規定要求，並響應全球環保運動。
- 危害預防、溝通訓練 持續對員工、供應商、承攬商進行環境安全衛生政策、知識與要求之溝通、參與及諮詢，並進行相關之訓練與演練，以降低安全衛生之危害風險與事件之發生。
- 污染預防、持續改善 致力污染預防、提升產品環境績效，落實持續改善。
- 節能減廢、有效使用 透過節約能源、工業減廢、資源回收，以提高資源之有效使用。
- 建立目標、永續經營 遵照ISO14001 & OHSAS18001之規定，建立環安衛管理系統，以設定及符合環境安全衛生目標與標的，並審查其績效以達永續經營。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施

本公司體認勞資一體的關係，於民國九十七年股東會中決議，除自每年所得盈餘中提撥7%~10%作為員工紅利外，復全面改善福利文康設施，舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等，使得全廠員工均有調劑身心的機會，並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下：

- 免費提供員工及眷屬團體醫療保險。
- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議。
- 成立勞工安全衛生督導委員會。
- 成立福利委員會辦理各項員工福利。
- 自助餐廳及福利社。
- 結婚禮金、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險1,500萬元。
- 假日安親措施。
- 假日免費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心。
- 員工認股權憑證。

(二) 員工進修及其實施情形

- 員工在職進修取得相關科系學歷者，可參加學歷升級考試，並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道，辦理「職訓局」台德菁英計劃。

(三) 員工訓練及其實施情形

- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練(OJT)。
- 培育公司內部專業講師與訓練師。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。
- 為有效整合公司資源，本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」，此辦法分為兩大項目：外訓(部門派外受訓)以及證照補助(個人自主學習補助)。為提高員工素質且鼓勵員工自主學習，工作之餘進修培養專業技術，強化個人專業職能，充實業務相關技能，利用外部訓練培養專業技術以彌補企業內訓之不足，並設立公司統一審核與課後回饋機制，以利公司外訓制度之推行，結合外訓與出差電子系統以利主管管控。
- 自主學習補助每人每次補助總訓練費用50%，以壹萬元為上限，採課後補助原則，由員工先行自費報名，於課程結束取得證照後三個月內，檢具附件向訓練部門進行補助申請。
- 本公司一〇一年度員工訓練費用合計新台幣11,086,848元。
- 本公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形如下：本公司內部稽核人員取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書者計有一人。

(四) 退休制度及實施情形

- 本公司自民國七十五年十一月起即遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法，並設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休準備金存入台灣銀行，勞工退休時可請領退休金。
- 本公司自民國九十四年七月起即遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法，每月提撥薪資之6%存入勞保局退休金專戶，勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 優惠退休條件：工作滿十四年以上，年齡與工作年資合計滿六十八以上者，或工作滿十年以上且年齡滿六十歲者，得自請退休。

(五) 勞資協議情形

- 本公司設有書面及電子化員工溝通管道，且各廠均定期召開員工座談會，溝通良好，無重大勞資糾紛之情事。

(六) 各項員工權益維護措施

- 依勞動基準法，保障員工權益。
- 依性別工作平等法，提供一兩性平權及無性騷擾的工作環境。

(七) 工作環境與員工人身安全之保護措施(本公司為保護員工免於受職業傷害所做之措施)

- OHSAS18001及TOSHMS台灣職安衛管理系統持續驗證。
- 持續運作廠區安全衛生績效評核，辦理年度安全衛生優良廠區頒獎。
- 持續強化承攬商協議組織會議運作，結合承攬商安全衛生評核機制，辦理年度安全衛生優良承攬商頒獎。
- 強化承攬商協議組織會議運作，結合承攬商安全衛生評核機制，辦理年度安全衛生優良承攬商頒獎。
- 廠區健康風險評估模式建立及健康管理制度推動。
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案。
- 機台安全防護改善持續推動。
- 新建廠消防系統設計導入NFPA(National Fire Protection Association, 美國國家防火協會)規定，強化消防安全設施。
- 輔導主要承攬商建立自主安全衛生管理系統。

- 持續推動承攬商自主職業安全衛生管理系統OHSAS18001建構與查證。
- 建構承攬安全管理團隊。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之國家工安獎選拔。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之全國勞工安全衛生優良單位選拔。
- 廠區高風險區域現場指揮官應變演練。
- 持續推動廠區機台及加藥系統作業安全防護強化。
- 持續進行廠區週界風險評估及改善，強化廠區消防安全。
- 持續推動EICC電子電機產業社會行為準則管理規範並完成查證。
- 持續推動廠區安全文化評量系統，強化提升廠區安全文化水平。
- 舉辦健康&安全文化月活動。
- 建立「日月光緊急應變網頁」結合廠區「指揮官體系」強化防颱應變的防護能力。

(八) 各項員工工作守則及倫理原則

- 與主管有不同看法時，以「對事不對人」的態度，選擇適當時間、地點，與主管誠懇的溝通，勿在訪客或他人面前強烈的表示不同的意見。
- 會議須準時參加，不克出席應事先請代理人出席，並說明需準備之文件資料，並同時知會會議主持人。
- 與廠商開會若有跨越中晚餐時間，可以幫廠商代訂便當，再向公司報帳，勿與廠商外出交際應酬。
- 嚴禁私自攜帶公司產品、零件、貨品出加工區，出廠區物品務須配合保稅放行單，未依規定辦理者，經查獲，依相關法令處理。
- 尊重公司名譽，凡涉及公司任何事項，未經許可，不得擅自對外發佈個人意見。
- 培養誠實與負責任的文化。在公司所有的營業活動上應遵循最高道德標準的承諾。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括目前及未來可能發生之估計金額及因應措施)：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期或訂約日期	主要內容	限制條款
業務契約	ASE (U.S.) INC.	2013.01.01-2013.12.31	業務代理	
業務契約	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2012.01.01-2013.12.31	業務代理	
土地租約	經濟部加工出口區管理處	2013.02.01-2023.01.31	土地租賃	於租約有效期間內，不得轉作與業務不相關之用，且依約執行付款
聯貸契約	花旗銀行等28家銀行	2008.03-2013.03	台幣長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等24家銀行	2010.06-2015.06	台幣及美金長借契約	財務比率限制等
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04.13-2013.4.12 (Annually renew)	專利授權	於合約終止或取消五年內，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (FOC/RDL)(ULCSP)	2008.03.07-所授權專利技術屆期為止	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	TESSERA U.S.A.	1998.01-授權專利屆期為止	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Mitsui High-tec, Inc.	2007.06.25-2013.06.24 (Annually renew)	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06-2017.11.05 (Annually renew)	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	矽品精密工業股份有限公司暨其關係企業	2009.05.10-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	STATs Chippac Ltd.	2012.01.1-2016.12.31	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2013.04.11-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
廠房租賃	環鴻科技股份有限公司	2011.04-2013.03	廠房租賃	於租約有效期間內，不得從事有關變更建築物結構之工程、任何裝潢改裝、設備安裝工程等應符合加工出口區環保安全法令規章之規定

註：係為截至年報刊印日止之資料。

陸、財務概況

依據公開發行公司年報應行記載事項準則第三章附則第23-1條規定，“本準則中華民國一百零一年九月二十日修正發布之第十九條第一項第一款、第二款、第四款及第五款，其適用情形如下：股票於證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公開發行股票公司，應自一百零三會計年度適用。”故本公司今年度尚未揭露該新格式。

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料(註1)				
		一〇一年底	一〇〇年底	九十九年底	九十八年底	九十七年底
流動資產		18,147,566	17,147,117	16,752,587	17,591,613	11,426,119
基金及投資		110,891,285	106,619,178	101,583,798	80,340,959	77,506,660
固定資產		57,233,865	44,897,565	38,809,576	30,383,071	29,296,724
無形資產		1,222,757	1,023,803	1,044,022	1,069,754	1,095,651
其他資產		1,505,088	1,390,944	3,436,477	3,887,601	4,606,092
資產總額		189,000,561	171,078,607	161,626,460	133,272,998	123,931,246
流動負債	分配前	42,712,691	31,159,171	24,443,453	18,104,951	8,550,167
	分配後	42,712,691 (註2)	35,484,455	28,375,872	20,083,141	11,286,735
長期負債		34,625,670	37,453,501	47,373,743	42,479,131	44,707,225
其他負債		2,147,315	1,296,399	1,252,895	1,072,890	1,001,860
負債總額	分配前	79,485,676	69,909,071	73,070,091	61,656,972	54,259,252
	分配後	79,485,676 (註2)	74,234,355	77,002,510	63,635,162	56,995,820
股　　本		76,047,667	67,571,325	60,819,570	54,933,988	56,907,665
資本公積		8,767,134	7,397,481	7,180,585	6,333,755	6,373,287
保留盈餘	分配前	26,969,183	27,809,126	24,972,944	13,229,409	9,221,404
	分配後	26,969,183 (註2)	14,167,847	14,083,168	6,635,443	6,484,836
金融商品之未實現(損)益		401,938	235,088	246,303	25,498	(439,438)
累積換算調整數		119,987	3,353,938	(1,120,618)	3,276,508	4,873,957
未認列為退休金成本之淨損失		(831,917)	(465,681)	(398,103)	(248,641)	(230,401)
股東權益總額	分配前	109,514,885	101,169,536	88,556,369	71,616,026	69,671,994
	分配後	109,514,885 (註2)	96,844,252	84,623,950	69,637,836	66,935,426

註1：(1)最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。
(2)最近五年度均未曾辦理資產重估。
註2：截至年報刊印日止，本公司一〇二年股東常會尚未召開，是以分配後金額暫以分配前金額列示。

2. 簡明損益表

單位：新台幣仟元

項目＼年度	最近五年度財務資料(註3)				
	一〇一年度	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度
營業收入	72,926,652	69,439,165	67,339,406	46,134,314	48,451,017
營業毛利	18,365,510	17,720,164	16,705,791	10,579,841	10,538,763
營業淨利	10,732,774	10,859,132	10,361,203	5,818,771	5,487,648
營業外收入及利益	5,659,159	6,298,044	11,237,285	4,052,832	4,059,355
營業外費用及損失	1,806,747	2,104,588	2,565,899	2,203,912	2,205,500
繼續營業部門稅前損益	14,585,186	15,052,588	19,032,589	7,667,691	7,341,503
繼續營業部門損益	13,091,359	13,725,958	18,337,500	6,744,546	6,160,052
停業部門損益	–	–	–	–	–

項目 \ 年度	最近五年度財務資料(註3)				
	一〇一年度	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度
非常損益	–	–	–	–	–
會計原則變動之累積影響數	–	–	–	–	–
本期淨利	13,091,359	13,725,958	18,337,500	6,744,546	6,160,052
每股盈餘(元/股) (追溯調整後)					
基本每股盈餘	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82
稀釋每股盈餘	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80

註3：a.最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。
b.最近五年度均未曾辦理資產重估。
c.各年度利息資本化金額如下：

一〇一年度	86,389仟元
一〇〇年度	43,746仟元
九十九年度	43,533仟元
九十八年度	22,603仟元
九十七年度	55,051仟元

3. 最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
一〇一	陳珍麗	龔俊吉	無保留意見
一〇〇	龔俊吉	邱慧吟	無保留意見
九十九	龔俊吉	邱慧吟	修正式無保留意見
九十八	龔俊吉	邱慧吟	修正式無保留意見
九十七	龔俊吉	郭麗園	修正式無保留意見

二、最近五年度財務分析

分析項目 \ 年度			最近五年度財務分析(註1)				
			一〇一年度	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度
財務結構	負債占資產比率(%)		42.06	40.86	45.21	46.29	43.78
	長期資金占固定資產比率(%)		251.84	308.75	350.25	375.75	390.42
償債能力	流動比率(%)		42.49	55.03	68.54	97.16	133.64
	速動比率(%)		32.72	41.72	54.26	80.43	105.10
	利息保障倍數		21.33	17.85	18.95	8.16	9.62
經營能力	應收款項週轉率(次)		7.10	7.13	7.08	6.51	6.64
	平均收現日數		51	51	52	56	55
	存貨週轉率(次)		15.98	16.68	20.27	19.81	19.73
	應付款項週轉率(次)		7.42	7.17	7.43	7.23	7.52
	平均銷貨日數		23	22	18	18	18
	固定資產週轉率(次)		1.27	1.55	1.74	1.52	1.65
	總資產週轉率(次)		0.39	0.41	0.42	0.35	0.39
獲利能力	資產報酬率(%)		7.60	8.70	13.03	5.87	6.02
	股東權益報酬率(%)		12.43	14.47	22.90	9.55	8.51
	占實收資本比率(%)	營業利益	14.11	16.07	17.04	10.28	10.46
		稅前純益	19.18	22.28	31.29	13.96	12.90
	純益率(%)		17.95	19.77	27.23	14.62	12.71
	每股盈餘(純損)元/股 (追溯調整後)	基本	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82
		稀釋	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80

分析項目	年　　度	最近五年度財務分析(註1)				
		一〇一年度	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度
現金流量	現金流量比率(%)	49.27	75.82	80.59	57.85	185.34
	現金流量允當比率(%)	121.40	134.49	131.81	145.21	124.31
	現金再投資比率(%)	8.24	10.17	9.54	4.76	4.10
槓桿度	營運槓桿度	3.34	3.10	3.04	3.95	4.50
	財務槓桿度	1.07	1.09	1.11	1.23	1.17

說明最近二年度各項財務比率變動原因：

(1)本公司流動比率、速動比率及現金流量比率降低，主要係營運需要向子公司融通資金致其他應付款項增加所致。

(2)本公司資產報酬率及股東權益報酬率降低，主要係部分子公司因景氣變化產生虧損及因初期創業階段之故，導致資產報酬率及股東權益報酬率降低。

註1：最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

註2： 財務分析項目之計算公式如下：

計算公式：

1. 財務結構
   (1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
   (2)長期資金占固定資產比率＝(股東權益淨額＋長期負債)／ 固定資產淨額。
2. 償債能力
   (1)流動比率＝流動資產／流動負債。
   (2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債。
   (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
3. 經營能力
   (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
   (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
   (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
   (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
   (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
   (6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
   (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
4. 獲利能力
   (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×(１－稅率)〕／ 平均資產總額。
   (2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
   (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
   (4)每股盈餘＝(稅後淨利－特別股股利)／加權平均已發行股數。(註3)
5. 現金流量
   (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
   (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
   (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。(註4)
6. 槓桿度：
   (1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／ 營業利益(註5)。
   (2)財務槓桿度＝營業利益 ／(營業利益－利息費用)。

註3：每股盈餘之計算公式：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

註5：各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動。

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告

董事會造送本公司一〇一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及龔俊吉會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配議案等表冊，移由本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察為荷。

此　　致

本公司民國一〇二年股東常會

日月光半導體製造股份有限公司

監察人：　曾元一　　潘士華　　陳天賜　　李俊哲　　張能超

中華民國一〇二年四月十六日

四、最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表：

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司　公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司(日月光公司)民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

日月光公司已編製其與子公司民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師查核及出具無保留意見之查核報告，備供參考。

隨附日月光公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述之財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　陳珍麗

會計師　龔俊吉

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第1010028123號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

中華民國一〇二年三月四日

日月光半導體製造股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

代碼	資產	一〇一年十二月三十一日 金額	%	一〇〇年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四)	$ 1,694,430	1	$ 1,475,629	1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註二及五)	9,070	–	471,383	–
1320	備供出售金融資產－流動(附註二)	–	–	20,152	–
1140	應收帳款淨額(附註二、三及六)	10,685,080	6	9,729,994	6
1153	應收帳款－關係人(附註二、三及二三)	52,117	–	62,371	–
1178	其他應收款(附註三)	1,188,383	–	811,196	1
1180	其他應收款－關係人(附註三及二三)	253,262	–	305,919	–
120X	存貨(附註二及七)	3,538,679	2	3,292,068	2
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及十九)	397,233	–	691,776	–
1298	其他流動資產	329,312	–	286,629	–
11XX	流動資產合計	18,147,566	9	17,147,117	10
	基金及投資				
1450	備供出售金融資產－非流動(附註二)	67,146	–	4,675	–
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註二及八)	384,161	–	380,680	–
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及九)	110,439,978	59	106,233,823	62
14XX	基金及投資合計	110,891,285	59	106,619,178	62
	固定資產(附註二、十、二三及二五)				
1501	土地	1,558,201	1	1,558,201	1
1521	建築物及附屬設備	25,838,129	14	21,964,804	13
1531	機器設備	83,244,505	44	71,586,364	42
1551	運輸設備	69,066	–	68,522	–
1561	辦公設備	956,306	–	876,756	–
1611	租賃資產	–	–	1,351	–
15X1	成本合計	111,666,207	59	96,055,998	56
15X9	減：累計折舊	57,687,418	31	54,635,664	32
1599	累計減損	188,631	–	44,146	–
		53,790,158	28	41,376,188	24
1671	未完工程	512,657	–	765,382	–
1672	在途機器及預付設備款	2,931,050	2	2,755,995	2
15XX	固定資產合計	57,233,865	30	44,897,565	26
	無形資產(附註二)				
1760	商譽	957,167	1	957,167	1
1770	遞延退休金成本	34,417	–	37,655	–
1780	其他無形資產	231,173	–	28,981	–
17XX	無形資產合計	1,222,757	1	1,023,803	1
	其他資產				
1800	出租資產(附註二、十一及二三)	1,035,628	1	661,672	1
1810	閒置資產	4,744	–	4,744	–
1820	存出保證金	23,446	–	15,147	–
1830	遞延費用(附註二)	206,765	–	499,394	–
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註二及十九)	–	–	60,240	–
1887	受限制資產(附註二四)	179,929	–	149,747	–
1888	其他資產－其他	54,576	–	–	–
18XX	其他資產合計	1,505,088	1	1,390,944	1
1XXX	資產總計	$ 189,000,561	100	$ 171,078,607	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代碼	負債及股東權益	一〇一年十二月三十一日 金額	%	一〇〇年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十二)	$ 5,510,723	3	$ 302,750	–
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動(附註二及五)	350,654	–	56,514	–
2200	避險之衍生性金融負債－流動(附註二及二二)	4,524	–	–	–
2140	應付帳款	6,475,471	4	6,231,424	4
2150	應付帳款－關係人(附註二三)	1,119,382	1	878,306	–
2160	應付所得稅	752,843	–	944,631	–
2170	應付費用(附註十三及十六)	4,898,542	3	4,700,158	3
2190	其他應付款－關係人(附註二三)	19,046,515	10	14,632,851	9
2224	應付設備款	2,553,762	1	2,747,285	2
2228	其他應付款	746,456	–	442,414	–
2272	一年內到期長期借款(附註十五)	1,028,571	1	–	–
2298	其他流動負債	225,248	–	222,838	–
21XX	流動負債合計	42,712,691	23	31,159,171	18
	長期負債				
2430	避險之衍生性金融負債－非流動(附註二及二二)	–	–	58,279	–
2410	應付公司債(附註十四)	7,823,571	4	7,783,910	5
2420	長期借款(附註十五)	26,802,099	14	29,611,312	17
24XX	長期負債合計	34,625,670	18	37,453,501	22
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註十六)	1,599,049	1	1,295,041	1
2820	存入保證金	4,358	–	1,358	–
2860	遞延所得稅負債－非流動(附註二及十九)	543,908	–	–	–
28XX	其他負債合計	2,147,315	1	1,296,399	1
2XXX	負債合計	79,485,676	42	69,909,071	41
	股本(附註十七)				
3110	普通股股本－每股面額10元，額定股數為9,500,000千股；發行股數一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別為7,594,150千股及6,753,563千股	75,941,496	40	67,535,632	40
3140	預收股本	106,171	–	35,693	–
31XX	股本合計	76,047,667	40	67,571,325	40
	資本公積(附註二、十七及十八)				
3210	發行股票溢價	1,704,700	1	1,615,449	1
3220	庫藏股票交易	83,117	–	1,402,632	1
3260	長期投資	5,690,964	3	3,522,280	2
3271	員工認股權	1,288,353	1	857,120	–
32XX	資本公積合計	8,767,134	5	7,397,481	4
33XX	保留盈餘(附註十七)	26,969,183	14	27,809,126	16
	股東權益其他項目(附註二及十七)				
3450	金融商品未實現利益	401,938	–	235,088	–
3420	累積換算調整數	119,987	–	3,353,938	2
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(831,917)	–	(465,681)	–
3480	庫藏股票－一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別為145,883千股及233,456千股	(1,959,107)	(1)	(4,731,741)	(3)
34XX	股東權益其他項目淨額	(2,269,099)	(1)	(1,608,396)	(1)
3XXX	股東權益合計	109,514,885	58	101,169,536	59
	負債及股東權益總計	$ 189,000,561	100	$ 171,078,607	100

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司

損益表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼		一〇一年度 金額	一〇一年度 %	一〇〇年度 金額	一〇〇年度 %
	營業收入(附註二)				
4110	銷貨收入	$ 73,872,217	101	$ 69,975,733	101
4190	減：銷貨退回及折讓	945,565	1	536,568	1
4100	營業收入淨額	72,926,652	100	69,439,165	100
5000	營業成本(附註七、二十及二三)	54,561,142	75	51,719,001	74
5910	營業毛利	18,365,510	25	17,720,164	26
	營業費用(附註二、二十及二三)				
6300	研究發展費用	3,827,357	5	3,094,997	5
6100	推銷費用	860,445	1	771,976	1
6200	管理及總務費用	2,944,934	4	2,994,059	4
6000	合　計	7,632,736	10	6,861,032	10
6900	營業淨利	10,732,774	15	10,859,132	16
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	3,201	–	4,642	–
7310	金融資產評價利益－淨額(附註二及五)	2,218	–	757,669	1
7320	金融負債評價利益－淨額(附註二及五)	–	–	58,962	–
7121	權益法認列之投資收益(附註二及九)	4,335,611	6	4,497,292	6
7122	股利收入(附註二)	29,683	–	607,403	1
7160	兌換利益－淨額(附註二)	954,021	1	–	–
7480	其他(附註十一)	334,425	1	372,076	1
7100	合　計	5,659,159	8	6,298,044	9
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註二、十及二三)	717,451	1	893,343	1
7650	金融負債評價損失－淨額(附註二及五)	782,396	1	–	–
7560	兌換損失－淨額(附註二)	–	–	653,041	1
7630	減損損失(附註十)	27,974	–	164,770	–
7880	其　他	278,926	1	393,434	1
7500	合　計	1,806,747	3	2,104,588	3
7900	稅前淨利	14,585,186	20	15,052,588	22
8110	所得稅費用(附註二及十九)	1,493,827	2	1,326,630	2
9600	本期淨利	$ 13,091,359	18	$ 13,725,958	20

代碼		一〇一年度		一〇〇年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基本每股盈餘	$ 1.96	$ 1.76	$ 2.00	$ 1.83
9850	稀釋每股盈餘	$ 1.91	$ 1.71	$ 1.95	$ 1.78

假設子公司持有本公司股票不視為庫藏股票而作為備供出售金融資產時之擬制性資料(稅後金額)：

	一〇一年度	一〇〇年度
計算基本每股盈餘之淨利	$ 13,174,476	$ 13,800,118
計算稀釋每股盈餘之淨利	$ 13,066,844	$ 13,800,118
基本每股盈餘，一〇一及一〇〇年度分別按加權平均股數7,591,352千股及7,660,602千股計算	$ 1.74	$ 1.80
稀釋每股盈餘，一〇一及一〇〇年度分別按加權平均股數7,721,779千股及7,845,920千股計算	$ 1.69	$ 1.76

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

代碼		股本 普通股股本	股本 預收股本	股本 資本公積
A1	一〇〇年一月一日餘額	$ 60,519,872	$ 299,698	$ 7,180,585
	九十九年度盈餘分配(附註十七)			
N1	提列法定盈餘公積	–	–	–
N5	提列特別盈餘公積	–	–	–
P5	普通股股票股利－11.5%	6,957,357	–	–
P1	普通股現金股利－6.5%	–	–	–
S5	採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	–	–	(4,960)
Q5	備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–
J8	發放予子公司股利調整資本公積	–	–	74,160
Q7	現金流量避險未實現損益增減	–	–	–
L1	員工認股權發行	–	–	537,973
G1	員工認股權行使	428,403	(264,005)	424,928
M1	本期損益	–	–	–
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	–	–	–
R1	未認列為退休金成本之淨損失增減	–	–	–
J1	庫藏股票買回－105,475千股	–	–	–
J3	庫藏股票註銷－37,000千股	(370,000)	–	(815,205)
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	67,535,632	35,693	7,397,481
	一〇〇年度盈餘分配(附註十七)			
N1	提列法定盈餘公積	–	–	–
P5	普通股股票股利－14.0%	9,315,995	–	–
P1	普通股現金股利－6.5%	–	–	–
E9	特別盈餘公積迴轉	–	–	–
S5	採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	–	–	2,168,684
Q5	備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–
J8	發放予子公司股利調整資本公積	–	–	83,117
Q7	現金流量避險未實現損益增減	–	–	–
L1	員工認股權發行	–	–	445,120
G1	員工認股權行使	144,619	70,478	100,593
M1	本期損益	–	–	–
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	–	–	–
R1	未認列為退休金成本之淨損失增減	–	–	–
J3	庫藏股票註銷－105,475千股	(1,054,750)	–	(1,427,861)
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	$ 75,941,496	$ 106,171	$ 8,767,134

後附之附註係本財務報表之一部分。

單位：新台幣千元

保留盈餘				股東權益其他項目				
法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	金融商品未實現利益	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票	股東權益合計
$ 4,205,489	$ —	$ 20,767,455	$ 24,972,944	$ 246,303	($1,120,618)	($ 398,103)	($ 3,144,312)	$ 88,556,369
1,833,750	—	(1,833,750)	—	—	—	—	—	—
—	1,272,417	(1,272,417)	—	—	—	—	—	—
—	—	(6,957,357)	(6,957,357)	—	—	—	—	—
—	—	(3,932,419)	(3,932,419)	—	—	—	—	(3,932,419)
—	—	—	—	(174,005)	—	(68,355)	—	(247,320)
—	—	—	—	9,290	—	—	—	9,290
—	—	—	—	—	—	—	—	74,160
—	—	—	—	153,500	—	—	—	153,500
—	—	—	—	—	—	—	—	537,973
—	—	—	—	—	—	—	—	589,326
—	—	13,725,958	13,725,958	—	—	—	—	13,725,958
—	—	—	—	—	4,474,556	—	—	4,474,556
—	—	—	—	—	—	777	—	777
—	—	—	—	—	—	—	(2,772,634)	(2,772,634)
—	—	—	—	—	—	—	1,185,205	—
6,039,239	1,272,417	20,497,470	27,809,126	235,088	3,353,938	(465,681)	(4,731,741)	101,169,536
1,372,596	—	(1,372,596)	—	—	—	—	—	—
—	—	(9,315,995)	(9,315,995)	—	—	—	—	—
—	—	(4,325,284)	(4,325,284)	—	—	—	—	(4,325,284)
—	(1,272,417)	1,272,417	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	148,355	—	(32,010)	—	2,285,029
—	—	—	—	(26,122)	—	—	—	(26,122)
—	—	—	—	—	—	—	—	83,117
—	—	—	—	44,617	—	—	—	44,617
—	—	—	—	—	—	—	—	445,120
—	—	—	—	—	—	—	—	315,690
—	—	13,091,359	13,091,359	—	—	—	—	13,091,359
—	—	—	—	—	(3,233,951)	—	—	(3,233,951)
—	—	—	—	—	—	(334,226)	—	(334,226)
—	—	(290,023)	(290,023)	—	—	—	2,772,634	—
$ 7,411,835	$ —	$ 19,557,348	$ 26,969,183	$ 401,938	$ 119,987	($ 831,917)	($ 1,959,107)	$ 109,514,885

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司

現金流量表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	$ 13,091,359	$ 13,725,958
A20000	調整項目		
A20300	折舊費用	8,606,430	7,512,725
A20400	攤銷費用	309,630	388,197
A21200	股份基礎給付酬勞成本	327,221	398,496
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	152,082	123,712
A22400	權益法認列之投資收益	(4,335,611)	(4,497,292)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	2,223,664	5,791,158
A23700	金融資產減損損失	—	93,370
A23900	非金融資產減損損失	27,974	71,400
A24800	遞延所得稅費用	889,553	521,427
A29900	其他調整項目	(162,545)	712,059
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產減少(增加)	462,313	(398,797)
A31140	應收帳款增加	(957,762)	(142,932)
A31150	應收帳款－關係人減少	10,254	37,163
A31160	其他應收款增加	(383,395)	(132,929)
A31170	其他應收款－關係人減少(增加)	212,694	(141,278)
A31180	存貨增加	(398,693)	(505,456)
A31990	其他營業資產增加	(94,405)	(88,950)
A32110	交易目的金融負債增加(減少)	294,140	(432,255)
A32140	應付帳款增加(減少)	238,698	(172)
A32150	應付帳款－關係人增加(減少)	235,105	(212,368)
A32160	應付所得稅(減少)增加	(312,840)	200,409
A32170	應付費用增加	174,189	412,503
A32180	其他應付款項增加	101,522	58,833
A32190	其他應付款－關係人增加	331,108	73,071
A32212	其他流動負債增加	713	57,192
AAAA	營業活動之淨現金流入	21,043,398	23,625,244
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(168,441)	(150,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	100,008	150,062
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(3,481)	(30,914)
B01101	以成本衡量之金融資產減資退回股款	—	14,785
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(5,148,884)	(895,405)
B01800	採權益法之被投資公司減資退回股款	—	904,587
B01900	購置固定資產	(21,411,234)	(12,121,952)
B02000	處分固定資產及出租資產價款	121,566	939,261
B03501	合併子公司產生之現金流入	806,196	—
B04100	向子公司購入應收帳款(附註九)	—	(1,081,071)
B09900	其他投資活動	(247,398)	(307,658)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(25,951,668)	(12,578,305)
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	5,207,973	302,750
C00400	發行公司債	—	7,756,810
C00900	舉借長期借款	11,224,941	20,717,740
C01000	償還長期借款	(12,744,543)	(39,114,209)
C01701	其他應付款－關係人增加	5,449,393	5,249,447
C02100	發放現金股利	(4,325,284)	(3,932,419)
C02400	員工執行認股權	315,690	589,326
C02500	庫藏股票買回成本	—	(2,772,634)
C09900	其他融資活動	(1,099)	(223)
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	5,127,071	(11,203,412)
EEEE	本年度現金淨增加(減少)金額	218,801	(156,473)
E00100	年初現金餘額	1,475,629	1,632,102

單位：新台幣千元

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
E00200	年底現金餘額	$ 1,694,430	$ 1,475,629
FFFF	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	本年度支付利息	$ 829,694	$ 917,468
F00200	減：資本化利息	86,389	43,746
F00300	不含資本化利息之本年度支付利息	$ 743,305	$ 873,722
F00400	支付所得稅	$ 921,148	$ 608,471
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動		
H00300	固定資產增加數	$ 21,230,093	$ 13,586,160
H00500	應付購買設備款減少(增加)	181,141	(1,464,208)
H00800	購買固定資產支付現金數	$ 21,411,234	$ 12,121,952
H00900	出售固定資產及出租資產價款	$ 266,056	$ 891,973
H01000	其他應收款(增加)減少－出售固定資產	(144,490)	47,288
H01100	出售固定資產及出租資產收取現金數	$ 121,566	$ 939,261
	長期股權投資退回款項	$ －	$ －
	其他應收款－關係人減少	－	904,587
	收取現金數	$ －	$ 904,587
	採權益法之長期股權投資增加數	$ －	$ 1,976,476
	以應收款項償付	－	(1,081,071)
	支付現金數	$ －	$ 895,405
GGGG	不影響現金流量之融資活動		
G00100	一年內到期之長期負債	$ 1,028,571	$ －

本公司於一〇一年五月一日(合併基準日)吸收合併子公司日月鴻科技公司(消滅公司)，該公司截至合併基準日止相關資產負債列示如下：

現　　金	$ 806,196
應收帳款	28,950
其他應收款(含關係人)	1,389,340
其他流動資產	7,967
長期股權投資	1,324,528
固定資產	369,546
其他資產	77,744
	4,004,271
應付帳款(含關係人)	(11,320)
應付所得稅	(121,052)
應付費用	(24,195)
應付設備款	(781)
其他流動負債	(8,315)
長期應付款	(200,000)
其他負債	(7,361)
	(373,024)
取得淨資產	$ 3,631,247

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司

財務報表附註

民國一〇一及一〇〇年度 (除另為註明外，金額以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

本公司於七十三年三月設立於高雄楠梓加工出口區；九十三年八月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司並設立中壢分公司；九十五年八月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子)；一〇〇年一月經核准設立南投分公司；一〇一年五月吸收合併子公司日月鴻科技公司。本公司所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票在台灣證券交易所掛牌上市(股票代碼：2311)，另發行美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所掛牌上市，代號為ASX。

截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止，本公司員工人數分別約為22,100人及19,500人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

(一)外幣交易

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產、負債、收入或費用，按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳。外幣資產及負債於實際收付結清時所產生之兌換差額，作為當年度損益。

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債，按該日即期匯率予以調整，兌換差額列為當年度損益。

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債(例如權益商品)，依公平價值衡量者，按該日即期匯率調整，所產生之兌換差額，屬公平價值變動認列為股東權益調整項目者，列為股東權益調整項目；屬公平價值變動認列為損益者，列為當年度損益。以成本衡量者，則按交易日之歷史匯率衡量。

外幣長期投資採權益法評價者，以被投資公司之外幣財務報表換算後所得之股東權益為依據，兌換差額列入累積換算調整數，作為股東權益之調整項目。

(二) 會計估計

依照前述準則、法令及原則編製財務報表時，必須使用合理之估計金額，因估計涉及判斷，實際結果可能有所差異。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金，以及主要為交易目的而持有之資產或預期於資產負債表日後十二個月內變現或耗用之資產；固定資產、無形資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資產。流動負債包括主要為交易目的而發生之負債，以及須於資產負債表日後十二個月內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

(四) 公平價值變動列入損益之金融資產或負債

公平價值變動列入損益之金融商品係交易目的之金融資產或金融負債。本公司成為金融商品合約之一方時，認列金融資產或金融負債；於對合約權利喪失控制時，除列金融資產；於合約規定之義務解除、取消或到期而使金融負債消滅時，除列金融負債。

原始認列時，係以公平價值衡量，交易成本列為當年度費用；續後評價時，以公平價值衡量且公平價值變動認列為當年度損益。金融商品除列時，出售所得價款或支付金額與帳面價值之差額，計入當年度損益。

衍生性商品未能符合避險會計者，係分類為交易目的之金融資產或金融負債。公平價值為正值時，列為金融資產；公平價值為負值時，列為金融負債。

無活絡市場之金融商品，以評價方法估計其公平價值。

(五) 備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時，以公平價值衡量，並加計取得之交易成本；續後評價以公平價值衡量，且其價值變動列為股東權益調整項目，累積之利益或損失於金融資產除列時，列入當年度損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。

備供出售金融資產之認列或除列時點，以及公平價值之基礎，均與公平價值變動列入損益之金融商品相同。

若有減損之客觀證據，則認列減損損失。若後續期間減損金額減少，備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目。

(六) 避險會計

指定且為有效避險工具之衍生性金融商品係以公平價值評價，且其價值變動依所規避之風險列為當年度損益或股東權益調整項目。

符合現金流量避險會計之所有條件時，以互抵方式認列避險工具及被避險項目之公平價值變動所產生之損益影響數，避險工具之利益或損失屬有效避險部分，扣除相關所得稅影響數後認列為股東權益調整項目，並於被避險之預期交易或該預期交易產生之資產或負債影響淨損益時，轉列為當年度損益。但認列為股東權益調整項目之淨損失預期無法回收之金額，立即轉列當年度損失。

(七) 以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資以原始認列之成本衡量。現金股利於除息日認列收益；股票股利不認列為投資收益，僅於除權日註記股數增加，並按增加後之總股數重新計算每股成本。若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不得迴轉。

(八) 應收帳款之減損評估

於每一資產負債表日對應收帳款評估其減損跡象。先評估個別應收帳款是否有減損之客觀證據，再以組合基礎就過去收款經驗及與應收帳款違約有關之可觀察因素等評估減損。

應收帳款之帳面金額係藉由備抵評價科目調整，減損損失金額則為該帳面金額與預期未來現金流量以原始有效利率折現值之差額。

(九) 資產減損

倘資產(主要為固定資產、商譽、出租資產與採權益法之長期股權投資)以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時，就其減損部分認列損失。嗣後若資產(商譽除外)可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列折舊或攤銷後之帳面價值。

對僅具重大影響力而未具控制能力之長期股權投資，則以個別長期股權投資帳面價值(含商譽)為基礎，比較個別投資之可回收金額與帳面價值以計算該投資之減損損失。

(十) 備抵折讓

備抵銷貨折讓係按估計可能發生之折讓損失提列。

(十一) 存貨

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價，在製品及製成品成本平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

(十二) 採權益法之長期股權投資

本公司持有被投資公司有表決權股份達百分之二十以上或具有重大影響力者，採用權益法評價。惟子公司持有母公司股票視同庫藏股票，子公司收取本公司發放之現金股利收入不認列投資收益，係調整資本公積－庫藏股票交易。

取得股權或首次採用權益法時，先將投資成本予以分析處理，投資成本超過可辨認淨資產公平價值部分列為商譽，商譽不

予攤銷。若可辨認淨資產公平價值超過投資成本，則其差額就各非流動資產(非採權益法評價之金融資產及遞延所得稅資產除外)公平價值等比例減少之，仍有差額時列為非常利益。

本公司與採權益法評價之被投資公司間之順、逆流交易，及採權益法評價之被投資公司間發生之側流交易，其未實現損益均已銷除。

被投資公司發行新股時，若未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積及長期投資；此項調整如應調減資本公積，而長期投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額則調減保留盈餘。

(十三) 固定資產及出租資產

土地以成本計價，土地以外之固定資產及出租資產則以成本減累計折舊及累計減損計價。固定資產購建期間為是項資產所支出款項而負擔之利息，予以資本化列為固定資產之成本。重大之更新及改良作為資本支出；修理及維護支出則作為當年度費用。

折舊採直線法依下列耐用年數計提：建築物及附屬設備，二至四十年；機器設備，二至七年；運輸設備，四至五年；辦公設備，二至八年；租賃資產，五年。

固定資產及出租資產出售或報廢時，其相關成本、累計折舊及累計減損均自帳上減除。處分利益或損失列為當年度營業外利益或損失。

(十四) 無形資產

購買之其他無形資產以取得成本為入帳基礎，採直線法依其效益年限攤銷。併購所產生之商譽則不再攤銷，每年定期進行減損測試。

(十五) 遞延費用

遞延費用包括模具及系統軟體費用等，採直線法按二至五年攤銷。

(十六) 員工退休金

屬確定給付退休辦法之退休金成本係按精算結果認列；屬確定提撥退休辦法之退休金成本，係於員工任職服務期間，按應提撥之退休金金額認列。

(十七) 所得稅

所得稅作同期間及跨期間之分攤，即(一)直接調整股東權益之項目及(二)可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列備抵評價金額；應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期迴轉期間劃分為流動或非流動項目。

投資國外子公司之長期股權投資帳面價值與課稅基礎間產生之應課稅暫時性差異，因本公司可控制該暫時性差異迴轉之時間，且於可預見之未來不會迴轉，其實質上係長久存在者，不予認列相關遞延所得稅負債。

購置機器設備及研究發展等支出所產生之所得稅抵減，採當期認列法處理。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度之所得稅。

依所得稅法規定計算之未分配盈餘課徵百分之十所得稅，列為股東會決議年度之所得稅費用。

(十八) 股份基礎給付

發行酬勞性員工認股權憑證，其給與日在九十七年一月一日(含)以後者，係依照財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」處理。按預期既得認股權之最佳估計數量及給與日公平價值計算之認股權價值，於既得期間以直線法逐期認列為費用，並同時調整資本公積－員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。

發行酬勞性員工認股權憑證，其給與日在九十六年十二月三十一日以前者，係適用財團法人中華民國會計研究發展基金會

相關解釋函，本公司選擇採用內含價值法處理，酬勞成本於符合認股權計畫所規定之員工服務年限內逐期認列為費用。

(十九) 庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時，將所支付之成本列記庫藏股票，列為股東權益之減項。註銷庫藏股票時，轉銷帳列庫藏股票，並按股權比例減列股本及與股票發行溢價相關之資本公積。庫藏股票之帳面價值高於面值與股票發行溢價合計數之差額應沖銷同種類庫藏股票所產生之資本公積，如有不足，再減列保留盈餘。

子公司持有母公司股票視同庫藏股票處理，自長期投資重分類為庫藏股票。

(二十) 收入之認列

半導體封裝收入於完成封裝或交運時認列，半導體測試收入於測試服務完成時認列，其他營業收入通常於勞務完成或商品交付客戶時認列，因其獲利過程大部分已完成，且已實現或可實現。

銷貨收入係按本公司與客戶所協議交易對價(考量商業折扣及數量折扣後)之公平價值衡量；惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收款時，其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁，則不按設算利率計算公平價值。

三、會計變動之理由及其影響

金融商品之會計處理

本公司自一〇〇年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」。主要之修訂係將原始產生之放款及應收款納入公報適用範圍。此項會計變動，對本公司一〇〇年度財務報表並無重大影響。

四、現金

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
庫存現金	$ 1,157	$ 1,251
銀行支票及活期存款	1,693,273	1,474,378
	$ 1,694,430	$ 1,475,629

五、公平價值變動列入損益之金融商品－流動

本公司分類為交易目的之金融商品相關資訊如下：

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
交易目的之金融資產－流動		
換匯合約	$ 8,945	$ 467,725
遠期外匯合約	125	3,658
	$ 9,070	$ 471,383
交易目的之金融負債－流動		
換匯合約	$ 313,034	$ 40,837
遠期外匯合約	29,721	2,717
外幣選擇權合約	7,899	－
換匯換利合約	－	12,960
	$ 350,654	$ 56,514

本公司從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避因匯率及利率波動所產生之風險，除附註二二(八)所述外，因不符有效避險條件，是以不適用避險會計。

(一) 本公司於一〇一年及一〇〇年十二月三十一日尚未到期之換匯合約如下：

幣別	到期期間	合約金額(千元)
一〇一年十二月三十一日		
新台幣兌美金	102.01～102.12	NTD28,052,585 / USD958,500
美金兌新台幣	102.01～102.02	USD46,700 / NTD1,362,135
美金兌日幣	102.01	USD5,075 / JPY430,000
一〇〇年十二月三十一日		
新台幣兌美金	101.01～101.12	NTD18,119,714 / USD617,500
美金兌新台幣	101.01～101.03	USD43,500 / NTD1,287,428
美金兌日幣	101.01	USD9,640 / JPY750,000
美金兌歐元	101.01	USD1,992 / EUR1,500

(二) 本公司於一〇一年及一〇〇年十二月三十一日尚未到期之遠期外匯合約如下：

幣別	到期期間	合約金額(千元)
一〇一年十二月三十一日		
美金兌日幣	102.01～102.02	USD29,050 / JPY2,419,755
美金兌歐元	102.01	USD744 / EUR600
一〇〇年十二月三十一日		
美金兌新台幣	101.01～101.02	USD51,000 / NTD1,542,185
美金兌日幣	101.01	USD28,390 / JPY2,211,576
美金兌歐元	101.01	USD2,354 / EUR1,800

(三) 本公司於一〇一年十二月三十一日尚未到期之外幣選擇權合約如下：

合約內容	到期期間	每期合約金額(千元)
Sell USD Put / NTD Call	104.05(註)	USD4,000 / NTD111,400
Sell USD Put / NTD Call	104.05(註)	USD4,000 / NTD111,100
Buy USD Call / NTD Put	104.05(註)	USD2,000 / NTD55,700
Buy USD Call / NTD Put	104.05(註)	USD2,000 / NTD55,550

註：上述合約約定每月為一期進行交割，惟交易對手有權利提前終止合約。

(四) 本公司於一〇〇年十二月三十一日尚未到期之換匯換利合約之名目本金為美金10,000千元兌新台幣289,800千元，按約定利率收付利息，已於一〇一年八月到期。

一〇一及一〇〇年度，交易目的之金融資產分別產生淨利益2,218千元及757,669千元；交易目的之金融負債則分別產生淨損失782,396千元及淨利益58,962千元。

六、應收帳款淨額

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
應收帳款	$ 10,806,323	$ 9,820,601
減：備抵呆帳	21,931	22,921
備抵銷貨折讓	99,312	67,686
	$ 10,685,080	$ 9,729,994

本公司讓售應收帳款之相關資訊如下：

交易對象	本年度讓售金額(千元)		本年度已收現金額(千元)		截至年底已預支金額(千元)		已預支金額年利率(%)	額度(千元)	
一〇一年度									
花旗銀行	USD	278,498	USD	201,854	USD	76,644	1.06	USD	92,000
一〇〇年度									
花旗銀行	USD	204,324	USD	150,846	USD	53,478	1.50	USD	95,000
	NTD	447,415	NTD	447,415	NTD	–	–		
台新銀行	USD	8,141	USD	8,141	USD	–	–	USD	9,300

上述額度可循環使用，另依讓售合約之規定，因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔，因信用風險而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於一〇一年及一〇〇年十二月三十一日已分別提供美金27,000千元及美金28,930千元之本票作為擔保品。

七、存貨

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
製成品	$ 158,784	$ 150,145
在製品	84,947	182,839
原料	2,938,077	2,683,678
物料	236,405	156,932
在途原物料	120,466	118,474
	$ 3,538,679	$ 3,292,068

一〇一及一〇〇年度與存貨相關之營業成本分別為54,561,142千元及51,719,001千元，其中分別包括存貨損失152,082千元及123,712千元。

八、以成本衡量之金融資產－非流動

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
有限合夥	$ 308,643	$ 305,162
國內非上市(櫃)公司普通股	75,518	75,518
	$ 384,161	$ 380,680

九、採權益法之長期股權投資

	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	帳面金額	股權%	帳面金額	股權%
上市公司				
宏璟建設公司(宏璟)	$ 1,138,690	26.2	$ 1,124,692	26.2
非上市(櫃)公司				
J & R Holding Limited (J&R Holding)	39,982,654	100.0	41,267,217	100.0
環隆電氣公司(環電)	23,523,817	99.2	15,046,145	74.2
台灣福雷電子公司(台灣福雷)	20,330,884	100.0	20,447,313	100.0
A.S.E. Holding Limited (ASE Holding)	13,082,152	100.0	13,718,783	100.0
Omniquest Industrial Limited (Omniquest)	9,438,286	70.6	9,510,489	70.6
Innosource Limited (Innosource)	3,369,162	100.0	3,391,310	100.0
陸竹開發公司(陸竹)	1,319,591	84.3	–	–
宏錦光公司(宏錦光)	379,482	27.3	329,817	27.3
洋鼎科技公司(洋鼎)	104,510	100.0	–	–
晶錡科技公司(晶錡)	47,856	33.3	47,856	33.3
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd. (ASE MS Japan)	30,006	100.0	34,723	100.0
日月鴻科技公司(日月鴻)	–	–	3,622,590	99.6
	112,747,090		108,540,935	
減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益	300,149		300,149	
轉列庫藏股票	1,959,107		1,959,107	
累計減損－晶錡	47,856		47,856	
	$ 110,439,978		$ 106,233,823	

(一) 採權益法之上市公司股權投資依一〇一年及一〇〇年十二月三十一日股票收盤價計算之市價分別為895,619千元及775,517千元。另本公司透過環電持有之子公司環旭電子公司股票於一〇一年二月在上海證券交易所掛牌上市，於一〇一年十二月三十一日其帳面金額及依股票收盤價計算之市價分別為14,235,820千元及49,100,340千元。

(二) 重大新增投資

1. 本公司於一〇一年一月以300,016千元向非關係人購入洋鼎100%股權。該公司主要從事分離式元器件之封裝與測試業務。
2. 本公司分別於一〇〇年十一月及十二月以公開收購方式取得日月鴻股權計106,808千股，收購價款計1,972,194千元，其中1,081,071千元係以本公司於一〇〇年十一月向日月鴻購入其對力晶科技公司之應收帳款償付之，經本次收購後，本公司對日月鴻之持股比例自55.7%增加為99.6%。嗣於一〇一年五月吸收合併日月鴻(消滅公司)，並以10,993千元收購日月鴻剩餘流通在外股權733千股。
3. 本公司於一〇〇年十二月以4,282千元向子公司日月光電子取得其陸續收購之台灣福雷股權50千股；另子公司日月光封裝測試(上海)有限公司(日月光上海封測)於一〇〇年十一月以1,058,269千元(人民幣221,500千元)向關係人昆山鼎耀房地產開發有限公司收購子公司上海鼎匯房地產開發有限公司10%股權。
4. 本公司之子公司日月鴻分別於一〇〇年十月及十一月向力晶科技公司及其聯屬公司等購入陸竹計84.25%股權，收購價款計1,366,238千元，其中1,000,000千元係以日月鴻對力晶科技公司之應收帳款抵繳，另尚有200,000千元將依合約約定事項於交割日起兩年內支付。本公司於一〇一年五月吸收合併日月鴻後遂直接持有陸竹股權。

   上述股權併購之會計處理係按財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」辦理。有關取得子公司之現金、資產及負債相關資訊，參閱本公司合併財務報表。倘本公司及子公司於一〇〇年初即收購上述股權，則擬制性一〇一及一〇〇年度之經營結果資訊如下：

	一〇一年度	一〇〇年度
營業收入淨額	$ 72,926,652	$ 69,439,165
營業外收入及利益－權益法認列之投資收益	4,335,611	4,415,573
本期淨利	13,091,359	13,644,239
基本稅後每股盈餘(元)	1.76	1.82
稀釋稅後每股盈餘(元)	1.71	1.77

(三) 其他投資變動說明

1. 日月鴻以九十九年十二月二十二日為減資基準日辦理現金減資，於一〇〇年二月退回本公司投資款904,587千元。
2. 一〇一年二月子公司環旭電子公司股票於上海證券交易所掛牌上市(證券代碼601231)，並辦理現金增資計人民幣773,419千元。因本公司及子公司未依持股比例認購，致持股比例由99.2%降至88.7%，並認列資本公積－長期投資2,172,901千元。
3. 本公司為簡化對環電之持股架構，於一〇一年九月以4,837,875千元(參考其淨值)分別向子公司ASE Test Limited(ASE Test)、J&R Holding及ASE Holding購入其對環電之持股共265,817千股，致直接持股比例由74.2%增加至99.2%。

(四) 投資成本與股權淨值間差額屬非攤銷性資產、攤銷性資產及商譽，一〇一及一〇〇年度變動如下：

	非攤銷性資產	攤銷性資產	商　譽
一〇一年度			
年初餘額	($ 309,706)	$ 2,169,469	$ 611,360
本年度增加	22,046	763,016	174,783
本年度重分類	－	3,823	(3,823)
本年度攤銷	－	(516,680)	－
本年度減少	(2,074)	－	－
年底餘額	($ 289,734)	$ 2,419,628	$ 782,320
一〇〇年度			
年初餘額	($ 329,477)	$ 2,653,279	$ 607,537
本年度增加	－	－	3,823
本年度攤銷	－	(483,810)	－
本年度減少	19,771	－	－
年底餘額	($ 309,706)	$ 2,169,469	$ 611,360

一〇一年度新增係因購入洋鼎及環電股權重組，重分類則為完成一〇〇年度收購日月鴻股權之價格分攤。

(五) 本公司採權益法認列投資(損)益之明細如下：

	一〇一年度	一〇〇年度
台灣福雷	$ 2,467,374	$ 2,380,027
環　　電	1,508,442	811,269
J&R Holding	733,415	493,784
ASE Holding	(76,431)	576,185
其　　他	(297,189)	236,027
	$ 4,335,611	$ 4,497,292

(六) 本公司已編製包括所有子公司財務報表之一〇一及一〇〇年度合併財務報表。

(七) 採權益法之長期股權投資相關資訊請參閱附表八

十、固定資產

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
累計折舊		
建築物及附屬設備	$ 9,446,250	$ 7,990,400
機器設備	47,366,152	45,838,136
運輸設備	58,746	52,419
辦公設備	816,270	753,550
租賃資產	－	1,159
	$ 57,687,418	$ 54,635,664

本公司有關利息費用之資訊如下：

	一〇一年度	一〇〇年度
利息費用總額	$ 803,840	$ 937,089
利息資本化金額(列入固定資產項下)	86,389	43,746
列入損益表項下之利息費用	$ 717,451	$ 893,343
利息資本化年利率(%)	1.62～1.99	1.26～1.97

另一〇一及一〇〇年度經評估固定資產及出租資產使用情形而分別認列減損損失27,974千元及68,138千元。

十一、出租資產

	成本	累計折舊	累計減損	未折減餘額
一〇一年十二月三十一日				
建築物及附屬設備	$ 1,542,958	($ 489,211)	($ 89,703)	$ 964,044
機器設備	377,755	(306,171)	—	71,584
	$ 1,920,713	($ 795,382)	($ 89,703)	$ 1,035,628
一〇〇年十二月三十一日				
建築物及附屬設備	$ 1,222,186	($ 476,878)	($ 95,469)	$ 649,839
機器設備	168,960	(157,127)	—	11,833
	$ 1,391,146	($ 634,005)	($ 95,469)	$ 661,672

上述出租建築物及附屬設備主係分別出租予子公司日月光電子及台灣福雷等並按月收取租金。一〇一及一〇〇年度關係人之租金收入分別為134,211千元及221,556千元(列入其他收入項下)，其中建築物及附屬設備之租金係依當地市場行情議定，機器設備則依雙方協議計算。截至一〇一年十二月三十一日止，依租約未來可收取之租金列示如下：

期　　間	金　　額
一〇二年度	$ 54,872
一〇三年度	25,002
一〇四年度	10,484
一〇五年度	2,172
一〇六年度	571

十二、短期借款

銀行週轉性借款，一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之年利率分別為0.86%～1.03%及1.05%。

十三、應付費用

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
應付薪資及獎金	$ 1,629,596	$ 1,274,807
應付員工紅利及董監酬勞	1,413,867	1,635,094
應付修繕物料費用	517,186	466,604
其　　他	1,337,893	1,323,653
	$ 4,898,542	$ 4,700,158

十四、應付公司債

本公司於一〇〇年八月經主管機關核准發行國內有擔保普通公司債，一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之餘額係發行總額8,000,000千元扣除未攤銷發行成本176,429千元及216,090千元之淨額。每張公司債票面金額為50,000千元，發行期間五年，將於一〇五年八月到期一次償還，每年依票面利率1.45%付息一次，並由銀行提供擔保。該公司債並於證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)買賣，代碼為B67512～B67516。

十五、長期借款

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
(一)指定用途專案借款	$ 2,537,500	$ 7,612,500
(二)週轉性借款	25,314,823	22,042,400
	27,852,323	29,654,900
減：一年內到期	1,028,571	–
未攤銷遞延主辦費	21,653	43,588
	$ 26,802,099	$ 29,611,312

(一) 指定用途專案借款

花旗銀行主辦之銀行團專案借款，每半年為一期平均償還至一〇二年三月，一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之年利率分別為2.06%及2.08%。另依融資合約規定，本公司於借款期間對ASE Test應隨時直接或間接持有不少於51%之股權，並隨時維持對ASE Test之實質經營控制權。

(二) 週轉性借款

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
1.花旗銀行主辦之銀行團		
新台幣72億元及美金2.4億元之聯貸，自一〇一年六月起，每半年為一期平均償還至一〇四年六月，年利率一〇一年十二月三十一日0.96%～1.59%，一〇〇年十二月三十一日1.05%～1.54%	$ 10,121,143	$ 14,466,000
2.渣打國際商業銀行		
將於一〇三年十二月到期一次清償，年利率一〇一年十二月三十一日0.90%；一〇〇年十二月三十一日1.15%	2,320,000	1,750,000
3.台北富邦商業銀行		
美金66,000千元，將於一〇三年十二月到期一次清償，年利率1.15%	1,916,640	–
4.台灣土地銀行		
將於一〇四年三月到期一次清償，年利率一〇一年十二月三十一日1.05%；一〇〇年十二月三十一日1.34%	1,500,000	1,500,000
5.星展銀行		
美金50,000千元，將於一〇三年五月到期一次清償，年利率1.16%	1,452,000	–
6.澳商澳盛銀行		
美金40,000千元，將於一〇三年十二月到期一次清償，年利率1.15%	1,161,600	–
7.巴黎銀行		
新台幣700,000千元及美金15,000千元，將於一〇三年四月到期一次清償，年利率1.26%～1.50%	1,135,600	–
8.加拿大豐業銀行		
美金36,000千元，將於一〇三年二月到期一次清償，年利率一〇一年及一〇〇年十二月三十一日均為1.07%	1,045,440	1,089,900
9.台灣銀行		
將於一〇三年八月到期一次清償，年利率1.25%	1,000,000	–
10.台新國際商業銀行		
美金30,000千元，將於一〇四年五月到期一次清償，年利率1.21%	871,200	–
11.新加坡華僑銀行		
美金30,000千元，將於一〇三年十二月到期一次清償，年利率1.30%	871,200	–
12.合作金庫商業銀行		
將於一〇三年六月到期一次清償，年利率一〇一年十二月三十一日1.30%；一〇〇年十二月三十一日0.95%	800,000	800,000
13.台灣新光商業銀行		
將於一〇三年十月到期一次清償，年利率1.25%	300,000	–
14.大台北商業銀行		
將於一〇三年四月到期一次清償，年利率1.03%	200,000	–

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
15.中華開發工業銀行		
將於一〇四年九月到期一次清償，年利率1.40%	$ 200,000	$ –
16.板信銀行		
將於一〇三年八月到期一次清償，年利率1.34%	200,000	–
17.日盛銀行		
將於一〇三年十一月到期一次清償，年利率1.30%	120,000	–
18.華南商業銀行		
將於一〇三年三月到期一次清償，年利率1.50%	100,000	–
19.其　　他		
已清償，年利率1.17%～1.75%	–	2,436,500
	25,314,823	22,042,400
減：一年內到期部分	1,028,571	–
	$ 24,286,252	$ 22,042,400

上述銀行團聯合融資合約，除其他有關規定外，尚規定本公司以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報表為計算基礎，於貸款存續期間內，應維持特定流動比率、負債比率、有形淨值金額及利息償付能力。本公司於一〇一年及一〇〇年十二月三十一日均符合上述規定。

本公司預計以一〇一年及一〇〇年十二月三十一日前已取得之長期融資額度清償將於一年內到期之部分借款，是以分別有5,557,386千元及9,208,143千元未列入一年內到期部分。

十六、退休金

「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休辦法，依適用員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。本公司一〇一及一〇〇年度認列之退休金成本分別為452,000千元及376,217千元。

本公司另提列委任經理人退休金準備，一〇一及一〇〇年度認列之退休金成本分別為8,950千元及19,694千元(列入應計退休金負債項下)，並支付經理人退休金分別為19,161千元及2,666千元。截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止，本公司屬委任經理人之應計退休金負債分別為128,777千元及138,988千元。

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法係屬確定給付退休辦法，員工退休金係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資(基數)計付。本公司依規定每月按員工薪資總額百分之二至五提撥員工退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

本公司屬確定給付退休辦法之相關退休金精算資訊揭露如下：

(一)淨退休金成本組成項目

	一〇一年度	一〇〇年度
服務成本	$ 31,291	$ 42,590
利息成本	64,449	54,743
退休基金資產預期報酬	(20,531)	(18,995)
攤銷數	69,437	64,139
	$ 144,646	$ 142,477

(二) 退休基金提撥狀況與應計退休金負債之調節

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
給付義務		
既得給付義務	$ 543,628	$ 266,808
非既得給付義務	2,063,625	1,864,474
累積給付義務	2,607,253	2,131,282
未來薪資增加之影響數	1,246,392	1,109,392
預計給付義務	3,853,645	3,240,674
退休基金資產公平價值	(1,123,266)	(990,269)
提撥狀況	2,730,379	2,250,405
未認列過渡性淨給付義務	(25,704)	(31,793)
未認列前期服務成本	(8,713)	(9,439)
未認列退休金損失	(1,949,930)	(1,451,264)
補列之應計退休金負債	737,955	406,967
列入應付費用	(13,715)	(8,823)
應計退休金負債	$ 1,470,272	$ 1,156,053
既得給付	$ 642,306	$ 324,030

(三) 退休金給付義務之精算假設

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
折現率	1.75%	2.00%
未來薪資水準增加率	3.00%	3.00%
退休基金資產預期投資報酬率	2.00%	2.00%

	一〇一年度	一〇〇年度
(四)提撥至退休基金金額	$ 156,477	$ 108,788
(五)由退休基金支付金額	$ 40,439	$ 44,765

十七、股東權益

股本

本公司額定股本為95,000,000千元，供發行可轉換公司債及員工認股權憑證所保留之股本分別為6,000,000千元及8,000,000千元。一〇一及一〇〇年度，員工行使認股權繳交股款分別計315,690千元及589,326千元，股數分別為20,460千股及30,083千股。其中截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止尚未辦妥變更登記，列入預收股本分別為106,171千元及35,693千元，股數分別為8,142千股及2,145千股。本公司亦分別於一〇一年及一〇〇年一月辦理註銷庫藏股減資1,054,750千元及370,000千元，股數105,475千股及37,000千股。以上增減資均已完成變更登記。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR，每單位表彰本公司普通股5股，截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止，流通在外之ADR分別為105,431千單位及89,126千單位，折合普通股分別約527,154千股及445,628千股。

資本公積

依相關法令規定，發行股票溢價及庫藏股票交易所產生之資本公積，得用以撥充股本，惟每年以股本之一定比率為限。前述資本公積在公司無虧損時，亦得以現金分配。因長期股權投資及員工認股權所產生之資本公積，不得作為任何用途。

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

(一)彌補虧損。

(二)提存百分之十為法定盈餘公積。

(三)依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。

(四)長期投資採權益法計算之投資收益內屬於現金股利以外未實現部分，得就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

(五)如尚有盈餘分派如下：

1. 董事、監察人酬勞金係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之二(含)以下。
2. 員工紅利係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之七(含)以上，百分之十(含)以下，其中百分之七部分係按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其超過百分之七部分則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。
3. 其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總數比例分派之。

第2.款所稱之員工，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後辦理。

一〇一及一〇〇年度應付員工紅利估列金額分別為1,178,222千元及1,362,578千元；應付董監酬勞估列金額分別為235,645千元及272,516千元。前述員工紅利及董監酬勞係分別按稅後淨利(已扣除員工紅利及董監酬勞之金額)之10%及2%計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議紅利之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日之收盤價(考量除權除息之影響後)。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就股東權益減項(包括金融商品未實現損益、累積換算調整數及未認列為退休金成本之淨損失)淨額提列特別盈餘公積；另子公司於年底持有本公司股票市價低於帳面價值之差額，應依持股比例計算提列相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項數額如有減少時，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

依公司法規定，法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司股本總額時為止。法定盈餘公積得用於彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司股東會分別於一〇一年及一〇〇年六月通過董事會擬議之一〇〇及九十九年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配案		每股股利(元)	
	一〇〇年度	九十九年度	一〇〇年度	九十九年度
法定盈餘公積	$ 1,372,596	$ 1,833,750		
特別盈餘公積提列	–	1,272,417		
股票股利	9,315,995	6,957,357	$ 1.40	$ 1.15
現金股利	4,325,284	3,932,419	0.65	0.65
	$ 15,013,875	$ 13,995,943	$ 2.05	$ 1.80

另一〇一年六月股東會通過迴轉特別盈餘公積1,272,417千元。

上述股東會亦決議以現金配發一〇〇及九十九年度員工紅利及董監酬勞內容如下：

	一〇〇年度	九十九年度
員工紅利	$ 1,235,336	$ 1,523,133
董監酬勞	246,000	304,200

上述一〇〇及九十九年度員工紅利及董監酬勞與各年度財務報表估列之員工紅利及董監酬勞之差異分別為153,758千元及427千元，主要係因估計改變，已分別調整一〇一及一〇〇年度之損益。

截至會計師查核報告日止，本公司一〇一年度盈餘分配議案尚未經董事會通過，有關董事會通過擬議及股東會決議之員工紅利及董監酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

金融商品未實現利益(損失)

	備供出售金融資產	長期股權投資依持股比例認列	現金流量避險未實現損失(附註二二)	合計
一〇一年度				
年初餘額	$ —	$ 283,460	($ 48,372)	$ 235,088
直接認列為股東權益調整項目	(26,130)	148,355	(8,261)	113,964
轉列損益項目	8	—	52,878	52,886
年底餘額	($ 26,122)	$ 431,815	($ 3,755)	$ 401,938
一〇〇年度				
年初餘額	($ 9,290)	$ 457,465	($ 201,872)	$ 246,303
直接認列為股東權益調整項目	(77,901)	(174,005)	9,828	(242,078)
轉列損益項目	87,191	—	143,672	230,863
年底餘額	$ —	$ 283,460	($ 48,372)	$ 235,088

庫藏股票(股數為千股)

	年初股數	本年度增加	本年度減少	年底股數
一〇一年度				
子公司持有母公司股票	127,981	17,902	—	145,883
維護股東權益	105,475	—	105,475	—
	233,456	17,902	105,475	145,883
一〇〇年度				
子公司持有母公司股票	114,792	13,189	—	127,981
維護股東權益	37,000	105,475	37,000	105,475
	151,792	118,664	37,000	233,456

子公司持有本公司股票，一〇一及一〇〇年度因無償配股分別增加17,902千股及13,189千股。

截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止，上述庫藏股票帳面金額分別為1,959,107千元及4,731,741千元，市價分別為3,676,252千元及6,046,505千元。

本公司依證券交易法買回庫藏股票，買回股份之數量比例，不得超過本公司已發行股份總數之10%；收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股票溢價及已實現之資本公積之金額。另本公司持有之庫藏股票，依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

十八、員工認股權憑證

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工並提昇員工向心力，業經主管機關核准發行四次員工認股權憑證，每單位得認購本公司普通股一股，並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本公司及子公司之全職正式員工，且存續期間為十年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿二年才可行使被給與之一定比例之認股權。

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下：

認股權憑證	一〇一年度 單位(千)	一〇一年度 加權平均行使價格(元)	一〇〇年度 單位(千)	一〇〇年度 加權平均行使價格(元)
年初流通在外	371,034	$ 22.8	397,627	$ 22.3
本年度給與	–	–	12,280	25.8
本年度沒收	(6,233)	22.6	(8,790)	22.9
本年度到期	(9)	5.5	–	–
本年度行使	(20,460)	15.4	(30,083)	19.6
年底流通在外	344,332	20.3	371,034	22.8
年底可行使	243,930	20.1	145,154	21.6
本年度給與之認股權憑證加權平均公平價值(元)	$ –		$ 8.0～8.1	

上述認股權計畫之行使價格遇有無償配股時，則依照本公司員工認股權憑證發行辦法，調整無償配股之影響。

一〇一及一〇〇年度執行之員工認股權憑證，其於執行日之加權平均股價分別為25.2元及29.8元。

截至一〇一年十二月三十一日止，本公司發行之流通在外及可行使之員工認股權憑證相關資訊如下：

行使價格之範圍(元)	流通在外單位(千)	加權平均預期剩餘存續期限(年)	可行使單位(千)	可行使之認股權加權平均行使價格(元)
$ 8.4～13.5	22,727	1.6	22,720	$ 13.1
20.4～22.6	321,605	6.4	221,210	20.8
	344,332		243,930	20.1

子公司USI Enterprise Limited(環誠)於一〇〇年五月及九十九年四月亦分別發行員工認股權憑證，發行條件與本公司相同，並分別給與本公司員工4,257千單位及6,821千單位，每單位公平價值分別為美金0.83～0.95元及美金0.88～1.06元，一〇一及一〇〇年度均無行使，惟分別沒收119千單位及0單位。截至一〇一年十二月三十一日止，可行使之員工認股權憑證為3,388千單位，加權平均行使價格為美金2.43元。

本公司及環誠於九十七年一月一日以後發行之員工認股權憑證係採用Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型以估計給與日認股權憑證之公平價值，評價模式所採用之參數分別如下：

	本公司	環誠公司
給與日股價 / 市價	28.60～28.75元	美金2.49～2.62元
行使價格	28.60～28.75元	美金2.42～2.94元
預期股價波動率	28.59%～36.08%	32.48%～35.63%
合約期間	10年	10年
預期股利率	4%	–
無風險利率	1.5620%～1.8087%	1.6306%～1.7997%

本公司及環誠之預期股價波動率係分別基於本公司及同業過去十年歷史股票價格波動率，且為將提早執行之效果納入考量，均假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.58～1.69倍時，員工將執行認股權。

一〇一及一〇〇年度因員工離職而放棄本公司及環誠九十七年一月一日以後給與之認股權分別為4,716千單位及4,933千單位。本公司及環誠一〇一年十二月三十一日估計於未來剩餘既得期間因員工離職而放棄認股權之比率為1.8%～4.0%。

一〇一及一〇〇年度本公司及子公司合計認列九十七年一月一日以後發行之員工認股權之酬勞成本分別為445,120千元及537,973千元。

若本公司及子公司將給與日於九十六年十二月三十一日(含)以前之員工認股權依財務會計準則第三十九號公報規定衡量時，一〇一及一〇〇年度擬制性資訊如下：

	一〇一年度	一〇〇年度
本期淨利	$ 12,509,605	$ 13,177,782
稅後基本每股盈餘(元)	$ 1.68	$ 1.75

十九、所得稅

(一) 依法定稅率(17%)計算之所得稅費用與損益表所列示所得稅費用之調節如下：

	一〇一年度	一〇〇年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	$ 2,479,482	$ 2,558,940
調整項目之稅額影響數		
永久性差異		
免稅所得額	(191,035)	(331,389)
國內投資收益	(651,540)	(593,321)
暫時性差異		
國外投資收益	(85,514)	(171,219)
折舊財稅差	(602,989)	(277,168)
其他	1,274	162,404
按課稅所得估列之稅額	949,678	1,348,247
未分配盈餘課徵10%	—	434,156
當年度抵用之投資抵減	(391,043)	(989,316)
以前年度所得稅調整	36,292	12,116
當期所得稅費用	594,927	805,203
遞延所得稅費用	889,553	521,427
境外所得已繳納所得稅	9,347	—
所得稅費用	$ 1,493,827	$ 1,326,630

所得基本稅額條例於一〇一年八月修正，基本所得之扣除額及稅率分別修正為500千元及12%，修正條文自一〇二年度施行。

(二) 遞延所得稅資產(負債)列示如下：

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
流動		
未使用投資抵減	$ 325,664	$ 611,669
其他	121,758	80,107
備抵評價	(50,189)	—
	397,233	691,776
非流動		
未使用投資抵減	583,818	469,885
應計退休金負債	112,580	99,886
折舊財稅差	(1,057,630)	(571,804)
其他	17,135	62,273
備抵評價	(199,811)	—
	(543,908)	60,240
遞延所得稅資產(負債)淨額	($ 146,675)	$ 752,016

(三) 本公司增資擴展經營積體電路封裝之投資計畫，經核准部分產品就其新增所得自九十八年及一〇一年一月起連續五年免徵營利事業所得稅。另本公司因合併承受日月欣半導體公司增資擴展之五年免稅租稅優惠，已於一〇〇年十二月屆滿。

(四) 截至一〇一年十二月三十一日止，本公司依據促進產業升級條例得適用之所得稅抵減(含合併日月鴻繼受者)相關資訊如下：

最後抵減年度	可抵減總額	尚未抵減餘額
一〇二年	$ 494,348	$ 325,664
一〇三年	584,869	244,633
一〇四年	339,185	339,185
	$ 1,418,402	$ 909,482

(五) 本公司之所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關核定至九十七年度止，惟本公司對九十一至九十七年度核定之內容不服，已依法提起行政救濟或程序。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

(六) 兩稅合一相關資訊如下：

一〇一年及一〇〇年十二月三十一日本公司之未分配盈餘均屬八十七年度以後產生，股東可扣抵稅額帳戶餘額一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別為598,571千元及502,789千元。一〇一及一〇〇年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為5.55%(預計)及7.16%(實際)。

依所得稅法規定，本公司分配屬於八十七年度(含)以後之盈餘時，本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東可扣抵稅額，外國股東僅能就已實際繳納之未分配盈餘加徵10%稅額部分獲配股東可扣抵稅額以抵減股利扣繳稅款。由於實際分配予股東之可扣抵稅額，應以股利分配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準，因此本公司預計一〇一年度盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅額扣抵比率有所差異。

二十、用人費用、折舊及攤銷

	一〇一年度			一〇〇年度		
	營業成本	營業費用	合計	營業成本	營業費用	合計
用人費用						
薪　資	$ 9,476,001	$ 3,625,372	$ 13,101,373	$ 8,217,074	$ 3,261,181	$ 11,478,255
退休金	441,861	160,987	602,848	384,832	153,556	538,388
伙食費	474,589	105,746	580,335	424,654	91,504	516,158
福利金	112,054	37,438	149,492	106,606	35,829	142,435
員工保險費	746,100	239,218	985,318	611,485	184,829	796,314
其他用人費用	125,839	275,293	401,132	142,592	312,785	455,377
	$ 11,376,444	$ 4,444,054	$ 15,820,498	$ 9,887,243	$ 4,039,684	$ 13,926,927
折　舊	$ 7,954,873	$ 651,557	$ 8,606,430	$ 6,922,237	$ 590,488	$ 7,512,725
攤　銷	161,866	147,764	309,630	221,241	166,956	388,197

上列退休金合計數與附註十六退休金成本合計數之差異，係因員工短期借調子公司而向其收取退休金補貼所致。

二十一、每股盈餘

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金額(分子)		股數(分母)	每股盈餘(元)	
	稅前	稅後	(千股)	稅前	稅後
一〇一年度					
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利	$ 14,585,186	$ 13,091,359	7,445,469	$ 1.96	$ 1.76
具稀釋作用之潛在普通股之影響					
員工紅利	–	–	52,695		
本公司發行之員工認股權憑證	–	–	77,732		
子公司發行員工認股權憑證及員工紅利	(107,632)	(107,632)	–		
稀釋每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 14,477,554	$ 12,983,727	7,575,896	1.91	1.71

一〇〇年度	金額(分子) 稅前	金額(分子) 稅後	股數(分母) (千股)	每股盈餘(元) 稅前	每股盈餘(元) 稅後
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利	$ 15,052,588	$ 13,725,958	7,514,719	$ 2.00	$ 1.83
具稀釋作用之潛在普通股之影響					
員工紅利	–	–	63,653		
本公司發行之員工認股權憑證	–	–	121,665		
稀釋每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 15,052,588	$ 13,725,958	7,700,037	1.95	1.78

公司採用(九六)基秘字第〇五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用而非盈餘之分配，於計算稀釋每股盈餘時，假設員工紅利將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。計算稀釋每股盈餘時，以該潛在普通股資產負債表日之收盤價，並考量除權除息之影響後，作為發行股數之判斷基礎。於次年度股東會決議員工紅利發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，一〇〇年度稅後基本每股盈餘及稀釋每股盈餘，分別由2.08元及2.03元減少為1.83元及1.78元。

二十二、金融商品資訊之揭露

(一)公平價值之資訊

	一〇一年十二月三十一日 帳面價值	一〇一年十二月三十一日 公平價值	一〇〇年十二月三十一日 帳面價值	一〇〇年十二月三十一日 公平價值
非衍生性金融商品				
資產				
備供出售金融資產－流動及非流動	$ 67,146	$ 67,146	$ 24,827	$ 24,827
以成本衡量之金融資產－非流動	384,161	454,852	380,680	380,680
存出保證金	23,446	23,446	15,147	15,147
受限制資產	179,929	179,929	149,747	149,747
負債				
應付公司債	7,823,571	7,875,706	7,783,910	7,828,423
長期借款(含一年內到期)	27,830,670	27,830,670	29,611,312	29,611,312
衍生性金融商品				
資產				
換匯合約	8,945	8,945	467,725	467,725
遠期外匯合約	125	125	3,658	3,658
負債				
換匯合約	313,034	313,034	40,837	40,837
遠期外匯合約	29,721	29,721	2,717	2,717
外幣選擇權合約	7,899	7,899	–	–
利率交換合約	4,524	4,524	58,279	58,279
換匯換利合約	–	–	12,960	12,960

(二) 本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

1. 上述金融商品不包含現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款(含關係人)、短期借款、應付帳款(含關係人)、應付費用、其他應付款(含關係人)及應付設備款。此類短期金融商品之到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
2. 衍生性金融商品及備供出售金融資產－流動及非流動因無市場價格可供參考，是以採用評價方法估計。本公司採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊相近。

3. 部分以成本衡量之金融資產採用評價方法估計公平價值。本公司採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊相近。餘因無活絡市場公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平價值，故以帳面價值為公平價值。
4. 存出保證金及受限制資產係以現金方式存出，以其帳面價值為公平價值。
5. 長期借款係屬浮動利率，其帳面價值即為公平價值；應付公司債以櫃買中心之市場價格為公平價值。

(三) 本公司於一〇一及一〇〇年度因以評價方法估計金融商品公平價值之變動而分別認列損失780,178千元及利益816,631千元。

(四) 本公司一〇一年及一〇〇年十二月三十一日具利率變動之公平價值風險之金融資產均為0千元，金融負債分別為7,823,571千元及7,783,910千元；具利率變動之現金流量風險之金融資產分別為1,865,543千元及1,621,919千元，金融負債分別為50,730,853千元及43,234,129千元。

(五) 本公司一〇一及一〇〇年度非以公平價值衡量且公平價值變動列入損益之金融資產或金融負債，其利息收入分別為3,201千元及4,642千元，利息費用(含利息資本化金額)分別為803,840千元及937,089千元。

(六) 財務風險策略

本公司從事衍生性金融商品交易之經營避險策略，主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生性金融商品交易時，應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易，除依規定分別適用不同部位限制外，以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本公司業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

(七) 財務風險資訊

1. 市場風險

   從事衍生性金融商品交易即在規避外幣資產或負債因匯率或利率波動所產生之風險，因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷；而利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場風險並不重大。

2. 信用風險

   金融資產受到本公司之交易對方或他方未履行合約義務之潛在影響。本公司信用風險金額係以資產負債表日公平價值為正數之合約為評估對象，其一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之最大曝險金額與其帳面價值相同。

   另截至一〇一年及一〇〇年十二月三十一日止，本公司為子公司背書保證之最大信用曝險金額分別為3,438,832千元及3,701,275千元。

3. 流動性風險

   本公司營業活動持續產生現金流入且有足夠之營運資金及借款額度，未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。本公司持有之備供出售金融資產－非流動及以成本衡量之金融資產－非流動因無活絡市場，預期具有流動性風險。

4. 利率變動之現金流量風險

   本公司之借款(應付公司債除外)係屬浮動利率之債務，市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動，而使其未來現金流量產生波動，當利率提高1%，在匯率不變之情況下，本公司現金流出每年將增加約507,309千元。

(八) 現金流量避險

本公司從事利率交換合約係為規避長期借款可能因市場利率而使未來現金流量產生波動之風險。於一〇一年及一〇〇年十二月三十一日尚未到期之利率交換合約之公平價值損失分別為4,524千元及58,279千元，合約相關資訊如下：

到期期間	名目本金(千元)	支付利率(%)	收取利率(%)	現金流量預期產生期間	相關損益預期於損益表認列期間
一〇一年十二月三十一日					
102.03	NTD 1,740,000	2.45～2.48	0.887	102年	102年
102.03	NTD 797,500	0.97～0.99	0.887	102年	102年
一〇〇年十二月三十一日					
102.03	NTD 5,220,000	2.45～2.48	0.861	101年至102年	101年至102年
102.03	NTD 2,392,500	0.96～0.99	0.861	101年至102年	101年至102年

一〇一及一〇〇年度現金流量避險未實現損失變動詳附註十七。

二十三、關係人交易

(一) 關係人之名稱及關係，除福華工程公司(採權益法之被投資公司之子公司)外，詳附註九及附表八所述。

(二) 與關係人間之重大交易事項

除前述附註外，本公司與關係人間之重大交易如下：

當年度

	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	佔進貨淨額%	金額	佔進貨淨額%
1. 購置材料款				
日月光電子	$ 2,575,892	10	$ 2,194,428	8
日月光上海	1,418,504	5	1,745,596	6
其他	130,045	1	128,689	1
	$ 4,124,441	16	$ 4,068,713	15

	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	佔購置價款%	金額	佔購置價款%
2. 購置固定資產				
宏璟	$ 1,274,561	6	$ —	—
台灣福雷	213,595	1	24,490	—
日月光上海封測	45,883	—	37,457	1
日月鴻	15,505	—	266,310	2
其他	53,931	1	36,684	—
	$ 1,603,475	8	$ 364,941	3

	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	佔出售價款%	金額	佔出售價款%
3. 出售固定資產及出租資產				
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	$ 112,795	42	$ 18,153	2
日月光昆山	34,825	13	8,420	1
日月光電子	—	—	780,005	87
其他	20,440	8	34,629	4
	$ 168,060	63	$ 841,207	94

本公司向關係人進貨之交易條件與一般廠商相當，付款條件主係月結六十天。關係人交易產生之未實現銷貨毛利業已銷除。

本公司與關係人間之固定資產交易(不動產除外)，交易價格係以帳面價值為主，並按買方當地政府核定金額調整之，付款期限為驗收後一至二個月，與一般交易條件相當。另本公司向宏璟購置及出售予日月光電子之不動產，其交易價格係參酌鑑價機構鑑價結果議定之。

4. 服務費支出

本公司委託ASE (U.S.) Inc.及ASE MS Japan等提供市場行銷支援及客戶服務，按各該公司所發生費用之約定比率計算並訂有費用上限，一〇一及一〇〇年度之服務費支出分別為722,194千元及640,077千元。

5. 資金融通

本公司向關係人取得之資金融通(帳列其他應付款－關係人)情形如下：

關係人	最高餘額	年底餘額	利率區間(%)	利息費用
一〇一年度				
J&R Holding	$ 7,740,310	$ 6,053,660	0.58～1.00	$ 41,850
ASE Test	4,291,718	4,022,040	0.61～0.70	11,220
環誠	2,119,250	1,916,640	0.61～0.68	13,334
ASE Holding	1,858,560	1,858,560	0.61～0.62	2,498
Real Tech	1,568,160	1,568,160	0.61～0.65	3,917
台灣福雷	3,900,000	1,490,000	0.97～1.01	15,746
ASE Korea	597,600	290,400	3.31～3.46	894
日月瑞	190,000	190,000	0.97～1.00	1,739
日月鴻	700,000	－	0.97～0.98	2,259
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	388,440	－	0.62～0.70	75
一〇〇年度				
J&R Holding	5,290,642	5,290,642	0.59～0.97	12,306
台灣福雷	4,150,000	3,900,000	0.78～0.97	30,871
環誠	2,133,600	2,119,250	0.59～0.69	6,758
ASE Test	995,520	938,525	0.58～0.84	3,999
日月鴻	700,000	700,000	0.97	56
日月瑞	200,000	190,000	0.74～0.97	1,583
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	430,875	181,650	0.59～0.70	66
ASE Korea	878,400	－	3.30	241
日月光電子	420,000	－	0.74～0.97	2,776

年底餘額

	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
應收帳款－關係人				
台灣福雷	$ 14,301	－	$ 9,926	－
環鴻	14,159	－	14,862	－
ISE Labs, Inc.	11,664	－	14,199	－
ASE Japan Co., Ltd.	3,413	－	8,781	－
日月鴻	－	－	7,515	－
其他	8,580	－	7,088	－
	$ 52,117	－	$ 62,371	－
其他應收款－關係人				
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	$ 107,186	7	$ 4,125	－
日月光電子	79,603	6	29,088	3
日月光上海封測	23,054	2	130,223	12
台灣福雷	13,787	1	80,211	7
日月光昆山	12,727	1	33,479	3
其他	16,905	1	28,793	2
	$ 253,262	18	$ 305,919	27

	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
應付帳款－關係人				
日月光電子	$ 705,027	9	$ 493,094	7
日月光上海	412,551	6	384,313	5
其他	1,804	－	899	－
	$ 1,119,382	15	$ 878,306	12
其他應付款－關係人				
J&R Holding	$ 6,053,660	31	$ 5,290,642	35
ASE Test	4,022,040	20	938,525	6
台灣福雷	3,042,794	15	5,068,687	34
環誠	1,916,640	10	2,119,250	14
ASE Holding	1,858,560	9	－	－
Real Tech	1,568,160	8	－	－
其他	584,661	3	1,215,747	8
	$ 19,046,515	96	$ 14,632,851	97

其他應收款主係應收設備款及代墊款；其他應付款主係應付融資款及代收應付測試費等。

背書保證

本公司為子公司Anstock Limited 於一〇〇年九月發行之人民幣債券3,003,102千元(人民幣650,000千元)提供本金及利息背書保證，一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之背書保證餘額分別為3,438,832千元(人民幣744,304千元)及3,701,275千元(人民幣770,313千元)。

(三) 董事、監察人及管理階層薪酬資訊

	一〇一年度	一〇〇年度
	$ 391,798	$ 519,308
薪資、獎金及特支費	78,717	104,990
紅利	$ 470,515	$ 624,298

二十四、質抵押之資產

本公司一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別提供定期存單179,929千元及149,747千元(帳列受限制資產)作為進口原物料之關稅擔保及雇用外籍勞工之保證金。

二十五、重大承諾事項及或有事項

(一) 本公司廠房用地係向政府租用，其租期將陸續於一一一年十一月底屆滿。租期屆滿時本公司得予續約，但政府得於該土地公告現值調高時調整租金，並得在若干條件下終止租約。一〇一及一〇〇年度租金(包括公共設施建設費)均約13,000千元。

(二) 截至一〇一年十二月三十一日止，本公司已開立未使用之信用狀金額約106,000千元。

(三) 截至一〇一年十二月三十一日止，本公司已承諾購置之機器設備金額約1,690,000千元，其中已支付金額為58,705千元。

(四) 截至一〇一年十二月三十一日止，本公司已承諾購置之廠房工程金額約1,033,000千元，其中已支付金額為160,496千元。

(五) 九十五年二月美商Tessera Inc.於美國加州地方法院對本公司及子公司ASE (U.S.) Inc.提起專利侵權訴訟(加州訴訟案)，該地方法院於一〇一年一月重新安排本案之相關訴訟程序，預計於一〇三年四月進行審判

程序。另美國專利商標局亦著手對美商Tessera Inc.於加州訴訟案所堅稱其擁有之專利進行再審查。截至會計師查核報告日止，本公司及子公司尚無法估計美國專利商標局再審查之結果，及其對上述專利侵權訴訟案可能之影響。

二十六、外幣金融資產及負債之資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：外幣千元

	一〇一年十二月三十一日	一〇〇年十二月三十一日
貨幣性金融資產		
美金	$ 1,381,054	$ 970,920
日幣	3,170,632	3,184,542
非貨幣性金融資產		
美金	9,561	9,441
採權益法之長期股權投資		
美金	2,288,932	2,259,007
日幣	89,198	88,897
貨幣性金融負債		
美金	1,429,365	975,570
日幣	3,466,744	3,499,763
外幣換算匯率		
美金	USD1=NTD29.04	USD1=NTD30.275
日幣	JPY1=NTD0.3364	JPY1=NTD0.3906

二十七、附註揭露事項

一〇一年度應揭露事項如下：

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊

1. 資金貸與他人：詳附表一。
2. 為他人背書保證：詳附表二。
3. 期末持有有價證券情形：詳附表三。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表四。
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表五。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表六。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表七。
9. 具重大影響力或控制力之被投資公司相關資訊：詳附表八。
10. 從事衍生性商品交易：詳附註五、二二及附表九。

(三) 大陸投資資訊

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：詳附表十。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益：

(1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比：詳附註二三及附表六。

(2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比：無。

(3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：無重大交易。

(4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的：無。

(5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額：詳附表一。

(6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等：無。

二十八、營運部門資訊

本公司已於合併財務報表揭露營運部門資訊，是以於個別財務報表不予揭露。

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

資金貸與他人

民國一〇一年度
附表一

編號	資金貸與他人者公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象資金貸與限額(註一)	本年度最高額度餘額
1	日月光半導體(上海)公司	上海鼎威房地產開發有限公司	其他應收款－關係人	$ 10,951,489	$ 2,062,148
		上海鼎匯房地產開發有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	2,990,115
2	ASE Holding Limited	本公司	其他應收款－關係人	2,647,030	1,916,640
		ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	長期應收款－關係人	10,951,489	59,160
		J & R Holding Limited	長期應收款－關係人	10,951,489	1,454,515
3	J & R Holding Limited	本公司	其他應收款－關係人	8,050,490	7,764,514
		Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	長期應收款－關係人	10,951,489	461,846
			其他應收款－關係人		
		日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	2,613,600
		Omniquest Industrial Limited	長期應收款－關係人	10,951,489	2,999
		日月光封裝測試(上海)有限公司	長期應收款－關係人	10,951,489	1,499,500
		日月光半導體(昆山)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	876,450
4	ASE Test Limited	本公司	其他應收款－關係人	4,561,365	4,306,365
		J & R Holding Limited	長期應收款－關係人	10,951,489	2,999,000
		ASE Singapore Pte. Ltd.	其他應收款－關係人	10,951,489	1,109,630
		ASE Holding Limited	其他應收款－關係人	10,951,489	1,161,600
5	台灣福雷電子公司	本公司	其他應收款－關係人	4,102,350	3,900,000
		J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	4,102,350	3,163,942
		陸竹開發公司	其他應收款－關係人	4,102,350	60,000
6	日月光電子元器件(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	449,949
7	日月光電子公司	J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	639,551	62,530
8	日月瑞公司	本公司	其他應收款－關係人	197,521	190,000
		日月光電子公司	其他應收款－關係人	197,521	190,000
		J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	197,521	179,940
9	ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	10,951,489	1,139,620
			長期應收款－關係人		
10	ASE (Korea) Inc.	本公司	其他應收款－關係人	2,600,532	597,600
		日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	749,750
11	日月光電子元器件(昆山)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	119,960
12	ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	10,951,489	2,715,237
13	ASE Mauritius Inc.	J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	10,951,489	89,640
14	ASE Electronics (M) Sdn., Bhd.	本公司	其他應收款－關係人	702,500	479,840
15	環誠公司	本公司	其他應收款－關係人	3,461,300	2,099,300
		日月光半導體(昆山)有限公司	其他應收款－關係人	3,461,300	895,350
		J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	3,461,300	899,700
		環隆電氣公司	其他應收款－關係人	3,461,300	1,481,040
16	HHI	環隆電氣公司	其他應收款－關係人	4,338,842	1,529,490
		J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	4,338,842	1,598,025
17	Anstock Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司	長期應收款－關係人	10,951,489	3,045,441
18	上海鼎裕房地產開發有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	189,452
19	日月光半導體(昆山)有限公司	日月光電子元器件(昆山)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	12,532
		日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	908,145
20	日月鴻科技公司	本公司	其他應收款－關係人	(註三)	700,000
		J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	(註三)	695,130
21	RTH	本公司	其他應收款－關係人	3,876,115	1,568,160
22	日月光投資(昆山)有限公司	日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	597,600
		日月光封裝測試(上海)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	298,800
		日月光半導體(昆山)有限公司	其他應收款－關係人	10,951,489	599,800
23	日月光半導體(香港)有限公司	J & R Holding Limited	其他應收款－關係人	10,951,489	292,950

註一：對個別對象資金貸與限額為不超過該公司淨值之百分之二十。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十為限。

註二：因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度，以不超過該公司淨值百分之四十為限。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十五為限。

註三：本公司已於一〇一年五月吸收合併日月鴻科技公司。

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

年底額度餘額	年底實際動支餘額	利率區間(%)	資金貸與原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		業務往來金額	資金貸與最高限額(註二)
					名稱	價值		
$ —	$ —	5.23～7.22	營業週轉	$ —	—	$ —	$ —	$ 16,427,233
—	—	5.68～7.22	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
1,916,640	1,858,560	0.61～0.62	營業週轉	—	—	—	—	5,294,060
—	—	0.69～0.77	償還借款	—	—	—	—	16,427,233
508,200	508,200	0.61～0.70	償還借款	—	—	—	—	16,427,233
7,399,859	6,053,660	0.58～1.00	營業週轉	—	—	—	—	16,100,980
447,216	447,216	0.61～0.80	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
2,613,600	2,032,800	0.61～0.71	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
2,904	2,904	0.61～0.80	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
1,452,000	1,452,000	0.71～0.87	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
871,200	871,200	0.71	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
4,036,560	4,022,040	0.61～0.70	營業週轉	—	—	—	—	9,122,730
1,481,040	1,481,040	0.61～0.70	償還借款	—	—	—	—	16,427,233
1,074,480	1,074,480	0.61～0.70	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
1,161,600	1,161,600	0.61～0.62	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
2,000,000	1,490,000	0.97～1.01	營業週轉	—	—	—	—	8,204,700
1,301,803	560,000	0.64～1.00	營業週轉	—	—	—	—	8,204,700
60,000	60,000	0.99～1.00	營業週轉	—	—	—	—	8,204,700
438,919	438,919	5.68～5.90	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
—	—	—	營業週轉	—	—	—	—	1,279,102
190,000	190,000	0.97～1.00	營業週轉	—	—	—	—	395,041
—	—	0.97	營業週轉	—	—	—	—	395,041
174,240	170,000	0.98～1.00	營業週轉	—	—	—	—	395,041
1,103,520	1,103,520	0.71～0.97	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
290,400	290,400	3.31～3.46	營業週轉	—	—	—	—	5,201,064
726,000	726,000	3.31～3.55	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
116,160	116,160	1.80	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
2,240,472	2,018,400	0.58～0.70	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
—	—	0.65～0.69	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
261,360	—	0.62～0.70	營業週轉	—	—	—	—	1,405,001
1,916,640	1,916,640	0.61～0.68	營業週轉	—	—	—	—	6,922,600
—	—	0.64～0.69	營業週轉	—	—	—	—	6,922,600
871,200	871,200	0.61～0.65	營業週轉	—	—	—	—	6,922,600
319,440	319,440	0.61	營業週轉	—	—	—	—	6,922,600
—	—	0.71～0.96	營業週轉	—	—	—	—	8,677,683
1,597,200	1,597,200	0.71～0.87	營業週轉	—	—	—	—	8,677,683
2,970,789	2,970,789	4.45	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
184,808	184,808	5.90	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
12,225	12,225	2.78～6.56	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
406,560	406,560	2.29	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
—	—	0.97～0.98	營業週轉	—	—	—	—	(註三)
—	—	0.97～0.98	營業週轉	—	—	—	—	(註三)
1,568,160	1,568,160	0.61～0.65	營業週轉	—	—	—	—	7,752,231
—	—	2.34	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
—	—	2.34	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
—	—	2.34	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233
232,320	232,320	0.61～0.62	營業週轉	—	—	—	—	16,427,233

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

為他人背書保證

民國一〇一年度
附表二

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註一)
		公司名稱	關係	
0	本公司	Anstock Limited	間接持有表決權股份100%之子公司	$ 32,854,466

註一：依本公司「背書保證作業程序」，對單一企業之背書保證額度以不超過股東權益總額之百分之三十為限。
註二：依本公司「背書保證作業程序」，背書保證責任總額以不超過股東權益總額之百分之四十為限。
註三：係包含本金及利息。

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

本年度最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際動用餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率(%)	背書保證最高限額(註二)
$ 3,610,224 (人民幣770,313千元) (註三)	$ 3,438,832 (人民幣744,304千元) (註三)	$ 3,036,947 (人民幣657,319千元) (註三)	$ —	3.14	$ 43,805,954

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

期末持有有價證券情形明細表

民國一〇一年十二月三十一日
附表三

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
本公司	股票		
	J & R Holding Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環隆電氣公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	台灣福雷電子公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	A.S.E. Holding Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Omniquest Industrial Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Innosource Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	陸竹開發公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	宏璟建設公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	宏錦光公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	洋鼎科技公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	晶錡科技公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益轉列庫藏股票累計減損－晶錡		
	股票		
	漢驊創業投資公司	－	以成本衡量之金融資產－非流動
	漢大創業投資公司	－	以成本衡量之金融資產－非流動
	艾迪訊科技公司	－	以成本衡量之金融資產－非流動
	元隆電子公司	－	備供出售金融資產－非流動
	有限合夥		
	Ripley Cable Holdings I, L.P.	－	以成本衡量之金融資產－非流動
台灣福雷電子公司	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產－非流動
	Alto Enterprises Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Super Zone Holdings Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	艾迪訊科技公司	－	以成本衡量之金融資產－非流動
日月瑞公司	基金		
	日盛貨幣市場基金	－	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
	華南永昌麒麟貨幣市場基金	－	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	－	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
陸竹開發公司	股票		
	力晶科技公司	－	備供出售金融資產－流動
A.S.E. Holding Limited	股票		
	Oplink Communications, Inc.	－	備供出售金融資產－流動
	ASE Test Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Investment (Labuan) Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Global Strategic Investment Inc.	－	以成本衡量之金融資產－非流動
	InveStar Burgeon Venture Capital, Inc.	－	以成本衡量之金融資產－非流動
	SiPhoton, Inc.	－	以成本衡量之金融資產－非流動

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

年底						備註
股數／單位數	帳面金額		持股比率(%)	市價／股權淨值		
435,128	$	39,982,654	100	$	40,252,450	
1,209,573,053		23,523,817	99		20,312,908	
361,460,000		20,330,884	100		20,511,750	
243,966		13,082,152	100		13,235,151	
250,504,067		9,438,286	71		9,608,522	
86,000,000		3,369,162	100		3,374,459	
209,462,630		1,319,591	84		1,319,591	
68,629,782		1,138,690	26		895,619	
39,047,000		379,482	27		379,482	
23,318,400		104,510	100		103,056	
2,000,000		47,856	33		—	
1,200		30,006	100		30,006	
		112,747,090		$	110,022,994	
	(	300,149)				
	(	1,959,107)				
	(	47,856)				
	$	110,439,978				
4,435,245	$	44,352	15	$	35,181	
3,000,000		30,000	13		33,943	
28,376		1,166	—		205	
22,334,111		67,146	13		67,146	
—		308,643	4		393,286	
10,978,776(註)		276,665	—		276,665	
128,000,001		2,723,234	100		2,723,234	
100,000,000		3,028,385	100		3,028,385	
150,204		34,131	2		31,084	
6,711,313		96,400	—		96,400	
2,618,768		30,531	—		30,531	
2,834,498		44,871	—		44,871	
1,677,166		—	—		—	
50,210	美金	782千元	—	美金	782千元	
11,148,000	美金	88,594千元	10	美金	80,028千元	
147,642,842	美金	316,558千元	70	美金	316,558千元	
1,000,000	美金	850千元	3	美金	847千元	
455	美金	0.2千元	13	美金	2千元	
544,800	美金	1,500千元	4	美金	7千元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	艾迪訊科技公司	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	Global Strategic Investment, Inc. (Samoa)	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	可轉換公司債券		
	SiPhoton, Inc.	–	無活絡市場之債券投資－流動
J & R Holding Limited	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產－非流動
	ASE Test Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Omniquest Industrial Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	日月瑞公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Japan Co., Ltd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE (U.S.) Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Anstock Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證		
	蘇州日月新半導體有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	有限合夥		
	Crimson Velocity Fund, L.P.	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	H&QAP Greater China Growth Fund, L.P.	–	以成本衡量之金融資產－非流動
Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	股權憑證		
	日月光封裝測試(上海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光封裝測試(上海)有限公司	股權憑證		
	上海威宇宏欣半導體有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	上海鼎匯房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股票		
	日月光半導體(上海)公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	股票		
	ASE (Korea) Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Test Limited	股票		
	日月光半導體製造公司	最終母公司	備供出售金融資產－非流動
	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Test Holdings, Ltd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Test Finance Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Investment (Labuan) Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Singapore Pte. Ltd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	UC Fund II	–	以成本衡量之金融資產－非流動
ASE Test Holdings, Ltd.	股票		
	ISE Labs, Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	股票		
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
Omniquest Industrial Limited	股票		

年底						備註
股數／單位數	帳面金額		持股比率(%)	市價／股權淨值		
382,182	美金	96千元	4	美金	95千元	
500,000	美金	500千元	1	美金	499千元	
—	美金	3,000千元	—	美金	3,000千元	
46,703,763	美金	40,528千元	1	美金	40,528千元	
98,276,087	美金	914,849千元	90	美金	705,331千元	
30,200,000	美金	39,866千元	9	美金	39,866千元	
170,000,006	美金	34,008千元	100	美金	34,008千元	
7,200	美金	89,068千元	100	美金	88,347千元	
1,000	美金	8,560千元	100	美金	8,077千元	
190,000,000	美金	305,524千元	100	美金	292,713千元	
10,000	美金	231千元	100	美金	231千元	
—	美金	42,150千元	60	美金	42,150千元	
—	美金	2,289千元	—	美金	2,437千元	
—	美金	2,550千元	8	美金	1,873千元	
—	美金	308,417千元	100	美金	308,417千元	
—	人民幣	64,663千元	100	人民幣	64,663千元	
—	人民幣	2,383,031千元	60	人民幣	2,328,385千元	
6,283,605	美金	1,738千元	1	美金	1,738千元	
14,051,363	美金	452,207千元	100	美金	447,750千元	
88,200,472(註)	美金	76,538千元	1	美金	76,538千元	
71,428,902	美金	120,954千元	100	美金	120,954千元	
5	美金	91,821千元	100	美金	91,821千元	
2	美金	20千元	100	美金	20千元	
63,304,040	美金	135,668千元	30	美金	135,668千元	
30,100,000	美金	91,544千元	100	美金	91,544千元	
1,000,000	美金	345千元	7	美金	361千元	
26,250,000	美金	91,820千元	100	美金	71,175千元	
159,715,000	美金	120,954千元	100	美金	120,954千元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	ASE Corporation	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Corporation	股票		
	ASE Mauritius Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	ASE Labuan Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Mauritius Inc.	股票		
	日月光半導體(上海)公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證		
	日月光半導體(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	日月光電子元器件(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Labuan Inc.	股票		
	日月光電子公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
Innosource Limited	股權憑證		
	日月光電子元器件(上海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股票		
	Omniquest Industrial Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光半導體(上海)公司	股權憑證		
	上海鼎匯房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	日月光半導體(香港)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股票		
	環旭上海公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光電子元器件(上海)有限公司	股票		
	日月光半導體(上海)公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
上海鼎匯房地產開發有限公司	股權憑證		
	上海鼎威房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	上海鼎裕房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	昆山鼎泓房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	昆山鼎悅房地產開發有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE (Korea) Inc.	股權憑證		
	日月光半導體(威海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
Super Zone Holdings Limited	股權憑證		
	日月光集成電路製造(中國)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
Alto Enterprises Limited	股權憑證		
	日月光半導體(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	日月光投資(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光投資(昆山)有限公司	股權憑證		
	日月光半導體(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光半導體(昆山)有限公司	股權憑證		
	日月光電子元器件(昆山)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環隆電氣公司	股票		

年底						備註
股數／單位數	帳面金額		持股比率(%)	市價／股權淨值		
352,784,067	美金	468,469千元	100	美金	468,469千元	
217,800,000	美金	357,613千元	100	美金	357,613千元	
126,184,067	美金	110,701千元	100	美金	110,701千元	
1,062,682,358	美金	294,147千元	99	美金	294,147千元	
–	美金	53,850千元	37	美金	53,850千元	
–	美金	5,982千元	20	美金	5,982千元	
398,981,900	美金	110,115千元	100	美金	110,115千元	
–	美金	18,459千元	100	美金	18,459千元	
74,000,000	美金	97,720千元	21	美金	97,720千元	
–	人民幣	1,543,942千元	40	人民幣	1,554,198千元	
–	美金	7,293千元	100	美金	7,833千元	
9,049,238	人民幣	30,942千元	1	人民幣	107,143千元	
6,283,605	美金	1,738千元	1	美金	1,738千元	
–	人民幣	1,544,169千元	100	人民幣	1,544,169千元	
–	人民幣	1,102,056千元	100	人民幣	1,102,056千元	
–	人民幣	669,410千元	100	人民幣	669,410千元	
–	人民幣	329,687千元	100	人民幣	329,687千元	
–	美金	50,252千元	100	美金	50,252千元	
–	美金	104,279千元	100	美金	104,279千元	
–	美金	48,028千元	33	美金	48,028千元	
–	美金	45,747千元	100	美金	45,747千元	
–	美金	43,662千元	30	美金	43,662千元	
–	美金	23,929千元	80	美金	23,929千元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	全球創業投資公司	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	博智電子公司	–	備供出售金融資產－流動
	精磁科技公司	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	HHI	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	展毅公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	達基公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
展毅公司	股票		
	環隆電氣公司	母公司	以成本衡量之金融資產－非流動
HHI	股票		
	United Pacific Industrial Ltd.	–	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
	Cadence Design SYS Inc.	–	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
	環隆英國公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	UHI	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	UI	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	RTH	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環茂控股公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	RCI	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	RA	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	Solid Gain Invenstments Limited	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	特別股		
	Techgains I Corporation	–	以成本衡量之金融資產－非流動
	Techgains II Corporation	–	以成本衡量之金融資產－非流動
RCI	股權憑證		
	雲電貿易(上海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
UHI	股票		
	United Pacific Industrial Ltd.	–	公平價值變動列入損益之金融資產－流動
	Wacom Co., Ltd.	–	備供出售金融資產－非流動
	Sequans Communications SA	–	備供出售金融資產－非流動
	Asia Global Venture Co., Ltd.	–	以成本衡量之金融資產－非流動
RTH	股票		
	環誠公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證		
	環銓昆山有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環誠公司	股票		
	環旭上海公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環旭上海公司	股票		
	環鴻公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證		
	環勝深圳有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環鴻昆山有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環鴻公司	股票		
	環旭香港公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環鴻台灣公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環隆日本公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資

年底						備註
股數／單位數	帳面金額		持股比率(%)	市價／股權淨值		
6,200,000	$	72,000	5	$	59,177	
693,311		25,549	2		25,549	
733,000		—	2		5,057	
255,856,840		21,691,734	100		21,694,208	
39,329,700		439,168	100		507,695	
4,392,700		47,818	100		47,818	
22,922,913		420,604	2		376,975	
5,548,800	美金	243千元	1	美金	243千元	
9,633	美金	130千元	—	美金	130千元	
25,419,968	美金	5,645千元	100	美金	5,645千元	
3,000,000	美金	11,743千元	100	美金	11,743千元	
81,089		—	100		—	
149,151,000	美金	667,375千元	100	美金	667,375千元	
90,000,000	美金	27千元	100	美金	27千元	
6,000,000	美金	1,602千元	100	美金	1,602千元	
20,000	美金	1,262千元	100	美金	1,262千元	
2,000,000	美金	1,900千元	20	美金	1,334千元	
2,000,000	美金	833千元	10	美金	385千元	
1,500,000	美金	561千元	4	美金	212千元	
—	美金	1,167千元	100	美金	1,167千元	
5,613,600	美金	246千元	1	美金	246千元	
2,995	美金	7,841千元	1	美金	7,841千元	
370,554	美金	867千元	1	美金	867千元	
1,000,000	美金	1,000千元	10	美金	1,042千元	
210,900,000	美金	595,358千元	100	美金	595,358千元	
—	美金	13,717千元	100	美金	13,717千元	
895,874,563	美金	489,793千元	89	美金	1,687,559千元	
390,000,000	人民幣	549,752千元	100	人民幣	549,838千元	
—	人民幣	518,883千元	50	人民幣	535,683千元	
—	人民幣	101,717千元	100	人民幣	102,199千元	
85,800,000	美金	13,291千元	100	美金	13,291千元	
98,000,000	美金	42,492千元	100	美金	42,492千元	
6,400	美金	786千元	100	美金	786千元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	USI @ WORK	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	環隆墨西哥公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	USI－CA	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證		
	環勝深圳有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環旭香港公司	股票		
	環隆墨西哥公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
RA	股權憑證		
	雲湧電子(上海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資

註：台灣福雷電子公司持有本公司股票，其中9,600,219股以非保留運用決定權信託專戶保管，另1,378,557股納入集保；ASE Test Limited持有本公司股票88,200,472股，則全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

年底						備註
股數／單位數	帳面金額		持股比率(%)	市價／股權淨值		
250,000	美金	711千元	100	美金	711千元	
281,085,325	美金	26,473千元	100	美金	26,473千元	
250,000	美金	4,320千元	100	美金	4,320千元	
—	美金	85,225千元	50	美金	85,225千元	
1	美金	0.08千元	—	美金	0.08千元	
—	美金	1,262千元	100	美金	1,262千元	

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國一〇一年度
附表四

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額(註一)
本公司	股票					
	洋鼎科技公司	採權益法之長期股權投資	註三	無	–	$ –
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	A.S.E Holding Limited J&R Holding Limited ASE Test Limited	子公司	791,039,874	15,046,145
	基金					
	日盛貨幣市場基金	備供出售金融資產－流動	–	–	–	–
台灣福雷電子公司	基金					
	日盛貨幣市場基金	備供出售金融資產－流動	–	–	–	–
	寶來得寶貨幣市場基金	備供出售金融資產－流動	–	–	–	–
	股票					
	Alto Enterprises Limited	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	66,000,001	1,574,748
	債券					
	附買回政府債券	現金及約當現金	–	–	–	–
日月瑞公司	基金					
	凱基凱旋貨幣市場基金	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	–	–	–	–
A.S.E Holding Limited	股票					
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	本公司	母公司	15,964,200	美金 8,655千元
	ASE Investment (Labuan) Inc.	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	126,642,842	美金 303,324千元
J&R Holding Limited	股票					
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	本公司	母公司	87,448,562	美金 57,017千元
ASE Test Limited	股票					
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	本公司	母公司	162,404,554	美金 105,889千元
	ASE Investment (Labuan) Inc.	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	54,304,040	美金 129,996千元
Alto Enterprises Limited	股權憑證					
	日月光投資(昆山)有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	–
上海鼎匯房地產開發有限公司	股權憑證					
	上海鼎威房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	人民幣 1,065,430千元
	上海鼎裕房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	人民幣 798,960千元

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
20,820,000	$ 300,016	—	$ —	$ —	$ —	23,318,400	$ 104,510
265,817,316	4,837,875	—	—	—	—	1,209,573,053 (註五)	23,523,817
6,966,262	100,000	6,966,262	100,008	100,000	8	—	—
7,009,919	100,000	7,009,919	100,027	100,000	27	—	—
8,585,386	100,000	8,585,386	100,023	100,000	23	—	—
62,000,000	1,853,838	—	—	—	—	128,000,001	2,723,234
—	100,000	—	100,010	100,000	10	—	—
36,426,790	409,000	36,426,790	409,164	409,000	164	—	—
—	—	15,964,200	美金 9,747千元	美金 10,589千元	註四	—	—
21,000,000	美金 21,000千元	—	—	—	—	147,642,842	美金 316,558千元
—	—	87,448,562	美金 53,390千元	美金 66,309千元	註四	—	—
—	—	162,404,554	美金 99,153千元	美金 123,131千元	註四	—	—
9,000,000	美金 9,000千元	—	—	—	—	63,304,040	美金 135,668千元
—	美金 62,000千元	—	—	—	—	—	美金 45,747千元
—	人民幣 480,000千元	—	—	—	—	—	人民幣1,544,169千元
—	人民幣 300,000千元	—	—	—	—	—	人民幣1,102,056千元

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額(註一)
	昆山鼎泓房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	$ –
	昆山鼎悅房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	–
日月鴻科技公司	基金					
	日盛貨幣市場基金	備供出售金融資產－流動	–	–	–	–
	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	備供出售金融資產－流動	–	–	–	–
日月光封裝測試(上海)有限公司	股權憑證					
	上海鼎匯房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	人民幣 2,034,245千元
日月光半導體(上海)公司	股權憑證					
	上海鼎匯房地產開發有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	人民幣295,540千元
日月光投資(昆山)有限公司	股權憑證					
	日月光半導體(昆山)有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	–
日月光半導體(昆山)有限公司	股權憑證					
	日月光電子元器件(昆山)有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	–
ASE Investment (Labuan) Inc.	股票					
	ASE (Korea) Inc.	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	7,613,363	美金 433,295千元
環旭上海公司	股權憑證					
	環鴻昆山有限公司	採權益法之長期股權投資	註二	子公司	–	人民幣 50,234千元

註一：採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益及股東權益相關調整項目等。其他金融資產金額則包括以公平價值衡量之評價調整數。
註二：係辦理現金增資。
註三：係向玉山創業投資公司等八十三位股東購入。
註四：係組織架構調整。
註五：年底股數與年初股數及買入股數合計之差額係取得股票股利。

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
—	人民幣 670,000千元	—	$ —	$ —	$ —	—	人民幣 669,410千元
—	人民幣 330,000千元	—	—	—	—	—	人民幣 329,687千元
7,002,752	$ 100,000	7,002,752	100,043	100,000	43	—	—
7,621,032	120,000	7,621,032	120,023	120,000	23	—	—
—	人民幣 360,000千元	—	—	—	—	—	人民幣2,383,031千元
—	人民幣 1,160,000千元	—	—	—	—	—	人民幣1,543,942千元
—	美金 60,000千元	—	—	—	—	—	美金 43,662千元
—	美金 24,000千元	—	—	—	—	—	美金 23,929千元
6,438,000	美金 30,000千元	—	—	—	—	14,051,363	美金 452,207千元
—	人民幣 60,000千元	—	—	—	—	—	人民幣 101,717千元

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

取得重大不動產明細表

民國一〇一年度
附表五

取得之公司	財產名稱	交易日或事實發生日	交易金額	價款支付情形	交易對象	關係
本公司	房屋及建築物	101.05.02	$ 1,274,561(未稅)	已付訖	宏璟建設公司	被投資公司
台灣福雷電子公司	房屋及建築物	101.05.02	155,118(未稅)	已付訖	宏璟建設公司	母公司採權益法評價之被投資公司

單位：新台幣千元

交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
–	–	–	$ –	參酌專業機構出具之鑑價報告議定之	為因應未來產能擴充之需求，現有廠房恐不足以支應，故向宏璟建設公司購入K12廠房，以強化整體之發展	無
–	–	–	–	參酌專業機構出具之鑑價報告議定之	為因應未來產能擴充之需求，現有廠房恐不足以支應，故向宏璟建設公司購入K12廠房，以強化整體之發展	無

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

重大與關係人進、銷貨明細表

民國一〇一年度
附表六

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形	
			進(銷)貨	金額
本公司	日月光半導體(上海)公司	子公司	進貨	$ 1,418,504
	日月光電子公司	子公司	進貨	2,575,892
日月光封裝測試(上海)有限公司	日月光半導體(上海)公司	聯屬公司	進貨	932,170
日月光半導體(香港)有限公司	日月光半導體(上海)公司	母公司	進貨	738,595
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	日月光電子公司	聯屬公司	進貨	283,143
日月光半導體(上海)公司	本公司	最終母公司	銷貨	(1,418,504)
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(932,170)
	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	銷貨	(738,595)
日月光電子公司	本公司	最終母公司	銷貨	(2,575,892)
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	聯屬公司	銷貨	(283,143)
台灣福雷電子公司	本公司	母公司	銷貨	(165,076)
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司－荷蘭NXP B. V.之子公司	銷貨	(2,298,725)
環勝深圳有限公司	環旭香港公司	聯屬公司	進貨	人民幣 412,572千元
			銷貨	(人民幣 1,931,792千元)
環旭上海公司	環鴻公司	子公司	進貨	人民幣 1,623,942千元
	環旭香港公司	子公司	進貨	人民幣 86,869千元
			銷貨	(人民幣 1,446,703千元)
	環鴻昆山有限公司	子公司	銷貨	(人民幣 25,294千元)
環鴻公司	環旭上海公司	母公司	銷貨	(美金 252,373千元)
	環鴻昆山有限公司	聯屬公司	銷貨	(美金 33,419千元)
環旭香港公司	環勝深圳有限公司	聯屬公司	進貨	美金 306,030千元
			銷貨	(美金 22,350千元)
	環旭上海公司	母公司	進貨	美金 229,346千元
			銷貨	(美金 14,167千元)
	環鴻深圳有限公司	聯屬公司	進貨	美金 54,,170千元
			銷貨	(美金 5,385千元)
	環鴻台灣公司	聯屬公司	進貨	美金 40,351千元
			銷貨	(美金 471,932千元)
	環鴻昆山有限公司	聯屬公司	進貨	美金 11,833千元

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

交易情形		交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
佔總進(銷)貨之比率%	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	
6	月結60天	$ —	—	($ 412,551)	(5)	
11	月結60天	—	—	(705,027)	(9)	
21	月結60天	—	—	(151,971)	(21)	
100	月結90天	—	—	(200,931)	(100)	
16	發票日後60天	—	—	(49,112)	(15)	
(33)	月結60天	—	—	415,494	43	
(21)	月結60天	—	—	158,421	17	
(17)	月結90天	—	—	200,931	21	
(68)	月結60天	—	—	720,640	72	
(7)	發票日後60天	—	—	49,576	5	
(2)	月結60天	—	—	1,512,038	63	
(62)	月結90天	—	—	764,128	76	
13	75天	—	—	(人民幣 98,920千元)	(8)	
(54)	75天	—	—	人民幣 723,075千元	58	
24	75天	—	—	(人民幣 232,787千元)	(26)	
1	75天	—	—	(人民幣 18,996千元)	(2)	
(18)	75天	—	—	人民幣 246,239千元	14	
—	75天	—	—	人民幣 27,187千元	2	
(88)	75天	—	—	美金 37,122千元	57	
(12)	75天	—	—	美金 27,660千元	43	
47	75天	—	—	(美金 115,047千元)	(69)	
(3)	75天	—	—	美金 7,742	4	
35	75天	—	—	(美金 39,056千元)	(23)	
(2)	75天	—	—	美金 3,022千元	2	
8	75天	—	—	—	—	
(1)	75天	—	—	—	—	
6	75天	—	—	(美金 10,893千元)	(7)	
(72)	75天	—	—	美金 126,434千元	67	
2	75天	—	—	(美金 986千元)	(1)	

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形		
			進(銷)貨	金額	
環鴻深圳有限公司	環旭香港公司	聯屬公司	進貨	人民幣	48,797千元
			銷貨	(人民幣	341,570千元)
環鴻台灣公司	環旭上海公司	母公司	銷貨	($	228,325)
	環旭香港公司	聯屬公司	進貨		14,388,906
			銷貨	(	1,124,286)
	環勝深圳有限公司	聯屬公司	銷貨	(	150,204)
環鴻昆山有限公司	環旭上海公司	母公司	進貨	人民幣	25,296千元
	環鴻公司	聯屬公司	進貨	人民幣	24,306千元
	環旭香港公司	聯屬公司	銷貨	(人民幣	74,773千元)

交易情形		交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
佔總進(銷)貨之比率%	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	
15	75天	$ —	—	$ —	—	
(79)	75天	—	—	—	—	
(1)	75天	—	—	—	—	
84	75天	—	—	(3,670,670)	(77)	
(6)	75天	—	—	338,846	7	
(1)	75天	—	—	56,789	1	
6	75天	—	—	(人民幣 27,146千元)	(7)	
6	75天	—	—	(人民幣 188,428千元)	(51)	
(25)	75天	—	—	人民幣 6,197千元	3	

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

重大應收關係人款項明細表

民國一〇一年十二月三十一日
附表七

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額(註一)
本公司	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	子公司	$ 108,434 (註四)
日月光電子公司	本公司	最終母公司	720,780
ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	母公司	1,103,716 (註三)
Anstock Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	3,010,421 (註三)
A.S.E. Holding Limited	J & R Holding Limited	聯屬公司	515,097 (註三)
	本公司	最終母公司	1,858,560 (註三)
台灣福雷電子公司	本公司	母公司	3,044,291 (註四)
	J & R Holding Limited	聯屬公司	560,000 (註三)
	ASE (Korea) Inc.	聯屬公司	288,551 (註三)
ASE Test Limited.	本公司	最終母公司	4,022,040 (註三)
	J & R Holding Limited	母公司	1,494,610 (註三)
	ASE Singapore Pte.Ltd.	子公司	1,074,955 (註三)
	A.S.E. Holding Limited	母公司	1,162,954 (註三)
ASE (Korea) Inc.	日月光半導體(威海)有限公司	子公司	751,544 (註三)
	本公司	最終母公司	297,194 (註三)
J & R Holding Limited	日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司	2,037,562 (註三)
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands.	子公司	460,692
	本公司	母公司	6,053,660 (註三)
	日月光半導體(昆山)有限公司	聯屬公司	871,999 (註三)
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	1,459,004 (註三)
日月瑞公司	本公司	最終母公司	190,000 (註三)
	J & R Holding Limited	母公司	170,000 (註三)
ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	母公司	2,019,286 (註三)
日月光半導體(上海)公司	本公司	最終母公司	415,494
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	165,294
	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	200,931
日月光電子元器件(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	455,798 (註三)
日月光電子元器件(昆山)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	118,681 (註三)
日月光半導體(昆山)有限公司	日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司	409,124 (註三)

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

週轉率(次)(註二)	逾期應收關係人款項(註一)		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
	金額	處理方式		
4	$ 5	–	$ –	$ –
4	–	–	266,205	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	1,400	持續催收	448,441	–
–	–	–	100,000	–
–	162,900	持續催收	162,900	–
–	–	–	1,687	–
–	–	–	–	–
–	–	–	475	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	297,194	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	810,760	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	100,920	–
4	–	–	93,267	–
6	–	–	76,696	–
4	–	–	64,442	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	4,663	–	3,860	–

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額(註一)
上海鼎裕房地產開發有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	聯屬公司	$ 188,092 (註三)
日月光半導體(香港)有限公司	J & R Holding Limited	聯屬公司	232,373 (註三)
環誠公司	J & R Holding Limited	聯屬公司	871,660 (註三)
	本公司	最終母公司	1,916,640 (註三)
	環隆電氣公司	母公司	319,440
HHI	J & R Holding Limited	聯屬公司	1,597,959 (註三)
RTH	本公司	最終母公司	1,568,160 (註三)
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司－荷蘭NXP B. V.之子公司	764,439
環勝深圳有限公司	環旭香港公司	聯屬公司	人民幣 723,075千元
環旭上海公司	環旭香港公司	子公司	人民幣 246,239千元
	環鴻昆山有限公司	子公司	人民幣 27,187千元
環鴻香港公司	環旭上海公司	母公司	美金 37,122千元
	環鴻昆山有限公司	聯屬公司	美金 27,660千元
環旭香港公司	環勝深圳有限公司	聯屬公司	美金 7,742千元
	環鴻台灣公司	聯屬公司	美金 126,434千元
環鴻台灣公司	環旭香港公司	聯屬公司	$ 338,846

註一：係包含應收帳款及其他應收款。
註二：不含其他應收款。
註三：主係應收融資款；詳附表一說明。
註四：主係應收設備款。

週轉率(次)(註二)	逾期應收關係人款項(註一)		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
	金額	處理方式		
–	$ –	–	$ –	$ –
–	–	–	232,373	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
3	–	–	193,327	–
4	–	–	人民幣 228,293千元	–
5	–		人民幣 74,357千元	–
2	人民幣 4,588千元	持續催收	–	–
5	–	–	美金 27,350千元	–
2	–	–	美金 1,988千元	–
2	–	–	美金 3,046千元	–
4	–	–	美金 44,044千元	–
2	9,455	持續催收	$ 223,168	–

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊

民國一〇一年度
附表八

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
本公司	A.S.E. Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	J & R Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Innosource Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	宏錦光公司	台灣	自有剩餘攤位及辦公大樓出租
	宏璟建設公司	台灣	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口業務、房屋租售之介紹業務、室內設計裝潢工程
	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣
	日月鴻科技公司	台灣	從事電腦零組件、電腦及週邊設備、其他電機及電子機械器材、電子材料批發及零售業、國際貿易、其他顧問服務及租賃業務
	台灣福雷電子公司	台灣	半導體產品測試服務
	洋鼎科技公司	台灣	半導體產品封裝及測試業務
	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
	晶錡科技公司	台灣	從事電子零組件製造業、智慧財產權業、產品設計業、國際貿易業
台灣福雷電子公司	Alto Enterprises Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Super Zone Holdings Limited	香港	從事專業性投資活動
A.S.E. Holding Limited	ASEP Realty Corporation	菲 律 賓	房地產投資、買賣及出租
	ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	菲 律 賓	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
	ASE Test Limited	新 加 坡	從事專業性投資活動
	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
J & R Holding Limited	ASE Test Limited	新 加 坡	從事專業性投資活動
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣
	日月瑞公司	台灣	各型積體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等
	ASE Japan Co., Ltd.	日本	積體電路之封裝及製造
	ASE (U.S.) Inc.	美國	從事市場行銷支援及客戶服務等業務
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	開曼群島	從事專業性投資活動
	Anstock Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
	蘇州日月新半導體有限公司	中國大陸	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務等業務
Global Advanced Packaging	ASE Assembly & Test (HK) Limited	香港	從事貿易相關業務活動

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

原始投資金額		年底持有			被投資公司本年度損益	本年度認列之投資損益	備註
本年年底	去年年底	股數	比率	帳面金額			
美金 283,966千元	美金 283,966千元	243,966	100	$ 13,082,152	($ 71,310)	($ 76,431)	子公司
美金 479,693千元	美金 479,693千元	435,128	100	39,982,654	839,011	733,415	子公司
日幣 60,000千元	日幣 60,000千元	1,200	100	30,006	(739)	(738)	子公司
美金 250,504千元	美金 250,504千元	250,504,067	71	9,438,286	(195,669)	(132,788)	子公司
美金 86,000千元	美金 86,000千元	86,000,000	100	3,369,162	(22,032)	(20,434)	子公司
$ 390,470	$ 390,470	39,047,000	27	379,482	181,860	49,666	被投資公司
2,845,913	2,845,913	68,629,782	26	1,138,690	249,504	11,708	被投資公司
21,356,967	16,519,092	1,056,857,190	99	23,523,817	2,428,581	1,508,442	子公司
–	3,879,975	–	–	–	(6,733)	(2,958)	子公司
20,698,867	20,698,867	361,460,000	100	20,330,884	2,473,629	2,467,374	子公司
300,016	–	23,318,400	100	104,510	(183,010)	(195,506)	子公司
1,366,238	–	209,462,630	84	1,319,591	(8,512)	(6,139)	子公司
84,000	84,000	2,000,000	33	–	–	–	被投資公司
美金 128,000千元	美金 66,000千元	128,000,001	100	2,723,234	(381,371)		子公司
美金 100,000千元	美金 100,000千元	100,000,000	100	3,028,385	38,741		子公司
–	美金 234千元	–	–	–	美金 1千元		子公司
–	美金 57,141千元	–	–	–	(美金 77千元)		子公司
美金 84,889	美金 84,889千元	11,148,000	10	美金 88,594千元	美金 52,095千元		子公司
美金 –	美金 7,044千元	–	–	–	美金 82,286千元		子公司
美金 147,643千元	美金 126,643千元	147,642,842	70	美金 316,558千元	(美金 11,402千元)		子公司
美金 964,524千元	美金 964,524千元	98,276,087	90	美金 914,849千元	美金 52,095千元		子公司
美金 30,200千元	美金 30,200千元	30,200,000	9	美金 39,866千元	(美金 6,449千元)		子公司
美金 –	美金 57,406千元	–	–	–	美金 82,286千元		子公司
美金 51,344千元	美金 51,344千元	170,000,006	100	美金 34,008千元	(美金 187千元)		子公司
美金 25,606千元	美金 25,606千元	7,200	100	美金 89,068千元	美金 3,124千元		子公司
美金 4,600千元	美金 4,600千元	1,000	100	美金 8,560千元	(美金 653千元)		子公司
美金 190,000千元	美金 190,000千元	190,000,000	100	美金 305,524千元	(美金 17,788千元)		子公司
美金 10千元	美金 10千元	10,000	100	美金 231千元	美金 223千元		子公司
美金 21,600千元	美金 21,600千元	–	60	美金 42,150千元	美金 11,100千元		子公司
–	港幣 1,000千元	–	–	–	美金 6千元		子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
Technology Limited, Cayman Islands	日月光封裝測試(上海)有限公司	中國大陸	半導體產品封裝及測試業務
日月光封裝測試(上海)有限公司	上海威宇宏欣半導體有限公司	中國大陸	半導體產品封裝及測試業務
	上海鼎匯房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
	日月光半導體(上海)公司	中國大陸	從事半導體材料製造業務
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	南韓	電子零組件，通信機械器材製造
ASE Test Limited	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣
	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Test Holdings, Ltd.	開曼群島	從事專業性投資活動
	ASE Test Finance Limited	模里西斯	從事專業性理財活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
	ASE Singapore Pte. Ltd.	新加坡	半導體產品封裝測試業務
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	開曼群島	從事專業性投資活動
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc.	模里西斯	從事專業性投資活動
	ASE Labuan Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
ASE Mauritius Inc.	日月光半導體(上海)公司	中國大陸	從事半導體材料製造業務
	日月光高新科技(上海)有限公司	中國大陸	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務
	日月光半導體(昆山)有限公司	中國大陸	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務
	日月光電子元器件(昆山)有限公司	中國大陸	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	台灣	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業
Innosource Limited	日月光電子元器件(上海)有限公司	中國大陸	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
日月光半導體(上海)公司	上海鼎匯房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
	日月光半導體(香港)有限公司	香港	從事貿易相關業務活動
	環旭上海公司	中國大陸	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等
日月光電子元器件(上海)有限公司	日月光半導體(上海)公司	中國大陸	從事半導體材料製造業務
上海鼎匯房地產開發有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
	上海鼎裕房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理

原始投資金額		年底持有			被投資公司本年度損益	本年度認列之投資損益	備註
本年年底	去年年底	股數	比率	帳面金額			
美金 203,580千元	美金 203,580千元	–	100	美金 308,417千元	(美金 17,749千元)		子公司
人民幣 76,000千元	人民幣 76,000千元	–	100	人民幣 64,663千元	(人民幣 1,116千元)		子公司
人民幣 2,242,500千元	人民幣 1,882,500千元	–	60	人民幣 2,383,031千元	人民幣 83,786千元		子公司
美金 1,000千元	美金 1,000千元	6,283,605	1	美金 1,738千元	(美金 1,180千元)		子公司
美金 130,000千元	美金 100,000千元	14,051,363	100	美金 452,207千元	(美金 11,646千元)		子公司
–	美金 106,611千元	–	–	–	美金 82,286千元		子公司
美金 65,520千元	美金 65,520千元	71,428,902	100	美金 120,954千元	美金 22,957千元		子公司
美金 222,399千元	美金 222,399千元	5	100	美金 91,821千元	美金 3,317千元		子公司
–	–	2	100	美金 20千元	(美金 11千元)		子公司
美金 63,304千元	美金 54,304千元	63,304,040	30	美金 135,668千元	(美金 11,402千元)		子公司
美金 55,815千元	美金 55,815千元	30,100,000	100	美金 91,544千元	美金 22,346千元		子公司
美金 221,145千元	美金 221,145千元	26,250,000	100	美金 91,820千元	美金 3,319千元		子公司
美金 60,000千元	美金 60,000千元	159,715,000	100	美金 120,954千元	美金 22,957千元		子公司
美金 352,784千元	美金 352,784千元	352,784,067	100	美金 468,469千元	(美金 6,448千元)		子公司
美金 217,800千元	美金 217,800千元	217,800,000	100	美金 357,613千元	(美金 13,394千元)		子公司
美金 126,184千元	美金 126,184千元	126,184,067	100	美金 110,701千元	美金 6,955千元		子公司
美金 138,542千元	美金 121,265千元	1,062,682,358	99	美金 294,147千元	(美金 1,180千元)		子公司
–	美金 15,000千元	–	–	–	美金 100千元		子公司
美金 74,000千元	美金 74,000千元	–	37	美金 53,850千元	(美金 25,452千元)		子公司
美金 6,000千元	美金 6,000千元	–	20	美金 5,982千元	(美金 30千元)		子公司
美金 125,813千元	美金 125,813千元	398,981,900	100	美金 110,115千元	美金 6,957千元		子公司
美金 12,000千元	美金 12,000千元	–	100	美金 18,459千元	美金 636千元		子公司
美金 74,000千元	美金 74,000千元	74,000,000	21	美金 97,720千元	(美金 6,449千元)		子公司
人民幣 1,441,000千元	人民幣 281,000千元	–	40	人民幣 1,543,942千元	人民幣 83,786千元		子公司
美金 1,000千元	美金 1,000千元	–	100	美金 7,293千元	美金 89千元		子公司
人民幣 12,900千元	人民幣 12,900千元	9,049,238	1	人民幣 30,942千元	人民幣 639,571千元		子公司
美金 1,000千元	美金 1,000千元	6,283,605	1	美金 1,738千元	(美金 1,180千元)		子公司
人民幣 1,548,000千元	人民幣 1,068,000千元	–	100	人民幣 1,544,169千元	(人民幣 1,261千元)		子公司
人民幣 1,100,000千元	人民幣 800,000千元	–	100	人民幣 1,102,056千元	人民幣 3,096千元		子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
	昆山鼎泓房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
	昆山鼎悅房地產開發有限公司	中國大陸	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
ASE (Korea) Inc.	日月光半導體(威海)有限公司	中國大陸	一般類之分離式元器件封裝及測試業務
Super Zone Holdings Limited	日月光集成電路製造(中國)有限公司	中國大陸	從事半導體封裝測試、售後服務及諮詢
Alto Enterprises Limited	日月光半導體(昆山)有限公司	中國大陸	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務
	日月光投資(昆山)有限公司	中國大陸	從事專業性投資活動
日月光投資(昆山)有限公司	日月光半導體(昆山)有限公司	中國大陸	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務
日月鴻科技公司	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
日月光半導體(昆山)有限公司	日月光電子元器件(昆山)有限公司	中國大陸	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務
環隆電氣公司	HHI	英屬維京群島	控股公司
	展毅公司	台灣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資
	達基公司	台灣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資
HHI	環隆英國公司	英國	海外售後服務
	UHI	英屬維京群島	控股公司
	UI	香港	主機板及相關電腦週邊設備之買賣
	RTH	英屬維京群島	控股公司
	環茂控股公司	開曼群島	控股公司
	RCI	英屬維京群島	控股公司
	RA	英屬維京群島	控股公司
RCI	雲電貿易(上海)有限公司	中國大陸	電子產品及通訊產品批發
RTH	環銓昆山有限公司	中國大陸	生產計算機輔助系統及高性能主板、無線網路通訊卡等
	環誠公司	香港	控股公司
環誠公司	環旭上海公司	中國大陸	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等
環旭上海公司	環鴻公司	香港	控股公司
	環勝深圳有限公司	中國大陸	生產經營電腦主機板和其他相關電腦周邊設備及通訊和工業控制等產品之設計、製造及銷售
	環鴻深圳有限公司	中國大陸	新型電子元器件之研發設計及生產
	環鴻昆山有限公司	中國大陸	提供電子產品設計及製造服務
環鴻公司	環鴻深圳有限公司	中國大陸	新型電子元器件之研發設計及生產
	環旭香港公司	香港	製造、貿易及投資控股公司
	環鴻台灣公司	台灣	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業

原始投資金額		年底持有			被投資公司本年度損益	本年度認列之投資損益	備註
本年年底	去年年底	股數	比率	帳面金額			
人民幣 670,000千元	–	–	100	人民幣 669,410千元	(人民幣 590千元)		子公司
人民幣 330,000千元	–	–	100	人民幣 329,687千元	(人民幣 313千元)		子公司
美金 81,500千元	美金 81,500千元	–	100	美金 50,252千元	(美金 32,738千元)		子公司
美金 100,000千元	美金 100,000千元	–	100	美金 104,279千元	美金 1,294千元		子公司
美金 66,000千元	美金 66,000千元	–	33	美金 48,028千元	(美金 25,452千元)		子公司
美金 62,000千元	–	–	100	美金 45,747千元	(美金 2,025千元)		子公司
美金 60,000千元	–	–	30	美金 43,662千元	(美金 25,452千元)		子公司
$ –	$ 1,366,238	–	–	$ –	($ 8,512)		子公司
美金 24,000千元	–	–	80	美金 23,929千元	(美金 30千元)		子公司
$ 8,370,606	8,370,606	255,856,840	100	$ 21,691,734	$ 2,599,210		子公司
393,298	393,298	39,329,700	100	439,168	1,219		子公司
43,927	50,000	4,392,700	100	47,818	(172)		子公司
美金 39,410千元	美金 39,410千元	25,419,968	100	美金 5,645千元	美金 26千元		子公司
美金 3,000千元	美金 3,000千元	3,000,000	100	美金 11,743千元	美金 1,005千元		子公司
美金 10千元	美金 101千元	81,089	100	–	(美金 3千元)		子公司
美金 149,151千元	美金 149,151千元	149,151,000	100	美金 667,375千元	美金 89,094千元		子公司
美金 28,125千元	美金 28,125千元	90,000,000	100	美金 27千元	(美金 10千元)		子公司
美金 6,000千元	美金 6,000千元	6,000,000	100	美金 1,602千元	(美金 1,414千元)		子公司
美金 2,000千元	美金 2,000千元	20,000	100	美金 1,262千元	(美金 731千元)		子公司
美金 5,000千元	美金 5,000千元	–	100	美金 1,167千元	(美金 1,404千元)		子公司
美金 12,000千元	美金 12,000千元	–	100	美金 13,717千元	美金 200千元		子公司
美金 210,900千元	美金 210,900千元	210,900,000	100	美金 595,358千元	美金 87,258千元		子公司
美金 115,563千元	美金 115,563千元	895,874,563	89	美金 489,793千元	美金 101,320千元		子公司
人民幣 324,185千元	人民幣 324,185千元	390,000,000	100	人民幣 549,752千元	人民幣 156,859千元		子公司
人民幣 292,812千元	人民幣 267,448千元	–	50	人民幣 518,883千元	人民幣 226,895千元		子公司
–	人民幣 27,314千元	–	–	–	人民幣 6,110千元		子公司
人民幣 110,000千元	人民幣 50,000千元	–	100	人民幣 101,717千元	(人民幣 8,035千元)		子公司
–	美金 4,000千元	–	–	–	美金 969千元		子公司
美金 11,000千元	美金 11,000千元	85,800,000	100	美金 13,291千元	美金 3,675千元		子公司
美金 30,400千元	美金 30,400千元	98,000,000	100	美金 42,492千元	美金 5,213千元		子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
	環勝深圳有限公司	中國大陸	生產經營電腦主機板和其他相關電腦周邊設備及通訊和工業控制等產品之設計、製造及銷售
	環隆日本公司	日本	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
	USI @ WORK	美國	海外售後服務
	環隆墨西哥公司	墨西哥	主機板及電腦系統組裝
	USI－CA	美國	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務
環旭香港公司	環隆墨西哥公司	墨西哥	主機板及電腦系統組裝
RA	雲湧電子(上海)有限公司	中國大陸	從事電子元件、計算機主版、無限網絡通信元器件、通訊及移動通信產品及模塊及相關零配件之批發、佣金代理等

原始投資金額		年底持有			被投資公司本年度損益	本年度認列之投資損益	備註
本年年底	去年年底	股數	比率	帳面金額			
美金 37,500千元	美金 33,500千元	—	50	美金 85,225千元	美金 35,927千元		子公司
美金 885千元	美金 885千元	6,400	100	美金 786千元	美金 80千元		子公司
美金 250千元	美金 250千元	250,000	100	美金 711千元	美金 21千元		子公司
美金 23,963千元	美金 23,963千元	281,085,325	100	美金 26,473千元	美金 1,704千元		子公司
美金 9,500千元	美金 9,500千元	250,000	100	美金 4,320千元	美金 38千元		子公司
美金 0.08千元	美金 0.08千元	1	—	美金 0.08千元	美金 1,704千元		子公司
美金 2,000千元	美金 2,000千元	—	100	美金 1,262千元	(美金 734千元)		子公司

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

衍生性金融商品資訊

民國一〇一年度
附表九

非避險之衍生性金融商品

各子公司從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避已認列資產或負債因匯率波動產生之風險。各子公司於一〇一年十二月三十一日尚未到期之衍生性金融商品合約如下：

一、遠期外匯合約

子公司名稱	幣別	到期期間	合約金額(千元)
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	美金兌馬幣	102.01～102.02	USD8,000 / MYR24,549
	美金兌日幣	102.01	USD2,378 / JPY200,000
ASE Singapore Pte. Ltd.	美金兌新加坡幣	102.01～102.03	USD9,500 / SGD11,594
	美金兌日幣	102.02	USD569 / JPY45,581
ASE (Korea) Inc.	美金兌韓圜	102.01	USD18,000 / KRW19,368,700
	美金兌日幣	102.01	USD1,000 / JPY86,410
	美金兌歐元	102.01	USD700 / EUR528
洋鼎	新台幣兌美金	102.02	NTD29,104 / USD1,000
日月光電子	美金兌日幣	102.01	USD2,300 / JPY194,005
環旭上海	歐元兌美金	102.01～102.02	EUR500 / USD658
	美金兌人民幣	102.01～102.04	USD37,000 / CNY232,230

二、換匯合約

子公司名稱	幣別	到期期間	合約金額(千元)
台灣福雷	美金兌新台幣	102.01～102.03	USD104,800 / NTD3,050,749
	新台幣兌美金	102.06～102.08	NTD1,006,098 / USD34,000
日月光電子	美金兌新台幣	102.01～102.04	USD31,000 / NTD902,151
	新台幣兌美金	102.06～102.07	NTD266,892 / USD9,000
J&R Holding	美金兌日幣	102.01～102.02	USD58,886 / JPY4,850,000
RTH	美金兌人民幣	102.06	USD40,000 / CNY251,940
環電	新台幣兌美金	102.06	NTD290,670 / USD10,000

上述金融商品於一〇一年十二月三十一日經評價產生淨損失102,966千元。另各子公司一〇一年度承作非避險之衍生性金融商品產生淨損失19,651千元。

避險之衍生性金融商品

子公司日月光上海封測從事利率交換合約係為規避長期借款因利率變動而產生之現金流量風險，因該長期借款已於一〇一年六月提前清償，已不再符合避險關係之條件，是以由股東權益轉列金融資產評價利益7,107千元。另一〇一年度股東權益轉列利息費用減項4,360千元。

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司

大陸投資資訊

民國一〇一年度
附表十

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初自台灣匯出累積投資金額
日月光半導體(上海)公司	從事半導體材料製造業務	$ 4,236,563 (美金 133,812千元)	註一	$ 3,919,776 (美金 122,800千元)
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	6,227,985 (美金 200,000千元)	註一	4,432,785 (美金 140,000千元)
日月光電子元器件(上海)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	383,640 (美金 12,000千元)	註一	383,640 (美金 12,000千元)
日月光電子元器件(昆山)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	871,200 (美金 30,000千元)	註二	201,599 (美金 6,000千元)
日月光高新科技(上海)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	— (註十三)	註一	478,800 (美金 15,000千元)
日月光封裝測試(上海)有限公司	半導體產品封裝及測試業務	6,501,336 (美金 203,580千元)	註二	5,792,530 (美金 180,000千元)
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務等業務	1,568,467 (美金 48,672千元)	註二	711,180 (美金 21,600千元)
日月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元器件封裝及測試業務	3,244,744 (美金 107,200千元)	註二	1,295,307 (美金 40,000千元)
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	17,029,989 (人民幣 3,600,000千元)	註三	— (註三)
上海威宇宏欣半導體有限公司	半導體產品封裝及測試業務	337,499 (人民幣 76,000千元)	註三	— (註三)
上海鼎威房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	7,247,880 (人民幣 1,548,000千元)	註三	— (註三)
上海鼎裕房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	5,053,352 (人民幣 1,100,000千元)	註三	— (註三)

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

本年度匯出或收回投資金額		本年年底自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例(%)	本年度認列投資(損)益	年底投資帳面價值	截至本年年底已匯回投資收益
匯出	收回					
$ －	$ －	$ 3,919,776 (美金 122,800千元)	100	($ 38,962) (美金 －1,180千元) (註七)	$ 8,642,980 (美金 297,623千元)	無
1,795,200 (美金 60,000千元) (註十二)	－	6,227,985 (美金 200,000千元)	100	(752,785) (美金 －25,452千元) (註六)	4,226,467 (美金 145,539千元)	無
－	－	383,640 (美金 12,000千元)	100	18,784 (美金 636千元) (註七)	536,061 (美金 18,459千元)	無
－	－	201,599 (美金 6,000千元)	100	(874) (美金 －30千元) (註六)	868,614 (美金 29,911千元)	無
－	－	478,800 (美金 15,000千元)	100	2,949 (美金 100千元) (註七)	－ (註十三)	無
－	－	5,792,530 (美金 180,000千元)	100	(531,438) (美金 －17,749千元) (註六)	8,956,434 (美金 308,417千元)	無
－	－	711,180 (美金 21,600千元)	60	196,668 (美金 6,660千元) (註七)	1,224,022 (美金 42,150千元)	無
－	－	1,295,307 (美金 40,000千元)	100	(967,109) (美金 －32,738千元) (註七)	1,459,314 (美金 50,252千元)	無
－	－	－ (註三)	100	355,053 (人民幣 77,188千元)(註六) (註七)	18,143,235 (人民幣 3,926,973千元)	無
－	－	－ (註三)	100	3,252 (人民幣 697千元) (註六)	298,754 (人民幣 64,663千元)	無
－	－	－ (註三)	100	(5,892) (人民幣 －1,261千元) (註七)	7,134,302 (人民幣 1,544,169千元)	無
－	－	－ (註三)	100	14,415 (人民幣 3,096千元) (註七)	5,091,673 (人民幣 1,102,056千元)	無

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初自台灣匯出累積投資金額
昆山鼎泓房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	$ 3,143,652 (人民幣 670,000千元)	註三	$ – (註三)
昆山鼎悅房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理	1,547,912 (人民幣 330,000千元)	註三	– (註三)
日月光集成電路製造(中國)有限公司	從事半導體封裝測試、售後服務及諮詢	3,149,000 (美金 100,000千元)	註二	3,149,000 (美金 100,000千元)
日月光投資(昆山)有限公司	從事投資控股業務	1,853,838 (美金 62,000千元)	註一	–
環勝深圳有限公司	生產經營電腦主機板、其他相關電腦周邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售	2,270,625 (美金 75,000千元)	註一	1,180,746
環旭上海公司	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等	4,848,609 (人民幣 1,011,724千元)	註一	1,668,233
環銓昆山有限公司	生產計算機輔助系統及高性能主板、無線網路通訊卡等	383,201 (美金 12,000千元)	註一	383,201
雲電貿易(上海)有限公司	電子產品及通訊產品批發	147,450 (美金 5,000千元)	註一	147,450
環鴻深圳有限公司	新型電子元器件之研發設計及生產	– (註十四)	註三	– (註三)
環鴻昆山有限公司	提供電子產品設計及製造服務	521,963 (人民幣 110,000千元)	註三	– (註三)
珠海航電電纜有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	90,825 (美金 3,000千元)	註四	13,406
三朋友電電子(深圳)有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	15,138 (美金 500千元)	註四	2,483
昆山三朋友電電子有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	127,882 (美金 4,224千元)	註四	20,973
矽翔微機電系統(上海)有限公司	氣體流量暨感測器之製造及批發零售	227,063 (美金 7,500千元)	註五	3,035
雲湧電子(上海)有限公司	從事電子元件、計算機主板、無限網絡通信元器件、通訊及移動通信產品及模塊及相關零配件之批發、佣金代理等	60,868 (美金 2,000千元)	註二	–

本年度匯出或收回投資金額		本年年底自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例(%)	本年度認列投資(損)益	年底投資帳面價值	截至本年年底已匯回投資收益
匯出	收回					
$ －	$ －	$ － (註三)	100	($ 2,764) (人民幣 －590千元) (註七)	$ 3,092,778 (人民幣 669,410千元)	無
－	－	－ (註三)	100	(1,468) (人民幣 －313千元) (註七)	1,523,204 (人民幣 329,687千元)	無
－	－	3,149,000 (美金 100,000千元)	100	38,802 (美金 1,294千元) (註六)	3,028,274 (美金 104,279千元)	無
1,853,838 (美金 62,000千元) (註十二)	－	1,853,838 (美金 62,000千元)	100	(58,990) (美金 －2,025千元) (註六)	1,328,500 (美金 45,747千元)	無
－	－	1,180,746	89	926,867 (美金 31,353千元) (註八)	4,318,101 (美金 148,695千元)	無
－	－	1,668,233	89	2,665,028 (美金 90,150千元) (註八)	14,235,820 (美金 490,214千元)	無
－	－	383,201	99	5,877 (美金 199千元) (註八)	395,087 (美金 13,605千元)	無
－	－	147,450	99	(41,170) (美金 －1,393千元) (註八)	33,602 (美金 1,157千元)	無
－	－	－ (註三)	89	23,545 (美金 796千元) (註八)	－ (註十四)	無
－	－	－ (註三)	89	(35,719) (人民幣 －7,627千元) (註八)	416,500 (人民幣 90,148千元)	無
－	13,406	－	－	－	－	無
－	2,483	－	－	－	－	無
－	20,973	－	－	－	－	無
－	－	3,035	1	－	－	無
－	－	－	99	(21,515) (美金 －728千元) (註八)	36,358 (美金 1,252千元)	無

投資公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	本公司赴大陸地區投資限額
本公司	$ 15,203,097 (美金471,400千元)	$ 15,431,856 (美金531,400千元) (註九)	$ — (註十)
台灣福雷電子公司	7,015,358 (美金228,000千元)	7,363,838 (美金240,000千元)	12,307,050 (註十一)
環隆電氣公司	3,382,665	6,250,149 (美金209,175千元)	— (註十)

註一：係透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
註二：係透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
註三：係由大陸地區現有公司再投資。
註四：係本公司之子公司UHI於九十六年八月投資以成本衡量之金融資產三朋友電有限公司新發行之特別股計美金1,836千元，該公司計有上述三家現有大陸子公司，對大陸公司之投資金額係依間接投資之持股比例計算；於一〇一年三月全數贖回，收回本金美金1,836千元及股利美金110千元。
註五：係本公司之子公司UHI所投資之以成本衡量之金融資產Asia Global Venture Co., Ltd.以自有資金間接投資大陸公司，對大陸公司之投資金額係依間接投資之持股比例計算。
註六：依經台灣母公司簽證會計師核閱之財務報表揭露。
註七：依經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所核閱之財務報表揭露。
註八：依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師核閱之財務報表揭露。
註九：經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差額美金60,000千元，係由子公司ASE (Korea) Inc.直接匯出。
註十：依經濟部九十七年八月二十九日經審字第09704604680號令修正發布並自同年八月一日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點，本公司及子公司環隆電氣公司係取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。
註十一：茲將台灣福雷電子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下：$20,511,750×60%=$12,307,050
註十二：係同一筆資金由台灣福雷電子公司透過投資日月光投資(昆山)有限公司再轉投資日月光半導體(昆山)有限公司之投資金額。
註十三：已於一〇一年八月由日月光半導體(上海)公司吸收合併。
註十四：已於一〇一年十月由環勝深圳有限公司吸收合併。

日月光半導體製造股份有限公司

現金明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表一

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

項目	摘要	金額	
庫存現金	包括美金11千元、日幣7千元及新台幣824千元	$	1,157
銀行存款			
支票及活期存款			310,215
外幣活期存款	包括美金45,652千元、日幣162,543千元、歐元69千元		1,383,058
		$	1,694,430

註：美金匯率按USD1=NTD29.04換算。
日幣匯率按JPY1=NTD0.3364換算。
歐元匯率按EUR1=NTD38.49換算。

日月光半導體製造股份有限公司

應收帳款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表二

單位：新台幣千元

客戶名稱	金額		帳款結欠逾一年以上者	
非關係人				
Qualcomm Global Trading, Inc.	$	1,828,357	$	—
Broadcom Singapore Pte Ltd		835,665		—
Marvell Asia Pte Ltd		675,440		—
其他(註)		7,466,861		27
		10,806,323	$	27
關係人(註)		52,117		
		10,858,440		
減：備抵呆帳		21,931		
備抵銷貨折讓		99,312		
	$	10,737,197		

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

其他應收款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表三

單位：新台幣千元

名稱/項目	金額	備註
非關係人		
代收付款項	$ 1,025,664	主係Turnkey款
應收退稅款	119,371	
其他(註)	43,348	
	1,188,383	
關係人		
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	107,186	
日月光電子	79,603	
其他(註)	66,473	
	253,262	
	$ 1,441,645	

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

存貨明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表四

單位：新台幣千元

項目	金額	
	成本	淨變現價值
原料	$ 2,938,077	$ 2,948,118
物料	236,405	238,007
在製品	84,947	142,997
製成品	158,784	234,203
在途原物料	120,466	120,466
	$ 3,538,679	$ 3,683,791

日月光半導體製造股份有限公司

採權益法評價之長期股權投資變動明細表

民國一〇一年度
明細表五

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

被投資公司	年初餘額 股數	年初餘額 金額	本年度增加(註一) 股數	本年度增加(註一) 金額	本年度減少(註一) 股數	本年度減少(註一) 金額
普通股						
上市公司						
宏璟	68,629,782	$ 1,124,692	—	$ 13,998	—	$ —
未上市櫃公司						
J&R Holding	435,128	41,267,217	—	—	—	1,284,563
環電	791,039,874	15,046,145	418,533,179	8,477,672	—	—
台灣福雷	361,460,000	20,447,313	—	—	—	116,429
ASE Holding	243,966	13,718,783	—	—	—	636,631
Omniquest	250,504,067	9,510,489	—	—	—	72,203
Innosource	86,000,000	3,391,310	—	—	—	22,148
陸竹	—	—	209,462,630	1,324,528	—	4,937
宏錦光	39,047,000	329,817	—	49,665	—	—
洋鼎	—	—	23,318,400	300,016	—	195,506
ASE MS Japan	1,200	34,723	—	—	—	4,717
晶錡	6,000,000	47,856	—	—	4,000,000	—
日月鴻	242,496,267	3,622,590	732,844	10,993	243,229,111	3,633,583
		108,540,935		10,176,872		5,970,717
減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益		300,149		—		—
轉列庫藏股票		1,959,107		—		—
累計減損－晶錡		47,856		—		—
		$ 106,233,823		$ 10,176,872		$ 5,970,717

被投資公司	年底餘額 股數	年底餘額 持股%	年底餘額 金額	市價或股權淨值(註二) 單價(元)	市價或股權淨值(註二) 總金額	提供擔保或質押情形
普通股						
上市公司						
宏璟	68,629,782	26.2	$ 1,138,690	$ 13.1	$ 895,619	無
未上市櫃公司						
J&R Holding	435,128	100.0	39,982,654	92,507.2	40,252,450	無
環電	1,209,573,053	99.2	23,523,817	19.2	20,312,908	無
台灣福雷	361,460,000	100.0	20,330,884	56.8	20,511,750	無
ASE Holding	243,966	100.0	13,082,152	54,250.0	13,235,151	無
Omniquest	250,504,067	70.6	9,438,286	38.4	9,608,522	無
Innosource	86,000,000	100.0	3,369,162	39.2	3,374,459	無
陸竹	209,462,630	84.3	1,319,591	6.3	1,319,591	
宏錦光	39,047,000	27.3	379,482	9.7	379,482	無
洋鼎	23,318,400	100.0	104,510	5.0	103,056	
ASE MS Japan	1,200	100.0	30,006	25,005.2	30,006	無
晶錡	2,000,000	33.3	47,856	—	—	無
日月鴻	—	—	—	—	—	無
			112,747,090		$ 110,022,994	
減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益			300,149			
轉列庫藏股票			1,959,107			
累計減損－晶錡			47,856		—	
			$ 110,439,978			

註一：本年度變動包括增加投資、採權益法認列投資損益、股東權益相關調整項目及獲配現金股利等。
註二：市價係指資產負債表日之普通股收盤價；股權淨值係依據各被投資公司之財務報表及本公司持股比例計算。
註三：依權益法認列之投資損益請參閱財務報表附註九。

日月光半導體製造股份有限公司

固定資產變動明細表

民國一〇一年度
明細表六

單位：新台幣千元

	年初餘額	本年度增加	本年度減少	重分類(註)	吸收合併計入	年底餘額	提供擔保或質押情形
成本							
土地	$ 1,558,201	$ —	$ —	$ —	$ —	$ 1,558,201	無
建築物及附屬設備	21,964,804	3,866,832	(70,409)	(242,231)	319,133	25,838,129	無
機器設備	71,586,364	17,350,056	(6,525,300)	(208,060)	1,041,445	83,244,505	無
運輸設備	68,522	376	(3,654)	—	3,822	69,066	無
辦公設備	876,756	77,314	(37,706)	1,351	38,591	956,306	無
租賃資產	1,351	—	—	(1,351)	—	—	無
	96,055,998	21,294,578	(6,637,069)	(450,291)	1,402,991	111,666,207	
未完工程	765,382	(253,670)	—	945	—	512,657	無
在途機器及預付設備款	2,755,995	189,185	(15,594)	1,464	—	2,931,050	無
	99,577,375	$ 21,230,093	(6,652,663)	(447,882)	1,402,991	115,109,914	
累計折舊							
建築物及附屬設備	(7,990,400)	($ 1,252,446)	43,809	(100,518)	(146,695)	(9,446,250)	
機器設備	(45,838,136)	(7,284,697)	6,324,826	136,046	(704,191)	(47,366,152)	
運輸設備	(52,419)	(6,761)	3,510	—	(3,076)	(58,746)	
辦公設備	(753,550)	(62,357)	37,462	(1,328)	(36,497)	(816,270)	
租賃資產	(1,159)	(169)	—	1,328	—	—	
	(54,635,664)	($ 8,606,430)	6,409,607	35,528	(890,459)	(57,687,418)	
累計減損							
建築物及附屬設備	(44,146)	($ 12,750)	11,251	—	(109,220)	(154,865)	
機器設備	—	—	—	—	(33,766)	(33,766)	
	(44,146)	($ 12,750)	11,251	—	(142,986)	(188,631)	
	$ 44,897,565		($ 231,805)	($ 412,354)	$ 369,546	$ 57,233,865	

註：本期重分類係遞延費用轉入2,410千元及轉列出租資產414,764千元。

日月光半導體製造股份有限公司

短期借款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表七

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

借款種類及債權人	年底餘額	借款期間	年利率(%)	融資額度	抵押或擔保
週轉性借款					
瑞穗實業銀行	$ 1,717,000	101.12～102.01	0.95	美金 60,000千元	無
香港上海匯豐銀行	1,380,000	101.12～102.03	1.03	美金 50,000千元	無
三菱東京日聯銀行	580,800	101.10～102.04	0.92	美金 20,000千元	無
臺灣銀行	414,922	101.11～102.02	0.86	美金 20,000千元	無
合作金庫商業銀行	564,225	101.12～102.01	0.91	$ 600,000千元	無
兆豐國際商業銀行	563,376	101.12～102.06	1.01	美金 65,000千元	無
台灣土地銀行	290,400	101.12～102.01	1.00	$ 500,000千元	無
	$ 5,510,723				

日月光半導體製造股份有限公司

應付帳款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表八

單位：新台幣千元

廠商名稱	金額
非關係人	
欣興電子公司	$ 871,456
南亞電路板公司	676,286
Samsung Electro － Mechanics Co., Ltd.	542,734
景碩科技公司	518,894
其他(註)	3,866,101
	6,475,471
關係人	
日月光電子	705,027
日月光上海	412,551
其他(註)	1,804
	1,119,382
	$ 7,594,853

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

其他應付款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表九

單位：新台幣千元

名稱 / 項目	金額	備註
關係人		
J&R Holding	$ 6,053,660	係應付融資款
ASE Test	4,022,040	係應付融資款
台灣福雷	3,042,794	主係應付融資款及代收應付測試費
環誠	1,916,640	係應付融資款
ASE Holding	1,858,560	係應付融資款
Real Tech	1,568,160	係應付融資款
其他(註)	584,661	
	19,046,515	
非關係人		
其他(註)	746,456	主係代收款
	$ 19,792,971	

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

應付設備款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表十

單位：新台幣千元

廠商名稱	金額
佳能半導體設備公司	$ 131,196
其他(註)	2,422,566
	$ 2,553,762

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

長期借款明細表

民國一〇一年十二月三十一日
明細表十一

債權銀行	期限及償還辦法	年利率(%)
(一)指定用途專案借款		
花旗銀行主辦之銀行團	每半年為一期平均償還至一〇二年三月	2.06
(二)週轉性借款		
花旗銀行主辦之銀行團	自一〇一年六月起，每半年為一期平均償還至一〇四年六月	0.96～1.59
渣打國際商業銀行	將於一〇三年十二月到期一次清償	0.90
台北富邦商業銀行	將於一〇三年十二月到期一次清償	1.15
台灣土地銀行	將於一〇四年三月到期一次清償	1.05
星展銀行	將於一〇三年五月到期一次清償	1.16
澳商澳盛銀行	將於一〇三年十二月到期一次清償	1.15
巴黎銀行	將於一〇三年四月到期一次清償	1.26~1.50
加拿大豐業銀行	將於一〇三年二月到期一次清償	1.07
台灣銀行	將於一〇三年八月到期一次清償	1.25
台新國際商業銀行	將於一〇四年五月到期一次清償	1.21
新加坡華僑銀行	將於一〇三年十二月到期一次清償	1.30
合作金庫商業銀行	將於一〇三年六月到期一次清償	1.30
台灣新光商業銀行	將於一〇三年十月到期一次清償	1.25
大台北商業銀行	將於一〇三年四月到期一次清償	1.03
中華開發工業銀行	將於一〇四年九月到期一次清償	1.40
板信銀行	將於一〇三年八月到期一次清償	1.34
日盛銀行	將於一〇三年十一月到期一次清償	1.30
華南商業銀行	將於一〇三年三月到期一次清償	1.50

註一：銀行團包括(二十八家)
花旗銀行、東方匯理銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、第一商業銀行、香港上海匯豐銀行、華南商業銀行、荷商安智銀行、台灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、三井住友銀行、台北富邦商業銀行、台灣銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、台新國際商業銀行、新加坡華僑銀行、玉山商業銀行、瑞穗實業銀行、台灣中小企業銀行、大華銀行、台灣工業銀行、永豐商業銀行、台灣新光商業銀行、台中銀行、日盛國際商業銀行及遠東國際商業銀行。

註二：銀行團包括(二十四家)
花旗銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、第一商業銀行、香港上海匯豐銀行、華南商業銀行、台灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、三井住友銀行、台北富邦商業銀行、台灣銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、台新國際商業銀行、新加坡華僑銀行、玉山商業銀行、瑞穗實業銀行、台灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、三菱東京日聯銀行、中華開發工業銀行、上海商業儲蓄銀行、泰國盤谷銀行及加拿大豐業銀行。

註三：本公司預計以一〇一年十二月三十一日前已取得之長期融資額度清償將於一年內到期之部分借款，是以5,557,386千元未列入一年內到期部分。另一〇一年十二月三十一日未攤銷遞延主辦費21,653千元。

單位：新台幣千元

金額				
一年內到期	一年後到期	合計	抵押或擔保	備註
$ –	$ 2,537,500	$ 2,537,500	無	註一
1,028,571	9,092,572	10,121,143	無	註二
–	2,320,000	2,320,000	無	
–	1,916,640	1,916,640	無	
–	1,500,000	1,500,000	無	
–	1,452,000	1,452,000	無	
–	1,161,600	1,161,600	無	
–	1,135,600	1,135,600	無	
–	1,045,440	1,045,440	無	
–	1,000,000	1,000,000	無	
–	871,200	871,200	無	
–	871,200	871,200	無	
–	800,000	800,000	無	
–	300,000	300,000	無	
–	200,000	200,000	無	
–	200,000	200,000	無	
–	200,000	200,000	無	
–	120,000	120,000	無	
–	100,000	100,000	無	
1,028,571	24,286,252	25,314,823		
$ 1,028,571	$ 26,823,752	$ 27,852,323		註三

日月光半導體製造股份有限公司

營業收入明細表

民國一〇一年度
明細表十二

單位：新台幣千元
(除另予註明者外)

項目	數量(千個)	金額
先進基板或導線架型積體電路(QFP, Flip Chip, BGA等)	6,954,274	$ 60,638,069
其他(註)		12,288,583
		$ 72,926,652

註：各項金額皆未超過本科目金額之百分之十。

日月光半導體製造股份有限公司

營業成本明細表

民國一〇一年度
明細表十三

單位：新台幣千元

項目	金額
直接材料耗用	
年初原料	
本年度進料	$ 2,683,678
減：出售原料	26,160,966
其他	(540,767)
年底原料	(2,938,077)
本年度耗料	25,365,800
直接人工	6,512,442
製造費用	22,196,218
製造成本	54,074,460
加：年初在製品	182,839
其他	26,455
減：年底在製品	(84,947)
製成品成本	54,198,807
加：年初製成品	150,145
減：年底製成品	(158,784)
其他	(61,801)
	54,128,367
其他	432,775
	$ 54,561,142

日月光半導體製造股份有限公司

營業費用明細表

民國一〇一年度
明細表十四

單位：新台幣千元

項目	研究發展費用	推銷費用	管理及總務費用	合計
薪資	$ 2,114,581	$ 51,915	$ 1,458,876	$ 3,625,372
銷售服務費	—	722,194	—	722,194
折舊	453,616	959	196,982	651,557
專業服務費	99,971	—	181,826	281,797
員工保險費	154,899	4,018	80,301	239,218
試產材料	215,547	—	1,005	216,552
退休金	99,467	2,771	58,749	160,987
修繕費	70,945	54	84,410	155,409
攤銷	58,829	161	88,774	147,764
其他	559,502	78,373	794,011	1,431,886
	$ 3,827,357	$ 860,445	$ 2,944,934	$ 7,632,736

五、最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司　公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司(日月光公司)及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　陳珍麗

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第1010028123號

會計師　龔俊吉

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

中華民國一〇二年三月四日

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

代碼	資產	一〇一年十二月三十一日 金額	%	一〇〇年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金	$ 20,265,551	8	$ 24,421,789	11
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	4,035,000	2	706,755	–
1320	備供出售金融資產－流動	48,266	–	48,794	–
1360	無活絡市場之債券投資－流動	87,120	–	90,825	–
1140	應收帳款淨額	37,212,587	15	30,475,788	14
1160	其他應收款	572,183	–	693,016	–
1210	存貨	15,171,042	6	13,920,757	6
1220	存貨－營建房地	16,902,018	7	16,149,498	7
1286	遞延所得稅資產－流動	762,552	1	1,135,525	1
1298	其他流動資產	2,986,004	1	2,488,943	1
11XX	流動資產合計	98,042,323	40	90,131,690	40
	基金及投資				
1450	備供出售金融資產－非流動	320,026	–	173,085	–
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	827,882	–	893,283	–
1421	採權益法之長期股權投資	1,218,023	1	1,154,360	1
14XX	基金及投資合計	2,365,931	1	2,220,728	1
	固定資產				
1501	土地	3,040,515	1	3,075,183	1
1521	建築物及附屬設備	62,071,245	25	55,738,712	25
1531	機器設備	191,479,488	78	175,652,291	79
1551	運輸設備	294,377	–	291,694	–
1561	辦公設備	5,254,442	2	4,965,374	2
1611	租賃資產及租賃改良	211,477	–	666,370	–
15X1	成本合計	262,351,544	106	240,389,624	107
15X9	減：累計折舊	144,267,903	58	137,123,072	61
1599	累計減損	314,659	–	313,969	–
		117,768,982	48	102,952,583	46
1671	未完工程	3,340,892	1	4,059,709	2
1672	在途機器及預付設備款	5,040,422	2	4,766,744	2
15XX	固定資產合計	126,150,296	51	111,779,036	50
	無形資產				
1760	商譽	10,306,823	4	10,374,501	5
1782	土地使用權	3,736,658	1	3,420,700	1
1788	其他無形資產	1,758,364	1	1,977,214	1
17XX	無形資產合計	15,801,845	6	15,772,415	7
	其他資產				
1810	閒置資產	1,092,502	1	1,114,054	1
1820	存出保證金	84,298	–	99,779	–
1830	遞延費用	427,967	–	1,045,356	–
1860	遞延所得稅資產－非流動	1,844,389	1	1,459,103	1
1887	受限制資產	201,862	–	218,178	–
1888	其他	492,702	–	37,756	–
18XX	其他資產合計	4,143,720	2	3,974,226	2
1XXX	資產總計	$ 246,504,115	100	$ 223,878,095	100

單位：新台幣千元(惟每股面額為新台幣元)

代碼	負債及股東權益	一〇一年十二月三十一日 金額	%	一〇〇年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$ 36,884,926	15	$ 22,965,133	10
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	467,148	–	134,274	–
2200	避險之衍生性金融負債－流動	4,524	–	–	–
2140	應付帳款	24,226,701	10	21,191,923	9
2160	應付所得稅	2,784,310	1	2,400,592	1
2170	應付費用	9,500,430	4	8,939,719	4
2224	應付設備款	5,291,348	2	5,699,504	3
2262	預收房地款	167,017	–	47,667	–
2272	一年內到期長期借款	3,167,050	1	3,418,799	2
2286	遞延所得稅負債－流動	246,180	–	175	–
2288	一年內到期應付租賃款	46,727	–	42,161	–
2298	其他流動負債	1,917,048	1	1,921,938	1
21XX	流動負債合計	84,703,409	34	66,761,885	30
	長期負債				
2430	避險之衍生性金融負債－非流動	–	–	58,279	–
2410	應付公司債	10,804,551	4	10,876,538	5
2420	長期借款	33,783,165	14	39,266,414	17
2443	長期應付款	–	–	200,000	–
2446	應付租賃款	3,969	–	23,925	–
24XX	長期負債合計	44,591,685	18	50,425,156	22
	其他負債				
2810	應計退休金負債	3,260,783	1	3,304,841	2
2860	遞延所得稅負債－非流動	946,577	1	624,740	–
2888	其他	542,593	–	478,979	–
28XX	其他負債合計	4,749,953	2	4,408,560	2
2XXX	負債合計	134,045,047	54	121,595,601	54
	母公司股東權益				
	股本				
3110	普通股股本－每股面額10元，額定股數為9,500,000；千股發行股數一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別為7,594,150千股及6,753,563千股	75,941,496	31	67,535,632	30
3140	預收股本	106,171	–	35,693	–
31XX	股本合計	76,047,667	31	67,571,325	30
	資本公積				
3210	發行股票溢價	1,704,700	1	1,615,449	1
3220	庫藏股票交易	83,117	–	1,402,632	1
3260	長期投資	5,690,964	2	3,522,280	1
3271	員工認股權	1,288,353	1	857,120	–
32XX	資本公積合計	8,767,134	4	7,397,481	3
33XX	保留盈餘	26,969,183	11	27,809,126	13
	股東權益其他項目				
3450	金融商品未實現利益	401,938	–	235,088	–
3420	累積換算調整數	119,987	–	3,353,938	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(831,917)	–	(465,681)	–
3480	庫藏股票－一〇一年及一〇〇年十二月三十一日分別為145,883千股及233,456 千股	(1,959,107)	(1)	(4,731,741)	(2)
34XX	股東權益其他項目淨額	(2,269,099)	(1)	(1,608,396)	(1)
	母公司股東權益合計	109,514,885	45	101,169,536	45
3610	少數股權	2,944,183	1	1,112,958	1
3XXX	股東權益合計	112,459,068	46	102,282,494	46
	負債及股東權益總計	$ 246,504,115	100	$ 223,878,095	100

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

代碼		一〇一年度 金額	一〇一年度 %	一〇〇年度 金額	一〇〇年度 %
	營業收入				
4110	銷貨收入	$ 195,714,665	101	$ 186,715,534	101
4190	減：銷貨退回及折讓	1,742,273	1	1,368,328	1
4100	營業收入淨額	193,972,392	100	185,347,206	100
5000	營業成本	157,348,622	81	150,338,403	81
5910	營業毛利	36,623,770	19	35,008,803	19
	營業費用				
6300	研究發展費用	7,874,210	4	7,117,964	4
6100	推銷費用	2,762,763	2	2,770,045	2
6200	管理及總務費用	8,225,415	4	8,299,543	4
6000	合計	18,862,388	10	18,187,552	10
6900	營業淨利	17,761,382	9	16,821,251	9
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	322,197	–	330,674	–
7310	金融資產評價利益－淨額	420,845	–	1,118,488	1
7160	兌換利益－淨額	965,404	1	36,203	–
7121	權益法認列之投資收益	61,374	–	96,938	–
7122	股利收入	66,129	–	621,488	–
7480	其他	599,280	1	854,917	1
7100	合計	2,435,229	2	3,058,708	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	2,004,315	1	1,666,325	1
7650	金融負債評價損失－淨額				
7630	減損損失	97,234	–	448,056	–
7880	其他	366,017	–	517,982	1
7500	合計	3,606,075	2	2,882,798	2

代碼		一〇一年度 金額	一〇一年度 %	一〇〇年度 金額	一〇〇年度 %
7900	合併稅前淨利	$ 16,590,536	9	$ 16,997,161	9
8110	所得稅費用	3,041,628	2	3,018,212	1
9600XX	合併總純益	$ 13,548,908	7	$ 13,978,949	8
	歸屬予：				
9601	母公司股東	$ 13,091,359	7	$ 13,725,958	8
9602	少數股權	457,549	–	252,991	–
		$ 13,548,908	7	$ 13,978,949	8

代碼		一〇一年度 稅前	一〇一年度 稅後	一〇〇年度 稅前	一〇〇年度 稅後
	母公司股東每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	$ 1.96	$ 1.76	$ 2.00	$ 1.83
9850	稀釋每股盈餘	$ 1.91	$ 1.71	$ 1.95	$ 1.78

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

代碼		股本			保留盈餘
		普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積
A1	一〇〇年一月一日餘額	$ 60,519,872	$ 299,698	$ 7,180,585	$ 4,205,489
	九十九年度盈餘分配				
N1	提列法定盈餘公積	–	–	–	1,833,750
N5	提列特別盈餘公積	–	–	–	–
P5	普通股股票股利－11.5%	6,957,357	–	–	–
P1	普通股現金紅利－6.5%	–	–	–	–
S5	採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	–	–	(4,960)	–
Q5	備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–	–
J8	發放予子公司股利調整資本公積	–	–	74,160	–
Q7	現金流量避險未實現損益增減	–	–	–	–
L1	員工認股權發行	–	–	537,973	–
G1	員工認股權行使	428,403	(264,005)	424,928	–
M1	一〇〇年度合併總純益	–	–	–	–
R5	外幣財務報表換算產生兌換差額增減	–	–	–	–
R1	未認列為退休金成本之淨損失增減	–	–	–	–
J1	庫藏股票買回－105,475千股	–	–	–	–
J3	庫藏股票註銷－37,000千股	(370,000)	–	(815,205)	–
S1	少數股權增減	–	–	–	–
T1	收購子公司股權後少數股權變動影響數	–	–	–	–
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	67,535,632	35,693	7,397,481	6,039,239
	一〇〇年度盈餘分配				
N1	提列法定盈餘公積	–	–	–	1,372,596
P5	普通股股票股利－14.0%	9,315,995	–	–	–
P1	普通股現金紅利－6.5%	–	–	–	–
E9	特別盈餘公積迴轉	–	–	–	–
S5	採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	–	–	2,168,684	–
Q5	備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–	–
J8	發放予子公司股利調整資本公積	–	–	83,117	–
Q7	現金流量避險未實現損益增減	–	–	–	–
L1	員工認股權發行	–	–	445,120	–
G1	員工認股權行使	144,619	70,478	100,593	–
M1	一〇一年度合併總純益	–	–	–	–
R5	外幣財務報表換算產生兌換差額增減	–	–	–	–
R1	未認列為退休金成本之淨損失增減	–	–	–	–
J3	庫藏股票註銷－105,475千股	(1,054,750)	–	(1,427,861)	–
S1	少數股權增減	–	–	–	–
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	$ 75,941,496	$ 106,171	$ 8,767,134	$ 7,411,835

單位：新台幣千元

保留盈餘			股東權益其他項目					
特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	金融商品未實現利益(損失)	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票	少數股權	股東權益合計
$ —	$ 20,767,455	$ 24,972,944	$ 246,303	($ 1,120,618)	($ 398,103)	($ 3,144,312)	$ 3,282,956	$ 91,839,325
—	(1,833,750)	—	—	—	—	—	—	—
1,272,417	(1,272,417)	—	—	—	—	—	—	—
—	(6,957,357)	(6,957,357)	—	—	—	—	—	—
—	(3,932,419)	(3,932,419)	—	—	—	—	—	(3,932,419)
—	—	—	(174,005)	—	(68,355)	—	—	(247,320)
—	—	—	9,290	—	—	—	(1,470)	7,820
—	—	—	—	—	—	—	—	74,160
—	—	—	153,500	—	—	—	—	153,500
—	—	—	—	—	—	—	—	537,973
—	—	—	—	—	—	—	—	589,326
—	13,725,958	13,725,958	—	—	—	—	252,991	13,978,949
—	—	—	—	4,474,556	—	—	95,701	4,570,257
—	—	—	—	—	777	—	3,079	3,856
—	—	—	—	—	—	(2,772,634)	—	(2,772,634)
—	—	—	—	—	—	1,185,205	—	—
—	—	—	—	—	—	—	(44,294)	(44,294)
—	—	—	—	—	—	—	(2,476,005)	(2,476,005)
1,272,417	20,497,470	27,809,126	235,088	3,353,938	(465,681)	(4,731,741)	1,112,958	102,282,494
—	(1,372,596)	—	—	—	—	—	—	—
—	(9,315,995)	(9,315,995)	—	—	—	—	—	—
—	(4,325,284)	(4,325,284)	—	—	—	—	—	(4,325,284)
(1,272,417)	1,272,417	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	148,355	—	(32,010)	—	—	2,285,029
—	—	—	(26,122)	—	—	—	—	(26,122)
—	—	—	—	—	—	—	—	83,117
—	—	—	44,617	—	—	—	—	44,617
—	—	—	—	—	—	—	—	445,120
—	—	—	—	—	—	—	—	315,690
—	13,091,359	13,091,359	—	—	—	—	457,549	13,548,908
—	—	—	—	(3,233,951)	—	—	(61,874)	(3,295,825)
—	—	—	—	—	(334,226)	—	—	(334,226)
—	(290,023)	(290,023)	—	—	—	2,772,634	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1,435,550	1,435,550
$ —	$ 19,557,348	$ 26,969,183	$ 401,938	$ 119,987	($ 831,917)	($ 1,959,107)	$ 2,944,183	$ 112,459,068

董事長：張虔生　　經理人：張洪本　　會計主管：董宏思

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併總純益	$ 13,548,908	$ 13,978,949
A20000	調整項目		
A20300	折舊費用	22,135,412	21,319,438
A20400	攤銷費用	1,278,879	1,625,958
A21200	股份基礎給付酬勞成本	445,120	537,973
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	519,431	433,418
A22400	權益法認列之投資收益	(61,374)	(96,938)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	54,904	27,452
A23700	金融資產減損損失	23,693	93,370
A23900	非金融資產減損損失	73,541	354,686
A24800	遞延所得稅費用	571,176	460,403
A29900	其他調整項目	(536,747)	601,263
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產減少(增加)	(3,328,245)	488,518
A31140	應收帳款減少(增加)	(6,686,670)	765,343
A31160	其他應收款減少	80,096	376,945
A31180	存貨增加	(1,728,671)	(1,191,659)
A31190	存貨－營建房地增加	(752,520)	(3,908,426)
A31211	其他流動資產增加	(807,780)	(697,969)
A32110	公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少)	332,874	(354,544)
A32140	應付帳款增加(減少)	2,992,599	(3,197,294)
A32160	應付所得稅增加(減少)	383,718	(339,119)
A32170	應付費用增加	534,821	1,095,081
A32200	預收房地款增加	119,350	6,292
A32212	其他流動負債與其他負債減少	(174,570)	(442,434)
AAAA	營業活動之淨現金流入	29,017,945	31,936,706
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(838,443)	(1,700,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	770,163	2,078,725
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(52,790)	(97,130)
B01000	處分以成本衡量之金融資產價款	54,180	–
B01101	以成本衡量之金融資產減資退回股款	34,598	24,308
B01400	採權益法之長期股權投資增加	–	(285,709)
B01600	取得子公司股權價款淨額	(261,607)	(2,106,203)
B01800	採權益法之被投資公司減資退回股款	–	267,478
B01900	購置固定資產	(39,301,272)	(29,417,906)
B02000	處分固定資產價款	385,164	1,292,012
B02500	存出保證金減少(增加)	15,391	(40,405)
B02800	受限制資產減少	19,368	55,505
B02900	無形資產增加	(895,466)	(1,158,835)
B04800	其他資產增加	(23,250)	(942,537)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(40,093,964)	(32,030,697)
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	13,919,793	8,810,615
C00400	發行公司債	–	10,841,834
C00900	舉借長期借款	13,840,778	29,852,451
C01000	償還長期借款	(18,969,491)	(43,783,427)
C01600	存入保證金增加(減少)	3,234	(6,789)

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
C01702	應付租賃款增加(減少)	($ 14,521)	$ 25,786
C02100	母公司發放現金股利(扣除子公司獲配數)	(4,242,167)	(3,858,259)
C02400	員工執行認股權	315,690	589,326
C02500	庫藏股票買回成本	–	(2,772,634)
C03300	少數股權增加(減少)	3,602,439	(41,537)
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	8,455,755	(342,634)
DDDD	匯率影響數	(1,535,974)	1,460,857
EEEE	本年度現金淨(減少)增加金額	(4,156,238)	1,024,232
E00100	年初現金餘額	24,421,789	23,397,557
E00200	年底現金餘額	$ 20,265,551	$ 24,421,789
FFFF	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	本年度支付利息	$ 2,140,357	$ 1,784,181
F00200	減：資本化利息	248,839	263,307
F00300	不含資本化利息之本年度支付利息	$ 1,891,518	$ 1,520,874
F00400	支付所得稅	$ 2,081,690	$ 2,896,928
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動		
H00300	固定資產增加數	$ 38,893,116	$ 31,032,002
H00500	應付設備款減少(增加)	408,156	(1,614,096)
H00800	購買固定資產支付現金數	$ 39,301,272	$ 29,417,906
H00900	出售固定資產價款	$ 343,039	$ 1,283,436
H01000	其他應收款減少－出售固定資產	42,125	8,576
H01100	出售固定資產收取現金數	$ 385,164	$ 1,292,012
GGGG	不影響現金流量之融資活動		
G00100	一年內到期長期借款	$ 3,167,050	$ 3,418,799
G00200	一年內到期應付租賃款	46,727	42,161

除附註二所述收購子公司流通在外股權外，新取得子公司之資訊如下：

一、公司於一〇一年一月以總價款300,016千元收購洋鼎科技公司(洋鼎)100%股權，購併日所支付之淨現金及洋鼎之資產與負債之公平價值分別列示如下：

流動資產	$	171,015
固定資產		265,902
其他資產		4,574
流動負債	(	96,929)
長期借款	(	44,800)
其他負債	(	1,200)
		298,562
商譽		1,454
併購總價款		300,016
減：併購日取得之現金	(	38,409)
取得子公司股權之淨現金流出	$	261,607

二、日月鴻科技公司(日月鴻)分別於一〇〇年十月及十一月向力晶科技公司(力晶)及其聯屬公司等購入陸竹開發公司(陸竹)計84.25%股權，併購日所支付之淨現金及所取得資產與負債之公平價值列示如下：

流動資產	$	1,636,455
其他資產		4
流動負債	(	981)
長期借款	(	60,000)
		1,575,478
乘以取得股權百分比		84.25%
		1,327,339
商譽		38,899
併購總價款		1,366,238
減：併購日取得之現金	(	13,709)
以應收帳款抵繳	(	1,000,000)
應付投資款	(	200,000)
取得子公司股權之淨現金流出	$	152,529

董事長：張虔生 經理人：張洪本 會計主管：董宏思

本公司合併財務報表依中華民國一般公認會計原則編製並針對國際會計原則(美國一般公認會計原則)所作之調節：

海外財務報告因適用中華民國及美國兩地會計原則不一致之差異調節項目主係企業合併—購買法之會計處理、非控制股權交易、員工認股權、未分配盈餘加徵10%營利事業所得稅、權益法投資會計處理調整中華民國及美國兩地會計原則差異影響數、退休金及減損資產折舊處理等。

詳細調節內容請參考本公司向美國證管會申報之2012英文年報(20-F)

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122411/000095010313002514/dp37493_20f.htm

單位：新台幣仟元

差異調節項目	中華民國一般公認會計原則	美國一般公認會計原則
(1)歸屬予母公司股東之合併總純益	13,091,359	12,477,633
(2)基本每股稅後盈餘(元)	1.76	1.68
(3)稀釋每股稅後盈餘(元)	1.71	1.67
(4)資產總額	246,504,115	242,656,744
(5)負債總額	134,045,047	136,212,511
(6)少數股權(非控制股權)	2,944,183	3,106,845
(7)母公司股東權益	109,514,885	103,337,388

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事：無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

(一) 固定資產增加主要係本期因應營運成長而購置固定資產之資本支出增加所致。

(二) 資產總額增加主要係本期因產能擴充購置固定資產增加及認列被投資公司損益所致。

(三) 流動負債增加主要係向子公司融通資金致其他應付款項增加所致。

二、財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

本年度持續擴充產能，使得營業收入和營業成本較去年增加。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

(一)最近年度現金流量分析

現金流量比率及現金再投資比率減少，主因係向子公司融通資金致流動負債增加所致。

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額①+②−③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
$1,694,429	$15,585,931	$26,511,186	($9,230,826)	−	$10,625,490

1.現金流量變動情形分析

營業活動：預計102年度營業淨利增加、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。

投資活動：預計102年度購置機器設備及擴建廠房。

融資活動：預計102年度將償還部份銀行借款及母子公司間資金貸與款項。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：銀行借款及母子公司間資金貸與。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形
				一〇二年度
擴建廠房	營運資金及銀行借款	102.12	4,517,395	4,517,395
購置機器設備	營運資金及銀行借款	102.12	8,215,902	8,215,902

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二)預計可能產生效益

A. 預計將增加之產銷量、值及毛利

單位：數量仟個 / 新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
一〇二	半導體製造封裝	3,699,093	3,699,093	12,526,943	2,739,945
一〇二	半導體製造測試	(348,901)	(348,901)	215,820	167,518

註：僅針對一〇二年度重大之資本支出於一〇二年度預計產生之效益估算。

B.其他效益說明：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司最近年度之轉投資政策主要係以大陸投資事業之投資為主，並以核心競爭力為主要考量，對每一投資案皆經審慎評估後為之。有關大陸地區投資九十七年度依經濟部九十七年八月二十九日經審字第09704604680號令修正發布並自同年八月一日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點修正案，由於本公司係取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。

本公司轉投資事業普遍均經營良善，有不等之獲利狀況，部分投資公司產生虧損或因處於初期發展擴充階段，或因階段任務完成，結束營業之故，相信經一段時日，即可獲得改變。

六、風險事項分析評估：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措 施：

於2011下半年引發之歐債危機，至2012年中東政局動盪不安、美國復甦跡象不甚穩定、中國大陸經濟成長趨緩及高失業率等，全球經濟面臨多重挑戰。多數主要先進經濟體均採取量化寬鬆貨幣政策以刺激經濟，更使通膨數據面臨考驗並造成貨幣競貶等問題。部份國家因當地通膨數據升溫逐步調高利率，我國中央銀行為維持金融穩定及利率平穩，遂維持不升息。有鑑於此，公司審慎管理現金部位，以期在最低風險下，提高現金部位報酬率；觀測利率趨勢與波動情形，必要時將評估標的負債以利率交換合約固定其利率，以規避營運上所產生之利率風險。公司亦將維持適足與活絡之金融機構融資額度，以期維持低融資成本，降低利息支出；輔以運用金融市場及資本市場相對低利率之融資工具，將現有借款進行再融資或提前清償。對於匯率變動之風險管理策略，未來將以密切注意國際經濟事件並觀察其變化、降低市場波動性風險為主要管理方向。配置低風險、短天期、安全且避險性高之投資標的為主要方針，並檢視公司資金配置，達有效管理之目標。因此，避險策略以採短天期現金流量避險為主，對長天期之資本支出或經常性風險部位，則採自然避險為原則。展望未來，經濟發展深受外需牽動的我國，自然無法免於全球經濟與金融動盪局勢影響，應以審慎態度面對挑戰。本公司除以更有效率之管理提高產品良率及品質，降低耗損增加獲利率，亦將更審慎維持穩健之財務操作。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司並未從事高風險、高槓桿之投資，本公司已依據證期局的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」(含衍生性金融商品處理程序)及「背書保證作業程序」。對於背書保證之政策，則以事先評估其必要性及合理性為執行依據；對於衍生性商品交易政策，均視避險標的之部位大小與避險之必要性，於自然避險後採取適時適量之穩健避險方式執行財務風險管理，並經適當授權及簽呈核准。

(三) 未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用：

1. 未來研發計劃(包括正在進行中)

封裝技術

新技術(Advanced Technology)	
3D系統封裝(3D SiP)	1. 晶片-晶片、晶片-晶圓堆疊技術 (Die-to-Die, Die-to-Wafer Stacking)
	2. 微間距銅柱覆晶封裝技術 (Fine Pitch Cu Pillar FC Solution)
	3. 矽材基板系統封裝技術 (Si Interposer SiP Technology)
	4. 熱壓融接技術 (Thermo-compression Bonding Technology)
	5. 晶圓級微機電封裝 (Wafer Level MEMS Packaging)
	6. 內引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-in Map PoP Technology)
	7. 外引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-out Map PoP Technology)
	8. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術 (Thin Core FC PoP Technology)
	9. 整合被動元件封裝技術 (Integrated Passive Device)
	10. 整合電阻動元件封裝技術 (Integrated Passive Resistor Device)
	11. 基板內埋被動元件技術 (Embedded Passives Laminate Substrate)
	12. 矽材基板內埋被動元件技術 (Embedded Passive Si Substrate)
	13. 矽材基板內埋主動元件技術 (Embedded Active Si Substrate)
	14. 異質晶片整合系統封裝 (Heterogeneous Chip Integration SiP)
	15. 微間距面對面堆疊系統封裝 (Fine Pitch CoC SiP Solution)
光電封裝(OEP)	1. 高功率、高亮度LED封裝方案 (High Power / High Brightness LED Packaging Solution)
	2. 晶圓級白光LED封裝方案 (Wafer Level White Light LED Packaging Solution)
	3. 光感測元件封裝技術 (Optical Sensor Packaging Solution)
	4. 光電整合傳導技術 (Optical-Electronic Interconnection)
晶圓級封裝(WLCSP)	1. 晶圓穿導孔技術 (Through Silicon Via)
	2. 矽基板封裝技術 (Silicon Substrate Technology)
	3. 疊層晶圓之薄化技術 (Bonded Wafer Thinning Technology)
	4. 雙層PI晶圓RDL電鍍銅技術 (2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology)
	5. 300 mm 二維外引腳式晶圓級封裝 (300 mm Wafer 2D Fan-out WLP)
	6. 200 mm 三維外引腳式晶圓級封裝 (200 mm Wafer 3D Fan-out WLP)
覆晶封裝(Flip Chip)	1. 綠色環保覆晶封裝 (Flip Chip Green Package Solution)
	2. 無核心層機板之覆晶封裝 (Coreless Flip Chip Package)
	3. 20奈米超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝 (20 nm ELK Wafer Lead-free FC)
	4. 300 mm晶圓50微米厚度研磨技術 (300 mm Wafer 50um Backgrind Technology)
	5. 300 mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術 (300 mm TSV Wafer 50 um CMP Technology)
	6. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術 (SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
	7. 微間距非導電覆晶薄膜底材 (Fine Pitch NCF Underfill Technology)
	8. 壓合式晶圓級覆晶封技術 (Laminated FC CSP)

射頻模組(RF Module)	1. Wi-Fi + BT + GPS+ FM + NFC系統模組完整方案 (Wi-Fi + BT + GPS+ FM +NFC Combo SiP Module Total Solution)
	2. 藍芽低耗能模組完整方案 (Bluetooth Low-Energy Module Total Solution)
	3. MCU + WiFi模組完整方案 (MCU Wireless Connection Module Total Solution)
	4. Conformal /Compartment式電磁干擾遮蔽方案 (Conformal / Compartment EMI Shielding Solution)
	5. 基板內埋被動元件通訊模組 (Embedded Passive Substrate Wireless Module)
微機電封裝(MEMS Packaging)	晶圓級微機電封裝技術 (Wafer Level MEMS Packaging)
銲線封裝(Wire Bond Package)	1. 22/20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝 (22/20 nm Cu / ELK Wafer Wire Bond Solution)
	2. 15微米銅線製程開發 (15 um Cu Wire Bond Technology Development)
	3. 新銅線材料製程開發 (New Cu Wire Bonding Material Technology Development)
	4. 新打線材料製程開發 (New Wire Bonding Material Technology Development)
	5. 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案 (Low Cost & High Performance aS3 / aQFN)
凸塊(Bumping)	
印刷製程(Printing)	1. 無助焊劑晶圓凸塊技術 (Fluxless Wafer Bumping Technology)
	2. 多層PI晶圓凸塊技術 (Wafer Bumping Technology with Multi-PI-Layers)
電鍍製程(Plating)	1. 低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術 (Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)
	2. 單層PI與單層銅 RDL 結構之晶圓級封裝技術 (Single PI and Single RDL for WLCSP)
	3. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術 (High Aspect Ratio Cu Pillar Plating Technology)
	4. 高長寬比銅柱凸塊技術 (Non-circular High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping)

測試技術

新測試技術(New Test Technology)	
晶圓測試(Wafer probe)	12吋晶圓測試能力與技術 (12" Wafer probe testing capability & Technology)
晶圓測試(Wafer probe)	1. 晶圓凸塊垂直探針技術(Wafer Bumping vertical probing Technology)
	2. 射頻晶圓測試技術(RF wafer probing Testing Technology)
	3. 超低介電係數晶圓測試方案(Ultra Low K wafer probing Solution)
後段封裝測試(Final Test)	1. 射頻藍芽無線產品測試技術(RF Bluetooth/wireless device testing technology)
	2. 箝入式與堆疊式記憶體測試能力(Embedded/stack memory testing capability)
	3. 邏輯電路/消費性元件測試服務(Logic/consumer Device Testing Service)
	4. 多工並列元件測試能力(Multiple site testing capability)
	5. 三重溫度測試技術(Tri-temp testing technology)
	6. 超高速介面元件測試技術(USB3.0 testing technology)
	7. 微機電產品測試技術(MEMS testing technology)
	8. 高頻模組測試(SiP RF module testing technology)

IGBT模組製程技術

新製程技術(New Process Technology)	
晶片焊錫組裝(Solder Die Bond)	1. 13mm以上晶片焊錫組裝能力與技術
	2. 焊錫介面空隙小於5%
基片焊錫組裝 (Substrate Attachment)	1. 60mm X 60mm以上基片焊錫組裝能力與技術
	2. 焊錫介面空隙小於3%
IGBT測試(IGBT Test)	1. 靜態測試技術(Static tests technology)
	1-1. 集射極崩潰電壓(Collector Emitter Breakdown Voltage)
	1-2. 集極至射極的洩漏電流IcEs
	1-3. 集極至射極的飽和電壓(Collector to emitter saturation voltage)
	1-4. 二極體順向電壓(Diode Forward Voltage)
	1-5. 閘極臨界電壓(Gate threshold Voltage)
	1-6. 跨導(Transconductance)
	1-7. 閘極電荷(QGE, QcG, QG)及閘極電容(Cies, Coes, Cres)
	1-8. 閘極至射極之洩漏電流IGEs
	2. 動態測試技術(Dynamic tests technology)
	2-1. 切換時間及切換損失(Switching Times and Saritching Losses)
	2-2. 短路測試(Short-Circuit testing)

2. 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣350,000仟元，另其他封裝研發費用預計投入新台幣3,150,000仟元。

測試試產預計投入之研發費用為新台幣38,250仟元，另其他測試研發費用預計投入新台幣1,300仟元。

模組製程技術測試試產預計投入之研發費用為新台幣100,500仟元。

3. 未來研發得以成功之主要影響因素

- 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合
- 現有封裝技術低成本最佳解決方案
- 流程、製程標準化暨產業鏈整合
- 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入
- 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
- 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
- 完善的產品研發流程及專案管理系統
- 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 充分掌握市場行銷之供需狀況，並依據市場動態與趨勢，先行開發先進封裝、基板與測試技術以確保技術領先地位，適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
- 研發人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化
- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規與綠色設計(Eco-design)之產品設計、研發與製造
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 與標竿客戶策略聯盟、降低研發成本與風險
- 晶片-封裝-系統一元化設計(IC-package-system Co-design)
- 依據市場分析結果，先行開發先進 Substrate確保技術領先地位
- 現有測試技術低成本最佳方案
- 測試程式開發能力的建立與深耕
- 依據市場分析結果，先行開發模組組裝技術，確保領先地位

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

金管會於九十八年五月十四日宣布之「我國企業採用國際會計準則推動架構」，上市上櫃公司及興櫃公司應自一〇二年起依證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會翻譯並由金管會發布之國際財務報導準則、國際會計準則及解釋暨相關指引(以下稱「IFRSs」)編製合併財務報告，為因應上開修正，本公司業已成立專案小組，並訂定採用IFRSs之計畫，該計畫係由財務長董宏思統籌負責，已依照計畫所訂之內容及預計完成時程執行。另本公司亦評估現行會計政策與未來依IFRSs編製財務報表所採用之會計政策二者間可能存在之重大差異，並揭露於一〇一年度合併財務報表中。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 全球總體經濟的不確定性與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是日月光透過與客戶及廠商的共同開發來符合客戶需求與降低成本及風險，並強化市場資訊的蒐集與分析來降低產品需求改變對科技所造成的影響。
2. 客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷趨勢與供需動態之狀況，並依據市場趨勢方向與標竿客戶產品藍圖，先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位，結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本，提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。

3. 新技術研發創新的經驗中，開發經費與關鍵新設備扮演極為重要一環。因應措施為確保新技術和日月光未來藍圖發展一致，並積極和客戶策略聯盟，落實資源共享，以降低研發風險。日月光定期拜訪產業領先地位之客戶，透過技術研討會與標竿客戶共同規劃產品藍圖與產品規範，確保研發技術能符合客戶上市需求。
4. 日月光南投廠(ASENT)長期紮根於電力電子產品發展，生產軍用級和工業級的DCDC converter功率模組(Power Module)等產品，提供多項解決方案給高功率的電力電子工業應用，日月光透過與客戶的更密切互動來掌握客戶需求及其變化，並強化市場資訊的收集與分析來降低科技改變所帶來的影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持誠信、守法及善盡社會責任之經營理念，故本公司之企業形象一向良好，最近年度亦無企業形象改變之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施： 無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

由於半導體市場成長前景樂觀，預計日月光集團2013年之成長幅度會超越2012年的成長率。至於投資部分，鑒於落實現有產能之充分及有效利用，日月光集團前幾年在產能上之擴充已能滿足部分成長之訂單，為提昇實質報酬率並降低投資風險，對於市場之成長乃以現有產能與設備為主，新設備之投資案，除因應新廠房之使用外，將以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨過度集中容易因為供應端的生產異常或品質異常造成斷料，同時削減對供應端的議價能力，本公司對於直接材料、機器設備等供貨來源，訂定有分散供應來源的政策，針對少數供應集中的資材進行開發替代廠商(2nd Source)；另外對於市場寡佔的國外供應來源，積極培植具技術研發潛力的國內協力廠商供貨，以達分散風險、降低成本的企業目標。
2. 本公司銷貨並無過度集中之情事。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

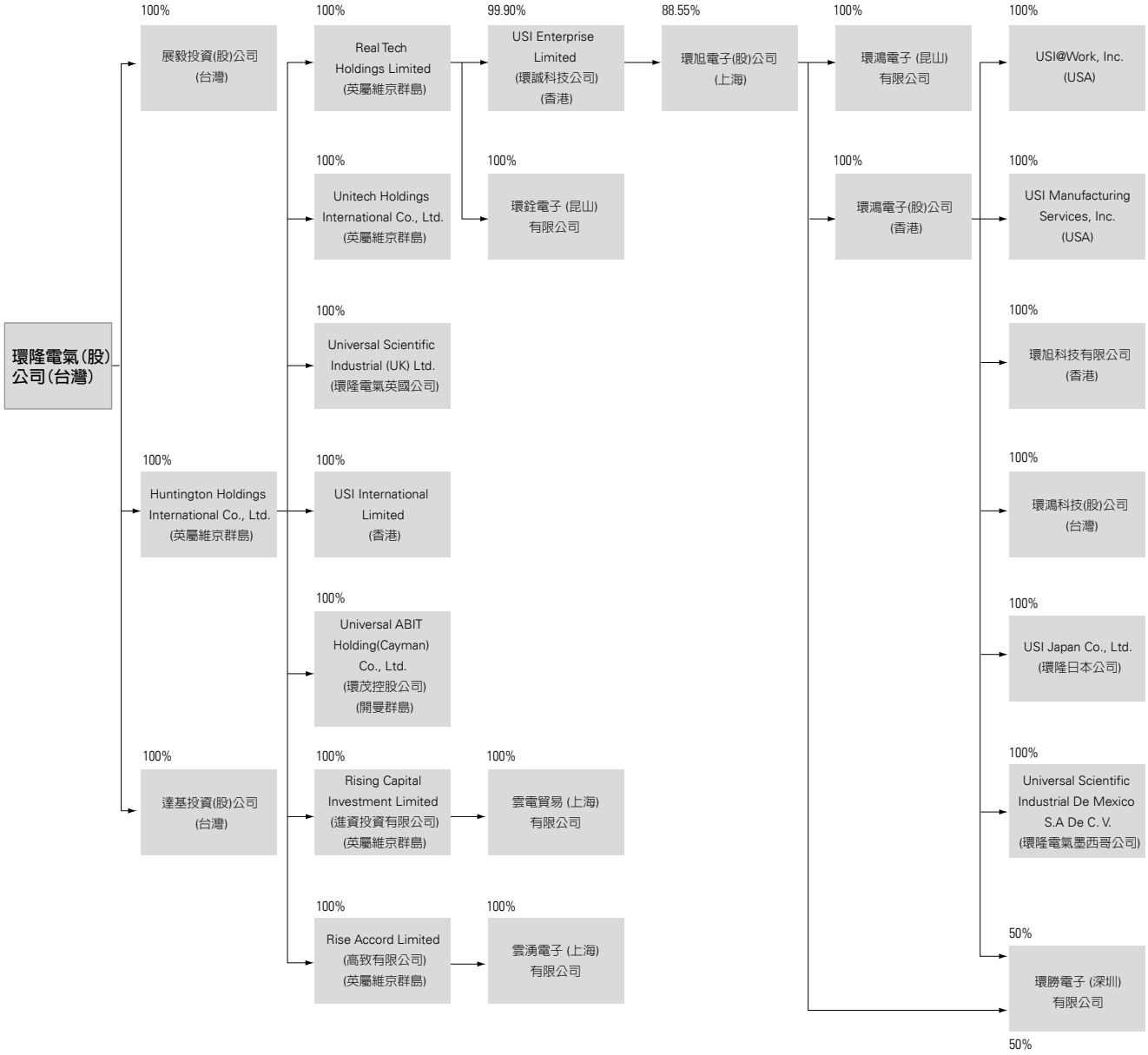
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖(101.12.31)


環隆電氣(股)公司(台灣)
100%
展毅投資(股)公司 (台灣)
100%
Huntington Holdings International Co., Ltd. (英屬維京群島)
100%
達基投資(股)公司 (台灣)
100%
Real Tech Holdings Limited (英屬維京群島)
99.90%
USI Enterprise Limited (環誠科技公司) (香港)
88.55%
環旭電子(股)公司 (上海)
100%
環鴻電子 (昆山) 有限公司
100%
環鴻電子(股)公司 (香港)
100%
USI@Work, Inc. (USA)
100%
USI Manufacturing Services, Inc. (USA)
100%
環旭科技有限公司 (香港)
100%
環鴻科技(股)公司 (台灣)
100%
USI Japan Co., Ltd. (環隆日本公司)
100%
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A De C. V. (環隆電氣墨西哥公司)
50%
環勝電子 (深圳) 有限公司
50%
100%
Unitech Holdings International Co., Ltd. (英屬維京群島)
100%
環銓電子 (昆山) 有限公司
100%
Universal Scientific Industrial (UK) Ltd. (環隆電氣英國公司)
100%
USI International Limited (香港)
100%
Universal ABIT Holding(Cayman) Co., Ltd. (環茂控股公司) (開曼群島)
100%
Rising Capital Investment Limited (進資投資有限公司) (英屬維京群島)
100%
雲電貿易 (上海) 有限公司
100%
Rise Accord Limited (高致有限公司) (英屬維京群島)
100%
雲湧電子 (上海) 有限公司

(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光半導體製造(股)公司	73年3月	高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號	NT$75,941,496仟元	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASE Corporation	95年3月	Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, Grant Cayman, Cayman Islands	NT$11,425,922仟元 (USD$352,784仟元)	從事專業性投資
日月光半導體(上海)公司	90年12月	上海張江高科技園區金科路2300號	NT$4,236,563仟元 (USD$133,812仟元)	發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷
日月光電子股份有限公司	95年3月	高雄市楠梓加工出口區開發路73號	NT$3,989,819仟元	電子材料批發業、電子材料零售業、國際貿易業
ASE Labuan Inc.	95年3月	Labuan F.T. Malaysia	NT$4,099,954仟元 (USD$126,184仟元)	從事專業性投資
ASE Mauritius Inc.	95年4月	608, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Republic of Mauritius.	NT$7,046,629仟元 (USD$217,800仟元)	從事專業性投資
日月光半導體(香港)有限公司	97年4月	RMS 2702-3 ,27/F Bank of EAST ASIA Harbour view Centre, 56 Gloucester RD, Wan Chai ,HK	NT$32,130仟元 (USD$1,000仟元)	從事貿易活動
ASE Test Limited. (Singapore)	84年12月	1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard, Singapore (018989)	NT$659,075仟元 (USD$27,356仟元)	從事專業性投資
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	NT$2,019,907仟元 (USD$62,260仟元)	半導體產品封裝測試服務
ISE Labs,Inc.	72年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA94538, U.S.A	NT$852仟元 (USD$26仟元)	半導體產品測試服務
ASE Singapore Pte. Ltd.	87年2月	2 Woodlands Loop Singapore 738074	NT$984,851仟元 (USD$30,056仟元)	半導體產品封裝測試服務
ASE Test Holdings, Ltd.	88年4月	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.	NT$162元 (USD$ 5元)	從事專業性投資
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	NT$1,633,708仟元 (SGD$71,429仟元)	從事專業性投資
ASE Test Finance Limited.	88年6月	608 St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Mauritius	NT$65元 (USD$2元)	從事專業性理財活動
台灣福雷電子(股)公司	76年12月	高雄市楠梓加工出口區西五街十號	NT$3,614,600仟元	半導體產品測試服務
ASE (Korea) Inc.	56年3月	494,Munbal-Ri,Kyoha,Paju-Si, Kyunggi-Do,Korea	NT$2,103,271仟元 (USD$67,976仟元)	半導體產品封裝測試服務
ASE Japan Co., Ltd.	93年5月	1863,Iryuda,Takahata-machi, Higashiokitama-gun,Yamagata, 992-0324,Japan	NT$105,802仟元 (￥360,000仟元)	半導體產品封裝測試服務
日月光電子元器件(上海)有限公司	94年1月	上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層	NT$389,316仟元 (USD$12,000仟元)	光電子器件等新型電子元器件、印刷電路板產銷、提供技術諮詢服務
日月光封裝測試(上海)有限公司	89年12月	上海張江高科技園區郭守敬路669號	NT$6,501,336仟元 (USD$203,580仟元)	半導體產品封裝測試服務
蘇州日月新半導體有限公司	90年5月	蘇州工業園區蘇虹西路188號	NT$1,568,467仟元 (USD$48,672仟元)	半導體產品封裝測試服務
日月光半導體(威海)有限公司	90年12月	威海市經濟技術發展區出口加入區海南路16-1號	NT$3,244,744仟元 (USD$107,200仟元)	半導體產品封裝測試服務
上海威宇宏欣半導體有限公司	95年12月	上海浦東華東路5001號T3-11-105	NT$337,499仟元 (RMB$76,000仟元)	從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
日月光集成電路製造(中國)有限公司	99年7月	上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室	NT$3,082,400仟元 (USD$100,000仟元)	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
洋鼎科技股份有限公司	93年8月	台中市潭子區南二路5-2號之1	NT$233,184仟元	半導體產品封裝測試服務
日月光半導體(昆山)有限公司	93年8月	江蘇省昆山市千 鎮淞南路373號	NT$5,862,852仟元 (USD$200,000仟元)	半導體產品封裝測試服務
日月光電子元器件(昆山)有限公司	96年1月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側	NT$871,200仟元 (USD$30,000仟元)	生產銷售新型電子元器件、提供技術諮詢服務
Global Advanced Packaging Technology Ltd. (Cayman)	89年10月	Walkers House 87 Mary Street, Grand Cayman, KY1 - 9002, Cayman Islands	NT$6,119,380仟元 (USD$190,000仟元)	從事專業性投資

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
A.S.E Holding Limited. (Bermuda)	79年2月	Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT$7,915,000仟元 (USD$243,966仟元)	從事專業性投資
J&R Holding Limited. (Bermuda)	84年12月	Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT$13,907,259仟元 (USD$435,128仟元)	從事專業性投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	NT$5,870,460仟元 (USD$180,947仟元)	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT$11,457,298仟元 (USD$354,704仟元)	從事專業性投資
Innosource Limited	90年6月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT$2,770,696仟元 (USD$86,000仟元)	從事專業性投資
日月瑞(股)公司	88年4月	高雄市楠梓加工出口區內環北路107號	NT$1,700,000仟元	從事租賃及投資業務
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	NT$18,298仟元 (￥60,000仟元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
ASE (U.S.) Inc.	72年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	NT$649仟元 (USD$20仟元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
Super Zone Holdings Limited	97年6月	1408 World-Wide House,19 Des Voeux Road Central,Hong Kong	NT$3,082,400仟元 (USD$100,000仟元)	從事專業性投資活動
Alto Enterprises Limited	99年3月	P.O. Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT$3,806,880仟元 (USD$128,000仟元)	從事專業性投資活動
Anstock Limited	100年3月	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Isaland	NT$303仟元 (USD$ 10仟元)	從事專業性理財活動
日月光投資(昆山)有限公司	101年5月	江蘇省昆山市千燈鎮淞南路373號	NT$1,850,880仟元 (USD$62,000仟元)	從事專業性投資活動
上海鼎匯房地產開發有限公司	94年8月	上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室	NT$17,029,989仟元 (人民幣3,600,000仟元)	房地產項目開發、物業管理
上海鼎威房地產開發有限公司	98年10月	上海市漕溪路270號1號樓338室	NT$7,247,880仟元 (人民幣1,548,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
上海鼎裕房地產開發有限公司	99年3月	上海市寶山區錦秋路48號E192	NT$5,053,352仟元 (人民幣1,100,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
昆山鼎泓房地產開發有限公司	101年2月	昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房	NT$3,143,652仟元 (人民幣670,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
昆山鼎悅房地產開發有限公司	101年2月	昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房	NT$1,547,912仟元 (人民幣330,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
陸竹開發(股)公司	93年12月	臺北市信義區基隆路1段333號19樓	NT$2,486,260仟元	房地產開發業務
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$12,453,900仟元	各種電腦資訊之週邊設備、厚膜混合積體電路、無線區域網路設備、電子零件配件及個人電腦暨其零件之製造、加工與買賣
展毅投資股份有限公司	85年10月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$393,297仟元	專業投資
達基投資股份有限公司	87年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$43,927仟元	專業投資
Huntington Holdings International Co., Ltd.	85年10月	Drake Chambers,Tortola,British Virgin Islands	NT$8,370,606仟元 (USD$255,857仟元)	控股公司
Universal Scientific Industrial (UK) Ltd.	87年4月	Steadman Place RiversideBusiness Park Irvine, AyrshireScotland UK KALL 5DN	NT$1,291,062仟元 (GBP$ 25,420千元)	海外售後服務
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	95年2月	P.O. Box 30691 SMB, GrandCayman.	NT$906,249仟元 (EUR$ 3,800千元)	控股公司
Unitech Holdings International Co., Ltd.	85年10月	P.O. Box 3321 Road TownTortola BVI	NT$111,256仟元 (USD$3,000仟元)	控股公司
Rising Capital Investment Limited	99年11月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT$ 176,940仟元 (USD$ 6,000仟元)	控股公司
雲電貿易(上海)有限公司	100年3月	上海市盧灣區中山南一路500弄1號304室	NT$ 147,450仟元 (USD$5,000仟元)	電子產品及通訊產品批發

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Rise Accord Limited	100年5月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT$ 57,730仟元 (USD$ 2,000仟元)	控股公司
雲湧電子(上海)有限公司	100年11月	上海市張江高科技園區龍東大道3000號A樓1201A室	NT$ 60,780仟元 (USD$ 2,000仟元)	電子元器件、計算主機板、無線網路通訊元器件、通訊及移動通信產品及模塊及相關零配件批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務
Real Tech Holdings Litimted	89年3月	Trust Net Chambers, P.O. Box3444, Road Town, Tortola,B.V. I.	NT$6,270,044仟元 (USD$149,151仟元)	控股公司
環銓電子(昆山)有限公司	94年8月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側	NT$383,201仟元 (USD$12,000仟元)	生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性能主機板及銷售自產產品
USI Enterprise Limited (環誠科技有限公司)	96年11月	7/F, Yue Fung Industrial Building, 22 Wang Yip Street South, Yuen Long, N.T. Hong Kong SAR	NT$6,642,762仟元 (USD$211,113仟元)	投資諮詢服務及倉儲管理服務
環旭電子股份有限公司	92年1月	上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號	NT$4,278,976仟元 (USD$133,652仟元)	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售
環鴻電子(昆山)有限公司	100年8月	千燈鎮黃浦路497號4棟	NT$ 505,212仟元 (RMB¥110,000仟元)	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售
Universal Global Technology Co., Limited(環鴻公司)	97年3月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT$1,476,556仟元 (USD$50,000仟元)	控股公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. (環隆墨西哥公司)	86年9月	Anillo Periferico ManuelGomez Morin No 656R.Santa Isabel C.P. 44290Guadalajara, Jalisco, Mexico	NT$1,003,750仟元 (USD$23,963仟元)	主機板及電腦系統組裝
USI@Work	89年12月	2000 Regency Parkway, Suite420 Cary, NC 27518 USA	NT$8,089仟元 (USD$250仟元)	海外售後服務
USI Japan Co., Ltd.	89年3月	8F West Tower, YokohamaBusiness Park, 134 Godo-cho,Hodogaya-ku, Yokohama-shi,Kanagawa 240-0005	NT$27,231仟元 (JPY 95,000千元)	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
環勝電子(深圳)公司	89年7月	深圳市南山區高新技術產業園北區環旭電子園	NT$2,445,264仟元 (USD$75,000仟元)	生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售
環旭科技有限公司	98年10月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT$330,960仟元 (USD$11,000仟元)	貿易及投資控股公司
USI Manufacturing Service, Inc.	89年10 月	3600 Peterson Way, SantaClara,CA95054,USA	NT$314,015仟元 (USD$9,500仟元)	電腦資訊設備之樣本製作、維修服務
環鴻科技股份有限公司	98年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$980,000仟元	有線及無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。
2. 日月光集團長久以來專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料及性能測試之服務。此外，客戶也可透過子公司環隆電氣(股)公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。
3. 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯，其往來分工情形向以透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援，以發揮集團最大競爭實力，創造最大綜效，鞏固本公司在業界的領導地位。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光半導體製造股份有限公司	副董事長兼總經理	張洪本	102,994,941股	1.36%
	董事	香港商微電子國際公司	1,327,202,773股	17.48%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	–	–
	董事(代表人)	吳田玉	–	–
	董事(代表人)	董宏思	–	–
	董事	J&R Holding Limited.(Bermuda)	46,703,763股	0.61%
	董事(代表人)	羅瑞榮	–	–
	董事(代表人)	陳昌益	–	–
	董事	張能傑	1,659,708股	0.02%
	獨立董事	游勝福	–	–
	獨立董事	徐大麟	–	–
	監察人	張能超	529,860股	0.01%
	監察人	宏璟建設股份有限公司	85,588,293股	1.13%
	監察人(代表人)	曾元一	–	–
	監察人(代表人)	陳天賜	–	–
	監察人(代表人)	潘士華	–	–
	監察人(代表人)	李俊哲	–	–
J&R Holding Limited. (Bermuda)	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Richard H. P. Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
日月瑞股份有限公司	董事	J&R Holding Limited.(Bermuda)	170,000,006股	100%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	–	–
	董事(代表人)	張洪本	–	–
	董事(代表人)	董宏思	–	–
	監察人(代表人)	馮美珍	–	–
A.S.E Holding Limited. (Bermuda)	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Richard H. P. Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
Omniquest Industrial Limited	董事	Richard H. P. Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
Innosource Limited	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Richard H. P. Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
ASE Corporation	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Joseph Hung-Szu Tung	–	–
ASE Mauritius Inc.	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Joseph Hung-Szu Tung	–	–
	董事	M. Aslam Koomar	–	–
	董事	M. Shariff Golam Hossen	–	–
ASE Labuan Inc.	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Joseph Hung-Szu Tung	–	–
	董事	Chau Siew Ha	–	–
日月光半導體(上海)股份有限公司	董事兼董事長	張虔生	–	–
	董事	張洪本	–	–
	董事	張能超	–	–
	董事	張能傑	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光半導體(上海)股份有限公司	董事	李俊哲	–	–
	董事	李智強	–	–
	董事	呂巍	–	–
	董事	朱菁	–	–
	董事	包啓敏	–	–
	監事主席	何弘	–	–
	監事	陳天賜	–	–
	監事職工代表	鄭志宏	–	–
日月光半導體(昆山)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	張虔生	–	–
	董事	陳昌益	–	–
	監事	Rutherford Chang	–	–
日月光電子元器件(上海)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	張虔生	–	–
	董事	陳昌益	–	–
上海鼎匯房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	俞旭濬	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
上海鼎威房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	俞旭濬	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
上海鼎裕房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	俞旭濬	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
昆山鼎泓房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	俞旭濬	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
昆山鼎悅房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	俞旭濬	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
日月光半導體(香港)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	陳昌益	–	–
	董事	鄭世欣	–	–
日月光電子元器件(昆山)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	張虔生	–	–
	董事	陳昌益	–	–
	監事	董宏思	–	–
ASE Investment (Labuan) Inc.	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
	董事	Mathew-Willie	–	–
ASE (Korea) Inc.	董事	Ung Bae	–	–
	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Richard H. P. Chang	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASE (Korea) Inc.	董事	Joseph Tung	–	–
	監察人	Alan Cheng	–	–
ASE Test Limited (Singapore)	董事長	Jason C.S. Chang	–	–
	董事	Richard H.P. Chang	–	–
	董事	Lee Kwai Mun	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
台灣福雷電子(股)公司	董事&監察人	日月光半導體製造股份有限公司	361,460,000股	100.00%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	–	–
	董事(代表人)	張洪本	–	–
	董事(代表人)兼總經理	羅瑞榮	–	–
	董事(代表人)	潘士華	–	–
	董事(代表人)	張能傑	–	–
	董事(代表人)	陳天賜	–	–
	董事(代表人)	周家佩	–	–
	董事(代表人)	陳昌益	–	–
	董事	鄭天正	–	–
	監察人(代表人)	董宏思	–	–
	監察人(代表人)	唐和明	–	–
ASE Test Holdings, Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	David Pan	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	董事	Hsiang De Way	–	–
	董事	Choong Lai Heng	–	–
	董事	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	–	–
ASE Test Finance Limited	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	David Hsiang	–	–
	董事	M. Shariff Golam Hossen	–	–
	董事	M.Aslam Koomar(Mr.)	–	–
ASE Electronics (M) Sdn,Bhd.	董事	Richard H. P. Chang	–	–
	董事	Mei-Jean Chang	–	–
	董事	Hsiang, De-Way	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	Choong Lai Heng	–	–
	董事	Lee Kwai Mun	–	–
ISE Labs,Inc.	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Tien Wu	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
ASE Singapore Pte. Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	–	–
	董事	Kuo Hung-Ming	–	–
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	–	–
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	董事	Tien Wu	–	–
	董事	John Ho	–	–
	董事	Chih-Hsiao Chung	–	–
	監察人	Joseph Tung	–	–
ASE Japan Co., Ltd.	董事	Jason C.S. Chang	–	–
	董事	Richard Chang	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASE Japan Co., Ltd.	董事	Tien Wu	–	–
	董事	David Pan	–	–
	董事	Chih-Hsiao Chung	–	–
	監察人	Joseph Tung	–	–
ASE (U.S.) Inc.	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang	–	–
日月光電子股份有限公司	董事&監察人	ASE Labuan Inc.	398,981,900股	100%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	–	–
	董事(代表人)	董宏思	–	–
	董事(代表人)	陳昌益	–	–
	監察人(代表人)	潘士華	–	–
GAPT-Cayman	董事	張洪本	–	–
	董事	Chih-Chiang Lee	–	–
	董事	Tien-Yue Wu	–	–
日月光封裝測試(上海)有限公司	董事	張洪本	–	–
	董事及總經理	Tien-Yue Wu	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	監事	陳昌益	–	–
Alto Enterprises Limited	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Richard Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
Super Zone Holdings Limited	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Richard Chang	–	–
	董事	Jeffrey Chen	–	–
Anstock Limited	董事	Jason Chang	–	–
	董事	Richard Chang	–	–
	董事	Joseph Tung	–	–
日月光投資(昆山)有限公司	董事兼董事長	張虔生	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	許志安	–	–
	監事	鄭世欣	–	–
上海威宇宏欣半導體有限公司	董事	陸濤	–	–
日月光集成電路製造(中國)有限公司	董事	張虔生	–	–
	董事	張洪本	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事	鄭世欣	–	–
蘇州日月新半導體有限公司	董事長	張虔生	–	–
	董事	吳田玉	–	–
	董事	陳昌益	–	–
	董事	Julien Charles Deregnaucourt	–	–
	董事	Martinus Maria Franciscus Verguld	–	–
	監事	David Siu Kee Kiang	–	–
	監事	陳天賜	–	–
日月光半導體(威海)有限公司	董事	吳田玉	–	–
	董事	裴熊	–	–
	董事	張能傑	–	–
	監察人	金首虎	–	–
陸竹開發股份有限公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	209,462,630股	84.25%
	董事(代表人)	潘士華	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
陸竹開發股份有限公司	董事(代表人)	陳天賜	–	–
	董事(代表人)	郭宏銘	–	–
	董事(代表人)	沈貝俐	–	–
	董事(代表人)	李柏練	–	–
	董事(代表人)	張聲華	–	–
	董事(代表人)	俞旭濬	–	–
	董事(代表人)	洪華霜	–	–
	董事(代表人)	劉純香	–	–
	董事	光磊科技股份有限公司	15,870,370股	6.38%
	董事(代表人)	陳建璋	–	–
	董事	敦南科技股份有限公司	12,650,000股	5.09%
	董事(代表人)	李朝福	–	–
	監察人	董宏思	–	–
	監察人	何弘	–	–
洋鼎科技股份有限公司	董事	張虔生	–	–
	董事	張洪本	–	–
	董事	潘士華	–	–
	監察人	董宏思	–	–
環隆電氣股份有限公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	1,209,573,053股	99.18%
	董事長	張洪本	–	–
	董事	張虔生	–	–
	董事 (代表人)兼總經理	魏振隆	–	–
	董事 (代表人)	魏鎮炎	–	–
	董事 (代表人)	劉曉明	–	–
	董事 (代表人)	石孟國	–	–
	董事 (代表人)	朱曙華	–	–
	董事 (代表人)	陳昌益	–	–
	董事	張能傑	–	–
	監察人	簡文祥	–	–
	監察人	董宏思	–	–
	監察人	俞旭濬	–	–
展毅投資股份有限公司	董事&監察人	環隆電氣股份有限公司	39,329,700股	100%
	董事兼總經理&董事長(代表人)	魏振隆	–	–
	董事(代表人)	魏鎮炎	–	–
	董事(代表人)	陳昌益	–	–
	監察人(代表人)	石孟國	–	–
達基投資股份有限公司	董事&監察人	環隆電氣股份有限公司	4,392,700股	100%
	董事兼總經理&董事長(代表人)	魏鎮炎	–	–
	董事(代表人)	魏振隆	–	–
	董事(代表人)	陳昌益	–	–
	監察人(代表人)	石孟國	–	–
Huntington Holdings International Co., Ltd.	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	石孟國	–	–
	董事	陳昌益	–	–
Universal Scientific Industrial (UK) Ltd	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	何弘	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	何弘	–	–
	董事	吳國相	–	–
	董事	林大毅	–	–
	董事	石孟國	–	–
Unitech Holdings International Co., Ltd	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	石孟國	–	–
Rising Capital Investment Limited	董事	石孟國	–	–
雲電貿易(上海)有限公司	董事	石孟國	–	–
Rise Accord Limited	董事	石孟國	–	–
雲湧電子(上海)有限公司	董事	石孟國	–	–
Real Tech Holdings Limited	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	石孟國	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
環銓電子(昆山)公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	魏振隆	–	–
	監察人	石孟國	–	–
環誠科技有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	石孟國	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
環旭電子股份有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	張虔生	–	–
	董事	何弘	–	–
	董事	Rutherford Chang	–	–
	董事兼總經理	魏鎮炎	–	–
	董事	吳福輝	–	–
	董事	董偉	–	–
	董事	陳啓杰	–	–
	董事	潘飛	–	–
	監察人	董宏思	–	–
	監察人	石孟國	–	–
	監察人	黃添一	–	–
環鴻電子(昆山)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事兼總經理	林大毅	–	–
	監察人	石孟國	–	–
環鴻電子(股)公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	劉丹陽	–	–
環隆墨西哥公司	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	侯爵	–	–
	董事	林大毅	–	–
	董事	石孟國	–	–
	董事	Hector Escobedo	–	–
USI@WORK	董事	陳麗華	–	–
	董事	林大毅	–	–

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
USI Japan Co., Ltd.	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	侯爵	–	–
	董事	金子憲幸	–	–
	監察人	石孟國	–	–
環勝電子(深圳)有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	侯爵	–	–
	董事	魏振隆	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事兼總經理	林大毅	–	–
	董事	石孟國	–	–
環旭科技有限公司	董事兼董事長	張洪本	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	石孟國	–	–
USI Manufacturing Services, Inc.	董事兼董事長	魏振隆	–	–
	董事	魏鎮炎	–	–
	董事	石孟國	–	–
環鴻科技股份有限公司	董事	環鴻公司	98,000,000股	100%
	董事(代表人)兼董事長	張洪本	–	–
	董事(代表人)	魏鎮炎	–	–
	董事(代表人)	石孟國	–	–
	監察人(代表人)	董宏思	–	–

(六)各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元/每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
日月光半導體製造(股)公司	75,941,496	189,000,561	79,485,676	109,514,885	72,926,652	10,732,774	13,091,359	1.76
ASE Corporation	11,425,922	13,604,395	50	13,604,345	0	(243)	(195,650)	(0.55)
日月光半導體(上海)股份有限公司	4,236,563	14,817,928	6,174,947	8,642,980	4,361,278	(45,057)	(38,962)	(0.04)
日月光電子股份有限公司	3,989,819	4,244,935	1,047,182	3,197,754	3,800,120	354,101	205,204	0.51
ASE Labuan Inc.	4,099,954	3,214,752	0	3,214,752	0	(72)	205,137	1.63
ASE Mauritius Inc.	7,046,629	10,385,264	179	10,385,085	0	(2,771)	(400,543)	(1.84)
日月光半導體(香港)有限公司	32,130	452,195	224,719	227,476	708,020	403	2,768	2.77
ASE Test Ltd. (Singapore)	659,075	22,809,258	2,432	22,806,826	0	(13,524)	1,537,393	14.05
ASE Electronics (M) Sdn,Bhd.	2,019,907	4,285,217	772,716	3,512,502	4,229,459	463,476	677,141	4.24
ISE Labs,Inc.	852	2,267,397	200,480	2,066,917	904,096	33,724	97,382	3.71
ASE Singapore Pte. Ltd.	984,851	5,414,588	2,756,155	2,658,434	3,645,737	755,972	659,759	21.92
ASE Test Holdings,Ltd.	0 (註一)	2,666,488	0	2,666,488	0	(43)	97,340	19,467,918
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	1,633,708	4,285,217	772,716	3,512,502	4,229,459	463,476	677,141	9.48
ASE Test Finance,Ltd.	0 (註二)	731	156	575	0	(338)	(337)	(168,652)
台灣福雷電子(股)公司	3,614,600	22,465,970	1,954,220	20,511,750	9,848,198	3,133,555	2,473,629	6.84
ASE (Korea) Inc.	2,103,271	15,663,458	2,660,800	13,002,659	14,817,634	693,300	(345,347)	(24.58)
ASE Japan Co., Ltd.	105,802	4,005,508	1,439,902	2,565,607	2,964,487	138,734	91,658	12,730
日月光電子元器件(上海)有限公司	389,316	537,838	1,777	536,061	0	(321)	18,784	不適用
日月光封裝測試(上海)有限公司	6,501,336	23,252,223	14,295,788	8,956,434	9,267,040	(355,554)	(531,437)	不適用

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
蘇州日月新半導體有限公司	1,568,467	4,293,955	2,253,918	2,040,037	3,706,620	409,209	327,780	不適用
日月光半導體(威海)有限公司	3,244,744	8,038,511	6,579,197	1,459,314	2,850,864	(833,261)	(967,109)	不適用
上海威宇宏欣半導體有限公司	337,499	298,754	0	298,754	0	(7,196)	(5,237)	不適用
日月光集成電路製造(中國)有限公司	3,082,400	3,028,450	176	3,028,274	0	(15,353)	38,802	不適用
洋鼎科技股份有限公司	233,184	1,358,260	1,255,204	103,056	321,748	(178,046)	(183,010)	(7.85)
日月光半導體(昆山)有限公司	5,862,852	10,977,424	6,750,957	4,226,467	2,125,119	(603,941)	(752,785)	不適用
日月光電子元器件(昆山)有限公司	871,200	882,354	13,740	868,614	0	(2,024)	(874)	不適用
Global Advanced Packaging Technology Ltd.-Cayman	6,119,380	8,961,077	460,692	8,500,386	0	(342)	(532,580)	(2.8)
A.S.E Holding Limited.(Bermuda)	7,915,000	14,398,714	1,163,563	13,235,151	0	(6,487)	(71,310)	(292)
J&R Holding Limited (Bermuda)	13,907,259	57,551,217	17,298,768	40,252,449	0	(21,156)	839,011	1,928
ASE Investment (Labuan) Inc.	5,870,460	13,132,698	50	13,132,648	0	(184)	(338,117)	(1.60)
Omniquest Industrial Limited	11,457,298	13,606,958	2,935	13,604,023	0	0	(195,669)	(0.55)
Innosource Limited	2,770,696	3,374,459	0	3,374,459	0	0	(22,032)	(0.26)
日月瑞(股)公司	1,700,000	990,688	3,085	987,603	0	(13,856)	(5,561)	(0.03)
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	18,298	46,678	16,672	30,006	90,450	3,360	(739)	(616)
ASE (U.S) Inc.	649	271,667	37,115	234,552	1,016,099	11,440	(19,258)	(19,258)
Super Zone Holdings Limited	3,082,400	3,028,384	0	3,028,384	0	(59)	38,741	0.39
Alto Enterprises Limited	3,806,880	2,723,234	0	2,723,234	0	0	(381,371)	(2.98)
Anstock Limited	303	3,021,558	3,014,851	6,707	0	(201)	6,586	不適用
日月光投資(昆山)有限公司	1,850,880	1,328,531	30	1,328,500	0	(2,093)	(58,990)	不適用
上海鼎匯房地產開發有限公司	17,029,989	19,569,496	1,631,352	17,938,144	1,534,665	938,438	385,501	不適用
上海鼎威房地產開發有限公司	7,247,880	7,464,951	330,649	7,134,302	0	(6,593)	(5,892)	不適用
上海鼎裕房地產開發有限公司	5,053,352	5,094,505	2,832	5,091,673	0	481	14,415	不適用
昆山鼎泓房地產開發有限公司	3,143,652	3,093,689	911	3,092,778	0	(3,581)	(2,764)	不適用
昆山鼎悅房地產開發有限公司	1,547,912	1,524,146	943	1,523,204	0	(2,020)	(1,468)	不適用
陸竹開發股份有限公司	2,486,260	1,626,753	60,474	1,566,280	0	(2,226)	(8,512)	(0.03)
環隆電氣股份有限公司	12,453,900	46,377,999	24,040,652	22,337,347	62,483,192	3,104,107	2,428,581	1.87
展毅投資股份有限公司	393,297	507,760	65	507,695	0	(96)	1,219	0.03
達基投資股份有限公司	43,927	47,818	0	47,818	0	(164)	(172)	(0.04)
Huntington Holdings International Co., Ltd.	8,370,606	21,706,504	12,296	21,694,208	0	(16,487)	2,603,931	10.18
Universal Scientific Industrial (UK) Ltd	1,291,062	164,720	780	163,940	0	54	762	0.03
Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd	906,249	913	99,667	(98,754)	0	(282)	(280)	0.00
Unitech Holdings International Co., Ltd	111,256	342,995	1,979	341,016	0	(2,136)	29,881	9.96
Rising Capital Investment Limited	176,940	46,642	127	46,515	0	(304)	(41,898)	(6.98)
雲電貿易(上海)有限公司	147,450	43,720	9,840	33,880	3,889	(39,283)	(41,607)	不適用
Rise Accord Limited	57,730	36,658	0	36,658	0	70	(21,563)	(1,078.15)
雲湧電子(上海)有限公司	60,780	81,230	44,572	36,658	226,615	(21,784)	(21,632)	不適用
Real Tech Holdings Limited	6,270,044	19,429,907	49,330	19,380,577	0	(275)	2,629,062	17.63
環銓電子(昆山) 有限公司	383,201	398,785	431	398,354	0	(3,097)	5,935	不適用
環誠科技有限公司	6,642,762	17,386,059	79,558	17,306,501	3,316	194	2,575,077	12.21
環旭電子股份有限公司	4,278,976	25,008,507	8,951,367	16,057,140	37,792,224	2,003,115	2,987,793	3.34
環鴻電子(昆山)有限公司	505,212	2,340,971	1,868,798	472,173	1,385,684	(54,573)	(37,097)	不適用
環鴻電子(股)公司	1,476,556	7,300,166	4,759,833	2,540,333	8,450,463	(100,459)	733,909	1.88
環隆墨西哥公司	1,003,750	1,079,143	310,380	768,763	1,858,717	46,027	50,624	0.18
USI@Work	8,089	22,699	2,049	20,650	36,738	1,070	607	2.43
USI Japan Co., Ltd.	27,231	25,947	3,109	22,838	26,043	684	2,340	365.63
環勝電子(深圳)有限公司	2,445,264	11,558,458	6,608,610	4,949,848	16,698,255	1,169,188	1,060,112	不適用

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
環旭科技有限公司	330,960	5,897,909	5,511,945	385,964	19,314,691	118,948	108,586	1.27
USI Manufacturing Services, Inc.	314,015	130,044	4,582	125,462	39,218	847	1,111	4.44
環鴻科技股份有限公司	980,000	7,681,133	6,447,157	1,233,976	17,996,889	126,300	154,643	1.58

註一：設立資本額為美金5元。
註二：設立資本額為美金2元。

(七) 關係企業合併財務報表

本公司民國一〇一年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(八) 本公司業已於本年報財務報告第96-99頁及第132-133頁揭露所有關係企業從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易資訊，其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、子公司持有或處分本公司股票情形：

102年02月28日 單位：新台幣仟元(除另有註明者外)；股：%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額(註)	處分股數及金額	投資(損)益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
台灣福雷電子(股)公司	3,614,600	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	101年	1,347,273股 –	– –	–	10,978,776股(註) 帳面金額$276,665千元 轉列庫藏股金額$196,677	–	–	–
				本年度截至年報刊印日止	– –	– –	–	10,978,776股(註) 帳面金額$270,078千元 轉列庫藏股金額$196,677	–	–	–
ASE Test Ltd.	659,075	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	101年	10,823,630股 –	– –	–	88,200,472股(註) 帳面金額$2,222,652千元 轉列庫藏股金額$1,380,721	–	–	–
				本年度截至年報刊印日止	– –	– –	–	88,200,472股(註) 帳面金額$2,169,732千元 轉列庫藏股金額$1,380,721	–	–	–
J&R Holding Ltd. (Bermuda)	13,907,259	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	101年	5,731,310股 –	– –	–	46,703,763股 帳面金額$1,176,935千元 轉列庫藏股金額$381,709	–	–	–
				本年度截至年報刊印日止	– –	– –	–	46,703,763股 帳面金額$1,148,913千元 轉列庫藏股金額$381,709	–	–	–

註：為配合ASE Test Ltd.當地法令規定，台灣福雷電子(股)公司取得本公司之股票9,600,219股信託予中國信託商業銀行，另1,378,557股集保；ASE Test Ltd.取得本公司之股票88,200,472股全數信託予中國信託商業銀行。

四、其他必要補充說明事項：無。

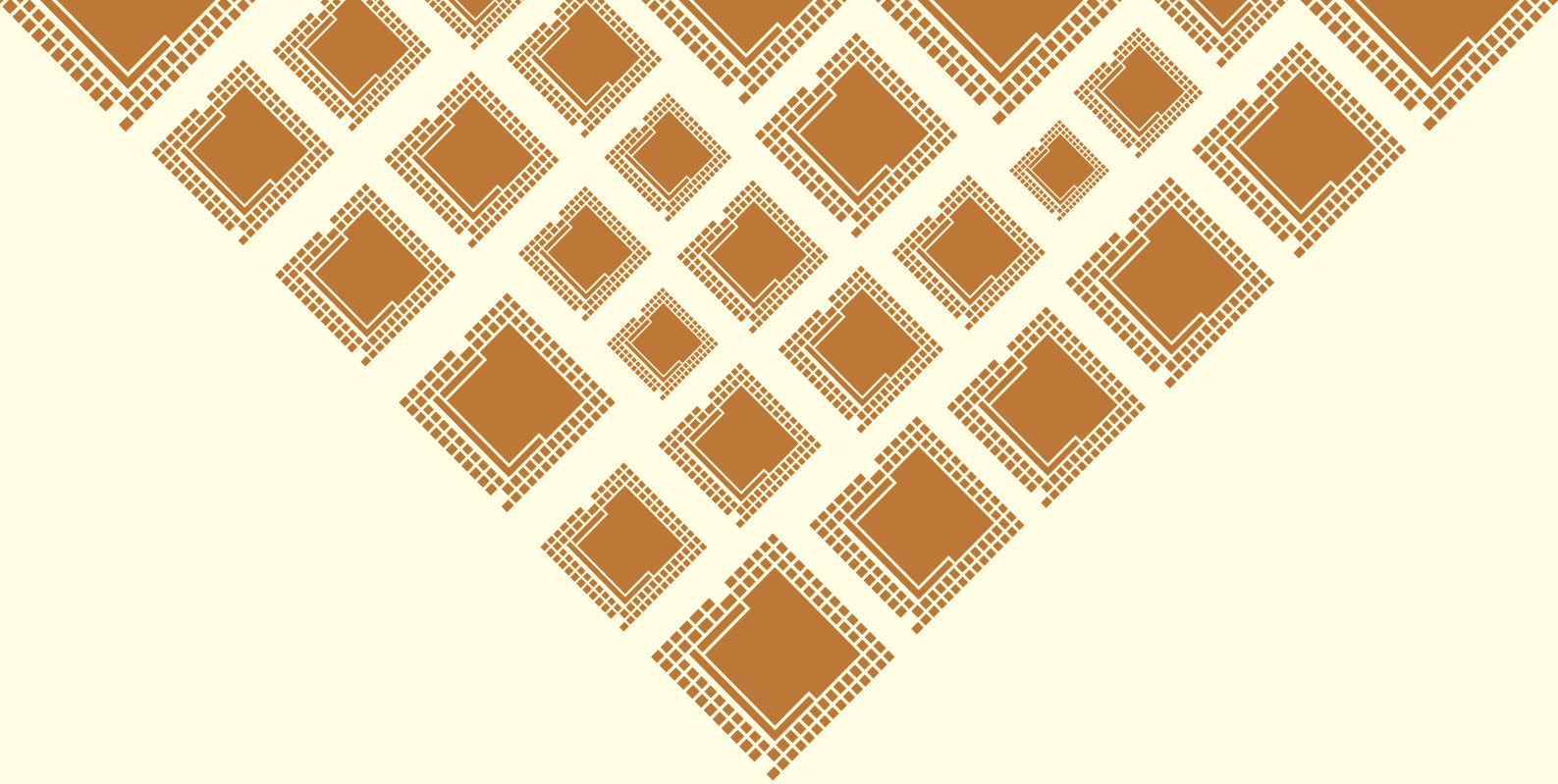
玖、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

日月光半導體製造股份有限公司

負責人｜張虔生

中華民國一〇二年二月二十八日 刊印



日月光半導體製造股份有限公司
www.aseglobal.com
本年報採用大豆油墨印刷與環保紙張
符合FSC認證